การวัดความหนาของฟิล์มบางนาโนด้วยเทกนิกเอกซเรย์สเปกโตรสโกปี แบบกระจายพลังงาน

วิรุฬห์ พรมมากุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มกราคม 2560 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา วิทยานิพนธ์ของ วิรุฬห์ พรมมากุล ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

กณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ว้าราว วิธาว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์)

<u>คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์</u>

*๗- ๛๛*ประธาน

(คร. ภ. พึ่งบุญ ปานศิลา)

fron)on

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์)

Bar Jun กรรมการ

.....กรรมการ

(ดร.อดิศร บูรณวงศ์)

as &

(ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์)

คณะวิทยาศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

Image: Comparison of the second s

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เอกรัฐ ศรีสุข) วันที่...4 ...เดือน...^{พกรา}ภา การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุคหนุนวิทยานิพนธ์/คุษฎีนิพนธ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2559

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีโดยความกรุณาและช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง หลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่ให้ความกรุณาเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ให้ความกรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบ ขอขอบคุณ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ช่วยเหลือประสานงาน ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย โดย วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจาก ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ กณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559 และขอขอบคุณ บุคลากรของ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทค โนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อไพบูลย์ พรมมากุล และคุณแม่สมบูรณ์ พรมมากุล สำหรับความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา พร้อมกันนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดรวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีฟิล์มบางและการเคลือบในสุญญากาศ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ย่อมเป็นผลจากความกรุณาของ ทุกท่านที่เอ่ยนามมาแล้วข้างค้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

วิรุฬห์ พรมมากุล

57912236: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ:

วิรุฬห์ พรมมากุล: การวัดความหนาของฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคเอกซเรย์สเปคโตร สโคปีแบบกระจายพลังงาน (THICKNESS MEASUREMENT OF NANO THIN FILM BY ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY TECHNIQUE) คณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์: นิรันดร์ วิทิตอนันต์, Ph.D. 103 หน้า. ปี พ.ศ. 2560.

เอกซเรย์สเปกโตรสโกปีแบบกระจายพลังงาน / ฟิล์มบาง/ สปัตเตอริง / ความหนา

งานวิจัขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการวัดความหนาของฟิล์มบางที่มีความหนาระดับ นาโนเมตรด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) ซึ่งติดตั้งต่อพ่วงอยู่กับ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค (SEM) ฟิล์มตัวอย่างในการศึกษาคือฟิล์มโครเมียม (Cr) ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยวิธีสปัตเตอริง โดยโครงสร้างผลึก ความหยาบผิว ความหนา โครงสร้างจุลภาค และ องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มศึกษาด้วยเทคนิค GA-XRD, AFM, FE-SEM และ EDS ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาวสะท้อนแสงดี ความหนาของฟิล์มบางที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีค่าอยู่ในช่วง 50.5 - 284.5 nm โดยความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr La จากฟิล์มกับความหนาฟิล์ม สัมพันธ์กัน ตามสมการ I_d = I_x(1 - e^{-αd}) ส่วนความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si Ka จาก วัสดุรองรับกับความหนาฟิล์ม สัมพันธ์กันตามสมการ I_d = I_xe^{-αd} เมื่อ I_d เป็นความเข้มของ รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความหนาเท่ากับ d และ I_x เป็นความเข้มอิ่มตัวของรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะ ส่วน a เป็นค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น ทั้งนี้ความหนาของฟิล์มบาง จากเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโลปีแบบกระจายพลังงานในงานวิจัยนี้มีความถูกต้องถึง 95% เมื่อเทียบกับความหนาของฟิล์มบางที่ได้จากเทคนิค FE-SEM

57912236: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY / THIN FILM / SPUTTERING / THICKNESS

WIROON PROMMAKOON: THICKNESS MEASUREMENT OF NANO THIN FILM BY ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY TECHNIQUE. ADVISORY COMMITTEE: NIRUN WITIT-ANUN, Ph. D. 103 P. 2017.

The objective of this research work is to study the thickness measurement of the thin film with the thickness scale in the range of the nanometer using energy dispersive X-ray spectroscopy technique (EDS), which equips in the scanning electron microscope (SEM). The metal thin films of chromium (Cr) were deposited on glass slides and silicon substrates by sputtering method. The Crystal structure, roughness, thickness, microstructure and elemental component of films were characterized by GA-XRD, AFM, FE-SEM, and EDS technique, respectively. The results showed that the as-deposited chromium thin films exhibit very bright color of dark gray, smooth surface and highly reflectance. The thickness of the films in this study is in the range of 50.5 - 284.5 nm. The intensity of the characteristic X-ray of Cr L_{\alpha} from films are related to film thickness obeyed the equation as $I_d = I_s(1 - e^{-\alpha d})$, while the intensity of the characteristic X-ray from the film thickness d, I_a is the saturation intensity of the characteristic X-ray from the film thickness d, I_s is the saturation intensity of the characteristic X-ray and α is the linear attenuation. The thickness of the films from this models is agreement with the thickness from FE-SEM technique of 95%.

สารบัญ

	หน้า		
บทคัดย่อภาษาไทย			
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ			
สารบัญ			
สารบัญตาราง			
สารบัญภาพ			
บทที่			
1 บทนำ	1		
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1		
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5		
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5		
ขอบเขตของการวิจัย	5		
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6		
การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ	6		
การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง	8		
ระบบเคลือบแบบดีซีสปัตเตอริง	11		
ความหนาและการวัคความหนาของฟีล์ม	13		
รังสีเอกซ์และการเกิดรังสีเอกซ์	18		
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์	25		
เอกซเรย์สเปกโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน	27		
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	33		
3 วิธีดำเนินการวิจัย	38		
อุปกรณ์และเครื่องมือ	38		
เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบดีซีสปัตเตอริง	41		
การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม	43		
ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง	44		
การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง	45		

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		
หลักการและแนวคิดของการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิก EDS	47	
แนวทางการทคลอง	50	
4 ผลและอภิปรายผลการวิจัย	52	
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	52	
การทคสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	66	
5 สรุปผลการทคลอง	78	
บรรณานุกรม		
ภาคผนวก		
ประวัติย่อของผู้วิจัย		

สารบัญตาราง

ตารางที่				
3-1	เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมที่ใช้ในงานวิจัย	50		
4-1	ค่าความหนาขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ความหยาบผิว			
	ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1	54		
4-2	ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์			
	ลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1 สำหรับสร้างแบบจำลอง			
	ทางคณิตศาสตร์	60		
4-3	ค่าความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช			
	ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2	68		
4-4	ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์			
	ลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุคที่ 2			
	สำหรับทคสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	73		
4.5	ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์			
	ลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุคที่ 2 แบบจำลอง			
	ทางคณิตศาสตร์จากฟิล์ม	75		
4-6	ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์			
	ลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุคที่ 2 แบบจำลอง			
	ทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ	77		

สารบัญภาพ

ภาพท์	
2-1	ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ
2-2	อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิววัสคุ
2-3	ระบบเคลือบแบบดีซีสปัตเตอริงอย่างง่าย
2-4	ผลของความคันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายีลค์และกระแสไฟฟ้าใน
	ระบบสปัตเตอริงของนิเกิลที่ใช้แรงคันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรค์
	ที่วางห่างกัน 4.5 cm
2-5	แนวกิดของการวัคกวามหนาด้วยสไตถัส
2-6	ใคอะแกรมการวัดความหนาของบางฟิล์มด้วยเทคนิคการแทรกสอด
	หลายลำแสง
2-7	สเปกตรัมของรังสีเอกซ์
2-8	การจัดอุปกรณ์การวัดความหนาโดยหลักการแผ่รังสี
2-9	การเรื่องรังสีเอกซ์จากฟิล์มบางที่ความหนาต่างกัน
2-1	0 ความสัมพันธ์ของความเข้มรังสึกับความหนาฟิล์ม
2-1	1 ลักษณะการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึก
2-1	2 องค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
2-1	3 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมตัวอย่าง
2-1	4 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับ
	กับตัวอย่างที่ระดับชั้นความลึกต่าง ๆ
2-1	5 การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์เฉพาะตัวโดยใช้ลำอิเล็กตรอน
2-1	6 การเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะตัวที่ระดับพลังงานของชั้นโคจรต่าง ๆ
2-1	7 องค์ประกอบหลักของเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน
2-1	8 ตัวอย่างการวิเคราะห์องก์ประกอบของธาตุทางเคมีด้วยเทคนิก EDS
3-1	ใดอะแกรมและลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศระบบแมกนีตรอน
	สปัตเตอริง
3-2	เครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD)
3-3	เครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
	พร้อม Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-4 เกรื่อง Atomic Force Microscope (AFM)	40
3-5 ผังระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัย	41
3-6 ลักษณะและการติดตั้งกาโทด และพลาสมาจากกาโทดของเกรื่องเกลือบ	42
3-7 ขั้นตอนการถ้างวัสคุรองรับ	43
3-8 ตัวอย่างผลการตรวจวัดองก์ประกอบทางเกมีของฟิล์มด้วยเทกนิก EDS	46
3-9 ตัวอย่างผลการตรวจวัคลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนา	
ของฟิล์มด้วยเทคนิค FE-SEM	46
3-10 ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง	48
3-11 ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสคุรองรับ	49
4-1 ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1 สำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	52
4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุคที่ 1	53
4-3 ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมเมื่อแปรค่าเวลาในการ	
เคลือบ	56
4-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS	
และลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 1	61
4-5 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์มบาง เมื่อใช้ศักย์เร่ง	
อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV	63
4-6 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์มบาง	
เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV	63
4-7 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ	
เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV	65
4-8 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ	
เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV	65
4-9 ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุคที่ 2 สำหรับทคสอบแบบจำลอง	
ทางกณิตศาสตร์	66

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4-10	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุคที่ 2	67
4-11	ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียม	
	เมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ	69
4.12	ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางค้วยเทคนิค EDS	
	และลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุคที่ 2	74

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การปรับปรุงผิวของวัสดุเพื่อให้มีความทนทาน สีสันสวยงาม หรือ รวมถึงมีสมบัติตาม ต้องการเพื่อการใช้ประ โยชน์ในงานอื่น ๆ อาจทำได้หลายวิธี แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การเคลือบผิววัสดุด้วยสารที่เหมาะสมในลักษณะของชั้นเคลือบที่เรียกว่า ฟิล์มบาง (Thin Films) (Wasa & Hayakawa,1992) ทั้งนี้ Bunshah (1994) ให้ความหมายของ ฟิล์มบางว่าหมายถึงชั้นของ อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับตัวรวมกันเป็นของแข็งบาง ๆ บนวัสดุรองรับ โดยการจำแนกชนิด ของฟิล์มยังขึ้นกับลักษณะการใช้งาน โดยฟิล์มบางเป็นการใช้สมบัติเชิงผิว (Surface Properties) แต่ถ้าใช้สมบัติเชิงปริมาตร (Bulk Properties) เรียกฟิล์มนั้นว่า ฟิล์มหนา

การเคลือบผิวของวัสดุในช่วงแรก ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักเลือกใช้การเคลือบด้วย วิธีอิเล็กโตรเพลตติง (Electroplating) เนื่องจากเป็นวิธีเคลือบที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีราคาถูก และสามารถเคลือบชิ้นงานได้จำนวนมากในแต่ละครั้ง แต่การเคลือบวิธีนี้ต้องใช้สารละลายเคมี จำนวนมากซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการวิจัยและพัฒนาการเคลือบใหม่มาทดแทน คือ การเคลือบในสุญญากาศ (Vacuum Deposition) ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจาก เป็นการเคลือบที่เกิดขึ้นในสุญญากาศ และไม่ใช้สารละลายเคมีในกระบวนการเคลือบ ทำให้ไม่เกิด ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญชั้นเคลือบที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าชั้นเคลือบจากวิธีอิเล็กโตรเพลตติงอีก ด้วย โดยวิธีการเคลือบในสุญญากาศที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม คือ การเคลือบด้วยไอกายภาพ (Physical Vapor Deposition; PVD) เนื่องจากการเคลือบวิธีนี้สามารถ ควบคุมการเกิดของชั้นเคลือบได้อย่างแน่นอนเที่ยงตรง ชั้นเคลือบที่ได้มีการยึดติดคี อีกทั้งยัง สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท ทั้งโลหะ อโลหะหรือของผสม (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2551)

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำฟิล์มบางมาประยุกต์ในงานลักษณะต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบบฟิล์มบางชั้นเดียว (Single Layer) หรือ แบบหลายชั้น (Multi-Layer) รวมถึงอาจเป็นฟิล์มบาง ของสารชนิดเดียว (Single Element) อัลลอยด์ (Alloys) หรือสารประกอบ (Compound) ซึ่งขึ้นกับ วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยสมบัติของฟิล์มบางส่วนใหญ่ขึ้นกับลักษณะ เฉพาะที่สำคัญของฟิล์ม เช่น โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ความหนา (Thickness) ความหยาบผิว (Roughness) องค์ประกอบทางเคมี (Elemental Composition) ความหนาแน่น (Density) ความพรุน (Porosity) เป็นต้น ความหนาฟิล์มเป็นลักษณะเฉพาะสำคัญอย่างหนึ่งของฟิล์ม เนื่องจากมีสมบัติของฟิล์ม หลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงหรือแปรไปตามความหนาฟิล์ม เช่น สมบัติการสะท้อนหรือส่งผ่านแสง สมบัติทางกล หรือ สมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ ดังนั้นการเตรียมฟิล์มบางหรือใช้ฟิล์มบาง ความหนาฟิล์ม จึงเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่งที่ต้องศึกษาและควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ Mattox (2010) กล่าวว่า ความหนาของฟิล์มอาจระบุได้ 3 ลักษณะคือ (1) ความหนาเชิงเรขาคณิต (2) ความหนาโดยมวล และ (3) ความหมายโดยสมบัติของฟิล์ม ซึ่ง Berry, Hall and Harris (1968) ได้ให้ความหมายของ ความหนาของฟิล์ม ว่าหมายถึง ระยะที่วัดตั้งฉากจากจุดใด ๆ บนผิวหน้าของฟิล์มหรือขอบด้าน หนึ่ง ผ่านเนื้อฟิล์มไปยังอีกขอบหนึ่งของฟิล์ม ถ้าขอบผิวหน้าฟิล์มที่ต้องการวัดไม่เรียบหรือไม่ ขนาน ความหนาของฟิล์มที่วัดได้อาจมีความกลาดเคลื่อนสูง อย่างไรก็ดิฟิล์มบางที่ได้จากการ เคลือบในสุญญากาศส่วนใหญ่มีผิวหน้าที่ราบเรียบและขนานกันทำให้ไม่มีปัญหาในประเด็นนี้

ทั้งนี้จากความสำคัญของความหนาฟิล์มต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติของฟิล์มบางต่าง ๆ ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาการวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางแสงเทคนิค เชิงกล เทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า และ เทคนิคทางรังสี (Piegari & Masetti, 1985) แต่ละเทคนิค ก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป โดยปัจจัยในการเลือกใช้เทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบางที่ เหมาะสมนั้นขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ชนิดของฟิล์ม ระดับความหนาของฟิล์ม ลักษณะการใช้งาน ความละเอียดที่ต้องการ ปกติแล้วไม่มีเทคนิคการวัดความหนาฟิล์มใดที่ดีที่สุด แต่ขึ้นกับการ ตัดสินใจของผู้ศึกษาเป็นสำคัญ (Pliskin & Zamin, 1970)

เทคนิกการวัดความหนาฟิล์มบางสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่ง American Society for Testing and Materials (1997) ได้แบ่งวิธีการวัดความหนาฟิล์มบางออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) วิธีวัดความหนาแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Methods) เช่น Magnetic Methods, Eddy-Current Methods, X-ray Fluorescence Methods และ Energy Dispersive Spectroscopy Methods (2) วิธีวัดความหนาแบบกึ่งทำลาย (Semi-destructive Methods) เช่น Coulometric Method, Doublebeam Method (3) วิธีวัดความหนาแบบทำลาย (Destructive Methods) เช่น Microscopical Method, Gravimetric Method และ (4) วิธีวัดความหนาด้วยวิธีอื่น เช่น Profilometry, Multiple-beam Method, Microscope อย่างไรก็ดี Echertová (1986) ได้แบ่งการวัดความหนาฟิล์มบางเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) การวัดระหว่างการเคลือบ (*in situ* method) เป็นการวัดความหนาฟิล์มระหว่างการเกลือบ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับใช้การควบคุมความหนาระหว่างการเคลือบฟิล์ม ด้วอย่างการวัดความหนา ฟิล์มระหว่างการเกลือบ เช่น Interferometry หรือ Quartz Balance และ Vibrating Quartz Crystal เป็นต้น การวัดความหนาของฟิล์มบางวิธีนี้ถึงจะให้ก่าที่เที่ยงตรงแม่นยำและมีความละเอียดสูง แต่กี มีน้อเสียที่สำคัญลือ อุปกรณ์และเครื่องมือมีกวามยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานและมีรากาแพงมาก และ (2) การวัดภายหลังการเคลือบ (*ex-situ* Method) เป็นการวัดความหนาฟิล์มที่เคลือบแล้ว วิธีนี้ทำให้ทราบเพียงค่าความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ในการควบคุม ความหนาของฟิล์มที่กำลังเคลือบ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ อย่างไรก็ดีการวัดความหนาของฟิล์ม ด้วยวิธีนี้ก็มีข้อได้เปรียบในด้านราคาของเครื่องมือซึ่งไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับเทคนิคการวัด ความหนาระหว่างการเคลือบ นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ให้ผลหรือค่าความหนาของฟิล์มที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างการวัดความหนาฟิล์มหลังการเคลือบเช่น Micrometers หรือ Profilometer หรือ Atomic Force Microscopy (AFM) หรือ X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) และ X-ray Fluorescence Technique (XRF) เป็นต้น

สำหรับภาลอุตสาหกรรมที่มีการเกลือบเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนั้น ในขั้นดอนของ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความหนาของชั้นเกลือบหรือฟิล์มบางเป็นสิ่งสำคัญและต้อง ถูกตรวจสอบและควบคุมให้มีความสม่ำเสมอสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้คือ การวัดความหนาแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคทางรังสี ทำได้โดยใช้ไอโซโทปรังสีฉายไปยังชิ้นงาน โดยมีหัววัดรังสีอยู่ด้านตรงข้าม ถ้ารังสีที่วัดได้มีค่าสูงแสดงว่ามีชั้นเคลือบมีความหนาน้อย ถ้ารังสีที่ วัดได้มีค่าต่ำแสดงว่ามีชั้นเคลือบมีความหนามาก จุดเด่นของวิธีนี้คือ ไม่มีการสัมผัสกับวัสดุที่วัด ความหนาทำให้สามารถควบคุมความหนาและผลิตชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือ การวัดความหนา ของชั้นเคลือบด้วยเทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence Technique; XRF) (นิรันคร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, และวีระพงส์ จิ๋วประดิษฐ์กุล, 2544) ซึ่งเป็นวิธี ที่เหมาะสำหรับใช้ในการวัดความหนาของฟิล์มในระดับไมโกรเมตร แต่สำหรับกรณีฟิล์มบางที่ เตรียมได้จากการเกลือบด้วยไอกายภาพที่มีความหนาในระดับไมโกรเมตร แต่สำหรับกรณีฟิล์มบางที่ เหมาะ เนื่องจากรังสีเอกซ์ที่ใช้เป็นโพรบ (Probe) ในการวิเคราะห์มีความเข้มสูงมากจนทะลุผ่านชั้น ของฟิล์มบางลงไปถึง วัสคุรองรับทำให้การเรืองรังสีเอกซ์จากฟิล์มมีความเข้มก้อยกว่าการเรือง รังสีเอกซ์จากวัสดุรองรับ ทำให้เทกนิค XRF ไม่เหมาะสำหรับใช้วัดฟิล์มบางที่มีความหนา ในระดับนาโนเมตร

อย่างไรก็ดีการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคทางรังสีเช่นเดียวกับเทคนิค XRF พบว่า การวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy Technique; EDS) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก อิเล็กตรอนที่ใช้เป็นโพรบในการวิเคราะห์ฟิล์มบางของเทคนิค EDS นั้นมีระดับพลังงานที่ไม่สูง จนเกินไปเหมาะสำหรับใช้ในการกระตุ้นให้เกิครังสีเอกซ์จากสารที่มีปริมาณน้อย ๆ (กรณีนี้คือ ฟิล์มบางโลหะที่มีความหนาระคับนาโนเมตร) ที่สำคัญ EDS เป็นอุปกรณ์ที่มิติคตั้งอยู่ในเครื่อง SEM ทั่วไปจึงเหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดความหนาของฟิล์มระดับนาโนเมตรได้

หลักการของเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน อธิบายได้ดังนี้กือ ้เริ่มจากยิ่งลำอิเล็กตรอนไปที่ชิ้นงาน เมื่อลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนกับอิเล็กตรอน ของ Sample ในวงโคจรชั้นในของอะตอม เช่น ชั้น K หรือชั้น L แล้วเกิดการถ่ายโอนพลังงานให้แก่ ้อิเล็กตรอนทำให้มีพลังงานสูงมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นโคจร จนอิเล็กตรอนชั้นในหลุด ้ออกมาจากวงโคจร ทำให้เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในชั้นของวงโคจรนั้น อะตอมที่เสียอิเล็กตรอน ้จะอยู่ในสถานะกระตุ้น (Excited State) จากนั้นอะตอมในสถานะกระตุ้นจะลดระดับพลังงานลงสู่ สถานะพื้น (Ground State) ซึ่งเป็นภาวะปกติอย่างรวคเร็ว โคยอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นถัคออกไป ้จะลดระดับพลังงานลงมาเท่ากับพลังงานยึคเหนี่ยวของวงโคจรที่เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน ด้วยการ ้ปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปของรังสีเอกซ์ แล้วอิเล็กตรอนจากชั้นถัดไปจะเข้ามาแทนที่ในวงโคจร ้ที่ว่างนั้น โดยพลังงานส่วนเกินนี้มีค่าเท่ากับผลต่างของระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะชั้นโคจรของ อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น ๆ เรียกรังสีเอกซ์นี้ว่า รังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ (Characteristic X-Ray) (นิพนธ์ ตั้งคณานุรักษ์ และ คณิตา ตั้งคณานุรักษ์, 2547) สำหรับแนวคิดของการใช้เอกซ์เรย์ ้สเปกโตรสโกปีแบบกระจายพลังงานในการวัคความหนาฟิล์มจะกล้ายกับการวัคกวามหนาด้วย เทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ กล่าว คือความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่วัคได้จะสัมพันธ์กับ ้ปริมาณอะตอมของธาตุในเนื้อฟิล์ม คังนั้นถ้าฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้น (อะตอมของธาตุในเนื้อฟิล์ม มากขึ้น) ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่วัดได้จากฟิล์มก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (นิรันคร์ ้วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, และวีระพงศ์ จิ๋วประคิษฐ์กุล, 2544)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวัดความหนาฟิล์มบางที่มีความหนาในระดับนาโนเมตรด้วย เทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน โดยในงานวิจัยนี้ฟิล์มบางตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือฟิล์มบางโลหะโครเมียมที่มีความหนาระดับนาโนเมตร ซึ่งเตรียมด้วยวิธีสปัตเตอริงแล้วนำไป วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD วัดความหนาจากเทคนิค FE-SEM สำหรับใช้เป็นค่า อ้างอิง จากนั้นนำฟิล์มบางตัวอย่างที่ทราบความหนาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS เพื่อให้ได้ความ เข้มของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งจะนำ ข้อมูลข้างต้นมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ของค่าความเข้มของ รังสีเอกซ์ลักษะเฉพาะกับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่าง สุดท้ายเป็นการทดสอบแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วยฟิล์มบางชุดที่ใช้สำหรับทดสอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเตรียมฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคสปัตเตอริง

 เพื่อพัฒนาเทกนิกการวัดกวามหนาของฟิล์มบางโลหะด้วยเทกนิกเอกซ์เรย์สเปกโตร สโกปีแบบกระจายพลังงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ทำให้ทราบขั้นตอนและกระบวนการเตรียมฟิล์มบาง ตั้งแต่การเคลือบฟิล์มบาง ขั้นตอน การเคลือบ การวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS , FE-SEM ตลอดจนการวัดความหนาด้วย เทคนิค EDS

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคนิกการวัดความหนาด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปกโตรสโกปี แบบกระจายพลังงาน เพื่อใช้วัดความหนาของฟิล์มบางโลหะที่เตรียมจากเทคนิคสปัตเตอริงที่มี ความหนาในระดับนาโนเมตร การสร้างสมการความสัมพันธ์ของความเข้มรังสีเอกซ์เฉพาะตัวกับ กวามหนาของฟิล์มเพื่อใช้ทำนายความหนาฟิล์ม จากนั้นเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มที่ได้จาก เทกนิก EDS กับความหนาของฟิล์มที่ได้จากเทกนิก FE-SEM

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ

การเคลือบฟิล์มบาง คือ การเรียงตัว (Fabricated) จากการทับถม (Deposition) ของ สารเคลือบบนวัสดุรองรับ (Substrate) จนเกิดเป็นชั้นของฟิล์มที่บางมาก ในระดับนาโนเมตร ทั้งนี้ อาจกล่าวว่า "ฟิล์มบาง (Thin Film) หมายถึง ชั้นหรือกลุ่มของอะตอมที่รวมกันบนผิววัสดุรองรับ" การระบุว่าฟิล์มใดเป็น "ฟิล์มบาง" อาจพิจารณาจากรูปแบบการใช้งาน โดยถ้าใช้สมบัติเชิงผิว (Surface Properties) ให้เรียกว่า "ฟิล์มบาง" แต่ถ้าใช้สมบัติเชิงบัลก์ (Bulk Properties) ให้เรียกว่า "ฟิล์มหนา" (Bunshah, 1994) ปัจจุบันมีการนำฟิล์มบางมาใช้งานด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น งานด้านทัศนศาสตร์ งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเคลือบฟิล์มในสุญญากาศอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม (Wasa & Hayakawa, 1992) (ภาพที่ 2-1) ได้แก่

 การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เป็นการเคลือบที่ อาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพของแก๊สและเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารใหม่ (New Species) ตกเคลือบบนวัสดุรองรับ เช่น วิธี plasma CVD และ วิธี laser CVD เป็นต้น

2. การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ (Physical Process) เป็นการเคลือบที่ อาศัยการทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกจากผิวแล้วฟุ้งกระจายหรือวิ่งเข้าไปจับและยึดติดกับ ผิวของวัสดุรองรับ เช่น วิธีระเหยสาร (Evaporation) และ วิธีสปัตเตอริง (Sputtering) เป็นต้น



ภาพที่ 2-1 ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ (Wasa & Hayakawa, 1992)

Wasa and Hayakawa (1992) กล่าวว่าการเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ เป็นกระบวนการที่อาศัยการทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกจากผิวแล้วฟุ้งกระจายวิ่งไปจับ และยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับแล้วพอกพูนเป็นชั้นของฟิล์มภายใต้สุญญากาศ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. การเคลือบด้วยวิธีระเหยสาร เป็นกระบวนการพอกพูนของชั้นฟิล์มของสารเคลือบที่

ทำให้ระเหยซึ่งเกิดขึ้นในสุญญากาศ (ความคันประมาณ 10⁻⁶ mbar) ทำได้โดยการให้ความร้อนที่ มากพอที่จะทำให้สารเคลือบกลายเป็นไอ ซึ่งไอของสารเคลือบนี้จะฟุ้งไปกระทบกับวัสดุรองรับที่มี อุณหภูมิเหมาะสมก็จะเกิดการควบแน่นของสารเคลือบและพอกพูนโตเป็นชั้นของฟิล์มบางต่อไป การให้ความร้อนในการระเหยสารเคลือบทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้และไม่ยุ่งยากคือการให้ ความร้อนแก่ภาชนะบรรจุสารเคลือบด้วยวิธีทางไฟฟ้า ข้อเสียของวิธีนี้คือแรงยึดติดของสารเคลือบ และวัตถุรองรับจะไม่สูงนักจึงต้องอาศัยกระบวนการอบด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นช่วยให้การยึด เกาะของสารเคลือบดีขึ้น นอกจากนี้ฟิล์มบางที่ได้อาจมีการปนเปื้อนของสารที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ สารเคลือบได้ ถ้าภาชนะบรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่ำหรือใกล้เคียงกับสารเคลือบ

2. การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง เป็นกระบวนการพอกพูนของชั้นฟิล์มของสารเคลือบที่ ได้จากกระบวนการสปัตเตอริง (ความคันประมาณ 10⁻³ ถึง 10⁻¹ mbar) การเคลือบด้วยวิธีนี้เกิดขึ้น เมื่ออะตอมของสารเคลือบที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอริงวิ่งเข้าชนวัสคุรองรับและมีการพอกพูน เป็นฟิล์มบางในที่สุด สารเคลือบจากกระบวนการสปัตเตอริงมีพลังงานสูงมาก ดังนั้นเมื่ออะตอม ของสารเคลือบกระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวแน่นลงในเนื้อวัตถุที่ต้องการเคลือบทำให้การยึด เกาะระหว่างสารเคลือบกับวัตถุรองรับดีมาก

Smith (1995) ได้อธิบายกระบวนการพื้นฐานของการเคลือบฟิล์มบางว่ามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างสารเคลือบ (Source) สารเคลือบอาจอยู่ในรูป ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ก็ได้ แต่ขณะเคลือบต้องอยู่ในรูปของไอระเหยเท่านั้น ซึ่งวิธีการที่ทำให้สารเคลือบกลายเป็น ไอระเหยทำได้หลายวิธี เช่น การให้ความร้อนหรือการระคมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานสูง เป็นต้น

 การเคลื่อนย้ายสารเคลือบมายังวัสดุรองรับ (Transport) ในภาวะสุญญากาศ ใอระเหยของสารเคลือบอาจจะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ไปยังวัสดุรองรับ หรืออาจจะเคลื่อนที่ไป ในลักษณะของไหล ซึ่งจะทำให้ไอระเหยของสารเคลือบมีการชนกับอนุภาคอื่นภายในภาชนะ สุญญากาศ นอกจากนี้ไอระเหยอาจจะเคลื่อนที่ไปยังวัสดุรองรับในลักษณะของพลาสมากีได้

 การทับถม (Deposition) เป็นขั้นตอนการพอกพูนของสารเคลือบและ โตขึ้นจน กลายเป็นชั้นของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขของวัสดุรองรับ พลังงานที่ใช้ในการ เคลือบ หรือการทำปฏิกิริยาของสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ตลอดจนความสะอาดของผิววัสดุรองรับ

การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง

การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง เป็นกระบวนการสะสมพอกพูนของอะตอมสารเคลือบ ที่ได้จากการสปัตเตอร์ (Sputter) บนผิวหน้าของวัสดุรองรับซึ่งรวมตัวและ โตเป็นฟิล์มบางในที่สุด ทั้งนี้การสปัตเตอร์เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและ โมเมนตัมระหว่างอนุภาคพลังงานสูง ที่วิ่งเข้าชนอะตอมที่ผิวสารเคลือบ จนทำให้อะตอมที่ผิวหน้าของเป้าสารเคลือบหลุดออกมา ทั้งนี้อะตอมของสารเคลือบที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอร์จะมีพลังงานสูงจึงทำให้การยึดติดของ ฟิล์มกับวัสดุรองรับดีมาก (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ, 2547; Chapman, 1980)

สำหรับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสปัตเตอริง โดยสรุปมีดังนี้

 อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวของวัสดุ เมื่อไอออนวิ่งชนผิวหน้าของวัสดุจะ เกิดปรากฏการณ์ดังแสดงในภาพที่ 2-2 ดังนี้ (Chapman, 1980)

1.1 การสะท้อนของไอออนที่ผิวหน้าของวัสดุ (Reflected Ion and Neutral) ไอออน อาจสะท้อนกลับจากผิวหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในรูปของอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า อันเกิดจากการรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่ผิวเป้าสารเคลือบ

 1.2 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สอง (Secondary Electron Emission) จากการชน ของไอออนอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สองจากเป้าสารเกลือบถ้าไอออนนั้นมี พลังงานสูงเพียงพอ

1.3 การฝังตัวของไอออน (Ion Implantation) ไอออนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบนั้นอาจ ฝังตัวลงในสารเคลือบ โดยความลึกของการฝังตัวจะแปรผันโดยตรงกับพลังงานไอออน สำหรับ ไอออนของแก๊สอาร์กอนที่ฝังตัวในทองแดง มีก่า 10 อังสตรอม/ พลังงานไอออน 1 keV

 1.4 การเปลี่ยนโครงสร้างของผิวสารเคลือบ (Target Material Structural Rearrangements) การชนของไอออนบนผิวสารเคลือบทำให้เกิดการเรียงตัวของอะตอมที่ผิว สารเคลือบใหม่และเกิดความบกพร่องของผลึก (Lattice Defect) โดยเรียกการจัดตัวใหม่ของ โครงสร้างผิวหน้านี้ว่า Altered Surface Layer

 1.5 การสป์ตเตอร์ (Sputter) การชนของไอออนอาจทำให้เกิดกระบวนการชนกัน แบบต่อเนื่องระหว่างอะตอมของเป้าอันทำให้เกิดการปลดปล่อยอะตอมจากเป้าสารเคลือบ ซึ่งเรียกว่ากระบวนการสป์ตเตอริง



ภาพที่ 2-2 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิววัสคุ (Chapman, 1980)

 กระบวนการสป์ตเตอริง เป็นกระบวนการที่อะตอมผิวหน้าของวัสดุถูกทำให้หลุด ออกมาด้วยการชนของอนุภาคพลังงานสูง โดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและ โมเมนตัมระหว่าง อนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอะตอมที่ผิววัสดุดังกล่าว (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ, 2547; Chapman, 1980) กระบวนการนี้อนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมีประจุก็ได้ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นในกระบวนการสป์ตเตอริง คือ

2.1 เป้าสารเคลือบ ทำหน้าที่เป็นเป้าสำหรับให้อนุภาคพลังงานสูงวิ่งเข้าชนจนมี การปลคปล่อยอะตอมของสารเคลือบลงเคลือบบนวัสคุรองรับ

2.2 อนุภาคพลังงานสูง ทำหน้าที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบเพื่อให้อะตอมเป้าสารเคลือบ หลุดออกมา ปกติอนุภาคพลังงานสูงนี้อาจเป็นกลางทางไฟฟ้า เช่น นิวตรอน หรืออะตอมของธาตุ ต่าง ๆ แต่การทำให้อนุภาคที่เป็นกลางมีพลังงานสูงเกิน 10 eV เพื่อใช้ในกระบวนการสปัตเตอริงทำ ได้ก่อนข้างยาก วิธีการหนึ่งที่นิยมคือการเร่งอนุภาคประจุภายใต้สนามไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบคุม ระดับพลังงานไอออนตามต้องการ อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุชนิดหนึ่งที่ผลิตได้ง่ายและ สามารถเร่งให้มีพลังงานสูงภายใต้สนามไฟฟ้าได้ แต่อิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าอะตอมของสาร เคลือบมากทำให้การถ่ายเทพลังงานและ โมเมนตัมต่ออะตอมสารเคลือบนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มี ประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้กระบวนการสปัตเตอริงเกิดขึ้นได้ ตามทฤษฎีทางฟิสิกส์การชน กันระหว่าง 2 อนุภาคที่มีการส่งถ่ายพลังงานและโมเมนตัมดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อมวลของอนุภาค ทั้งสองมีก่าเท่ากัน ดังนั้นเราจึงเลือกการเร่งไอออนของแก๊สในสนามไฟฟ้าเป็นอนุภาควิ่งชนเป้า สารเกลือบซึ่งให้อัตราการปลดปล่อยเป้าสารเกลือบสูงเพียงพอกับความต้องการ

2.3 การผลิตอนุภาคพลังงานสูง อนุภาคพลังงานสูงในระบบสป์ตเตอริงนี้จะต้องถูก ผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการเคลือบสารเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนได้ความหนา ฟิล์มบางตามต้องการ ทั้งนี้สามารถทำได้หลายวิชี เช่นการใช้ลำอนุภาคจากปืนไอออนที่มีปริมาณ การผลิตไอออนในอัตราสูงหรือผลิตจากกระบวนการโกลว์ดิสชาร์จ เนื่องจากปืนไอออนมีราคา ด่อนข้างสูงและให้ไอออนในพื้นที่แคบ กระบวนการสปัตเตอริงทั่วไปในระดับอุตสาหกรรมจึง นิยมใช้กระบวนการโกลว์ดิสชาร์จในการผลิตอนุภาคพลังงานสูง

3. ค่ายีลด์ของสปัตเตอริง (Sputtering Yield: S) คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณการหลุดของอะตอม เป้าสารเคลือบต่อปริมาณการชนของไอออน 1 อนุภาค มีหน่วยเป็น อะตอมต่อไอออน โดยการวัด ก่ายีลด์นี้ สามารถทำได้โดยการหาน้ำหนักหรือความหนาที่ลดลงของเป้าสารเคลือบ หรือหาได้จาก วัสดุทั้งหมดที่ถูกสป์ตเตอร์ หรืออาจหาได้จากการตรวจวัดสป์ตเตอร์อะตอม (Sputter Atom) ขณะที่ ยังฟุ้งกระจาย (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ, 2547) ค่ายีลด์ของกระบวนการสป์ตเตอริง จะเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

3.1 เปลี่ยนแปลงตามพลังงานไอออน ค่ายืลด์จากกระบวนการสบัตเตอริง จะมีค่าเป็น ศูนย์ เมื่อพลังงานไอออนมีค่าต่ำมาก เนื่องจากน้อยกว่าแรงยึดเกาะระหว่างอะตอมบนเป้าสาร เกลือบได้ เมื่อไอออนมีพลังงานสูงกว่า 4 H (H คือค่าพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ในการระเหิด 1 อะตอม จาก ผิวสารเกลือบ) ถ้าพลังงานไอออนสูงมากพอทำให้เกิดการชนอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มมีการปลดปล่อย อะตอมสารเกลือบ เรียกพลังงานก่านี้ว่า พลังงานขีดเริ่ม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกู่การชนของอนุภาค

3.2 เปลี่ยนแปลงตามระนาบผลึกของผิวเป้าสารเคลือบ จากการทดลองพบว่า เมื่อใช้เป้าสารเคลือบที่เป็นผลึกเดี่ยวค่ายีลด์จะมีก่ามากที่สุดเมื่อไอออนชนเป้าในแนวระนาบที่มี อะตอมหนาแน่นที่สุด และมีก่าต่ำในระนาบที่มีอะตอมเบาบาง

3.3 เปลี่ยนแปลงตามชนิดของไอออนที่ชนเป้าสารเคลือบ ค่ายิลด์จากเป้าสารเคลือบ ชนิดเดียวกัน เมื่อใช้ไอออนต่างชนิดกันวิ่งชนจะมีค่าแตกต่างกันออกไป โดยไอออนที่เหมาะสม คือไอออนจากแก๊สเฉื่อย ได้แก่ แก๊ส Ne, Ar, Kr, และ Xe ซึ่งเป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนครบ 8 ในวงนอกสุด

3.4 เปลี่ยนแปลงตามมุมตกกระทบของไอออนบนเป้าสารเคลือบ จากการทคลอง พบว่าเมื่อเพิ่มมุมเอียงของการชนจากไอออนบนเป้ามากขึ้นยิลค์จะมีค่าสูงขึ้นตามมุมที่เอียง

ระบบเคลือบแบบดีซีสปัตเตอริง

ภาพที่ 2-3 แสดงระบบเกลือบฟิล์มบางแบบดีซีสป์ดเตอริงอย่างง่าย (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ, 2547; Bunshah, 1994; Smith, 1995) ซึ่งประกอบด้วยแกโทด คือ แผ่นเป้าสาร เกลือบและแอโนด คือ ที่วางวัสดุรองรับหรือชิ้นงานที่ด้องการเกลือบ ปกติระยะระหว่างแกโทด และวัสดุรองรับจะอยู่ระหว่าง 4 - 10 cm เพื่อป้องกันการสูญเสียอะตอมสารเกลือบที่ผนังของ ภาชนะสุญญากาศ โดยทั่วไประยะคาร์กสเปซ อยู่ระหว่าง 1 - 4 cm โดยแอโนดจะอยู่บริเวณเนกา ทีฟโกล์ว ส่วนอุปกรณ์ทำงานจะอยู่ในช่วงแอบนอร์มอลโกล์วดิสชาร์จ แก๊สที่ใช้เป็นแก๊สเลื่อยซึ่ง ให้ยีลด์สูงและไม่ทำปฏิกริยากับสารเกลือบ (ปกติใช้แก๊สอาร์กอน) ขณะเกิดโกล์วดิสชาร์จที่กวาม ดันค่าหนึ่ง กระบวนการไอออไนเชชั่นจะรักษาสภาพโกล์วดิสชาร์จไว้ตราบที่ระยะคาร์กสเป ชไม่มากกว่า ระยะระหว่างแกโทดและแอโนด เมื่อความดันลดลงหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่าง อิเล็กโตรดสูงขึ้น ระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนจะสูงขึ้น ทำให้ระยะคาร์กสเปชขยายตัวออก และแหล่งผลิตไอออนในระบบมีปริมาตรน้อยกระแสลดลงและอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์มีปริมาณ ลดลงตามปริมาณของไอออนและกระแสไฟฟ้าในระบบ ที่กวามดันด่ำกว่า 10⁻² mbar ระยะ คาร์กสเปชจะยาวกว่าระยะระหว่างอิเล็กโทรด และกระแสไฟฟ้าลดลงสู่สูนย์ ทำให้กระบวนการ ผลิตไอออนสิ้นสุดลงและไม่มีอะตอมหลุดออกจากเป้าสารเกลือบเนื่องจากการสปัตเตอร์อีก



ภาพที่ 2-3 ระบบเคลือบแบบคีซีสปัตเตอริงอย่างง่าย (Bunshah, 1994)



ภาพที่ 2-4 ผลของความคันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายีลด์และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปัตเตอริงของนิเกิลที่ใช้แรงคันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด์ ที่วางห่างกัน 4.5 cm (Vossen & Kerns, 1978)

ขณะที่ความดันสูงขึ้นระยะคาร์คสเปซจะสั้นลงบริเวณการผลิตไอออนมีปริมาตรสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้นและการสปัตเตอริงเกิดขึ้นในอัตราสูงตามความดัน ดังภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ A ขณะที่ความดันในระบบสูงขึ้นระยะปลอดการชนระหว่างโมเลกุลของแก๊สมีค่าลดลง อะตอมสารเคลือบที่หลุดออกจากเป้าจะส่งผ่านเคลือบบนวัสดุรองรับได้ยากจากการชนกับโมเลกุล ของแก๊สและสะท้อนกลับสู่เป้าสารเคลือบหรือสูญเสียสู่ผนังภาชนะสุญญากาศทำให้ค่าของยีลด์ จากการสปัตเตอร์มีค่าลดลง แต่เมื่อความดันสูงขึ้น (ภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ B) ผลรวมระหว่างยีลด์ จากการสปัตเตอร์มีค่าลดลง แต่เมื่อความดันสูงขึ้น (ภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ B) ผลรวมระหว่างยีลด์ และกระแสไอออนทำให้อัตราเคลือบมีค่าสูงสุดที่ความดันก่าหนึ่ง ทั้งนี้พบว่าการสปัตเตอร์นิเกิล เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดที่ห่างกัน 4.5 cm ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน การเคลือบจะหยุดที่ความดันต่ำกว่า 2.6 × 10⁴ mbar และที่ความดันสูงกว่า 1.6 × 10⁵ mbar โดย อัตราเคลือบมีค่าสูงสุดและลดลงเมื่อความดันสูงเกินค่านี้ ดังนั้นบริเวณที่เหมาะกับกระบวนการ สปัตเตอริงคือบริเวณที่ให้อัตราเคลือบสูงและประสิทธิภาพดีที่สุด พบว่าความดันที่เหมาะสม สำหรับการเคลือบมือ 1.0 × 10⁵ mbar โดยใช้ความหนาแน่นกระแสประมาณ 1.0 mA/ cm² ด้วยอัตราเกลือบ 0.036 µm/min ซึ่งเป็นอัตราเคลือบที่ค่อนข้างต่ำขณะที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง (พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ, 2547)

ความหนาและการวัดความหนาฟิล์ม

ความหนาฟิล์ม หมายถึง ระยะที่วัดตั้งฉากจากจุดใด ๆ บนผิวหน้าของฟิล์มบางหรือ ขอบด้านหนึ่งของฟิล์ม ผ่านเนื้อฟิล์มไปยังอีกขอบหนึ่งของฟิล์ม ถ้าขอบของผิวหน้าฟิล์มที่ต้องการ วัดไม่เรียบหรือไม่ขนาน ความหนาของฟิล์มที่วัดได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง อย่างไรก็ดีฟิล์มบาง ที่ได้จากการเคลือบในสุญญากาศส่วนใหญ่มีผิวหน้าที่ราบเรียบและขนานกันทำให้ไม่มีปัญหาใน ประเด็นนี้ (Berry, Hall, & Harris, 1968)

ทั้งนี้จากความสำคัญของความหนาของฟิล์มมีผลต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติของฟิล์ม ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาการวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิกต่าง ๆ ขึ้นเช่น เทคนิคทางแสง เทคนิคเชิงกล เทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า และ เทคนิคทางรังสี (Piegari & Masetti, 1985) ซึ่งแต่ละ เทคนิคมีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไป โดยปัจจัยในการเลือกใช้เทคนิคการวัดความหนาที่เหมาะสมนั้น ขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ชนิดของฟิล์ม ระดับความหนาของฟิล์ม ลักษณะการใช้งาน ความละเอียด ที่ต้องการ ปกติแล้วไม่มีเทคนิคการวัดความหนาฟิล์มใดที่ดีที่สุด แต่ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ศึกษา เป็นสำคัญ (Pliskin & Zamin, 1970)

Mattox (2010) กล่าวว่าความหนาของฟิล์มอาจระบุได้จาก 3 ลักษณะดังนี้กือ

 ความหนาเชิงเรขาคณิต (Geometrical Thickness) วิธีนี้วัดในหน่วย มิลลิเมตร หรือ นิ้ว หรือ นาโนเมตร หรือ อังสตรอม วิธีนี้ไม่ต้องใช้สมบัติต่าง ๆ ของฟิล์ม ทั้งองค์ประกอบ ความหนาแน่น และ โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม แต่จำเป็นต้องระบุผิวหน้าฟิล์ม ลักษณะผิวและ รอยต่อของฟิล์มอย่างแม่นยำ ที่สำคัญลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเป็นปัจจัยสำคัญในการวัคความหนา

 ความหนาโดยมวล (Mass Thickness) วิธีนี้วัดในหน่วย กรัมต่อตารางเซนติเมตร และ สามารถแปลงเป็นความหนาเชิงเรขาคณิตได้ถ้าหากทราบความหนาแน่นของสารเคลือบ โดยวิธีนี้ ไม่จำเป็นต้องทราบ องค์ประกอบ ความหนาแน่น และ โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม รวมถึงลักษณะ พื้นผิวของฟิล์มก็ไม่ปัจจัยสำคัญในการวัดความหนา

3. ความหนาโดยสมบัติของฟิล์ม (Property Thickness) วิธีนี้อาศัยแนวที่คิดว่าสมบัติ บางประการของฟิล์มเปลี่ยนแปลงไปตามความหนาฟิล์ม ด้วอย่างของการวัดความหนาด้วยวิธีนี้ เช่น การวัดโดยการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption) หรือ การเรืองรังสีเอกซ์ หรือ การสะท้อน กลับของอิเล็กตรอน (Electron Backscatter) หรือ การสะท้อนกลับของไอออน (Ion Backscatter) โดยปริมาณต่าง ๆ ที่วัดจากจากสมบัติของฟิล์มเหล่านี้สามารถแปลงเป็นความหนาเชิงเรขาคณิตได้ หากทราบความสัมพันธ์ของความหนาและสมบัติของฟิล์ม ซึ่งปกติด้องสร้างกราฟปรับเทียบเพื่อใช้ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของกวามหนาและสมบัติฟิล์ม วิธีนี้เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ องค์ประกอบ กวามหนาแน่น และ โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแล้ว เทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบาง อาจแบ่งเป็นหลายเทคนิค หลายวิชี แต่ละวิชีก็มีข้อดี-ข้อเสีย ที่ต่างกัน ซึ่ง American Society for Testing and Materials (1997) ได้แบ่งวิชีการวัดความหนาของฟิล์มบางออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

 การวัดความหนาฟิล์มแบบไม่ทำลาย เช่น Magnetic Methods, Eddy-Current Methods, X-ray Fluorescence Methods และ Energy Dispersive Spectroscopy Methods

 การวัดความหนาฟิล์มแบบกึ่งทำลาย เช่น Coulometric Method, Double-beam Method

3. การวัดความหนาฟิล์มแบบทำลาย เช่น Microscopical Method, Gravimetric Method

 การวัดความหนาฟิล์มด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น Profilometry, Multiple-beam Method, Microscope

อย่างไรก็คี Echertová (1986) ได้สรุปการวัดความหนาของฟิล์มบางออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ การวัดระหว่างการเคลือบ (*in situ* method) และ การวัดภายหลังการเคลือบ (*ex-situ* Method) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การวัดระหว่างการเคลือบ วิธีนี้เป็นการวัดความหนาของฟิล์มบางระหว่างการเคลือบ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับฟิล์มบางในกลุ่มที่สมบัติของฟิล์มไวต่อเปลี่ยนแปลงตามความหนา วิธีนี้ใช้ การควบคุมความหนาระหว่างการเคลือบฟิล์ม ตัวอย่าง การวัดความหนาฟิล์มระหว่างการเคลือบ เช่น Interferometry หรือ Quartz Balance และ Vibrating Quartz Crystal เป็นต้น การวัดความหนา ของฟิล์มบางวิธีนี้ถึงจะให้ค่าที่เที่ยงตรงแม่นยำและมีความละเอียคสูง แต่ข้อเสียสำคัญคือ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีราคาแพงมาก

2. การวัดภายหลังการเคลือบ เป็นการวัดความหนาฟิล์มที่เคลือบแล้ว วิธีนี้ทำให้ทราบ เพียงค่าความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ในการควบคุม ความหนาของฟิล์มที่ กำลังเคลือบ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ อย่างไรก็ดีการวัดความหนาของฟิล์มด้วยวิธีนี้ก็มีข้อได้เปรียบ ในด้านราคาของเครื่องมือซึ่งไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับเทคนิคการวัดความหนาระหว่างการเคลือบ นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ก่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ให้ผลหรือค่าความหนาของ ฟิล์มที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างการวัดความหนาฟิล์มหลังการเคลือบเช่น Profilometer หรือ Atomic Force Microscopy (AFM) หรือ X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) และ Micrometers เป็นด้น Berry, Hall, and Harris (1968) ได้สรุปวิธีวัดความหนาฟิล์มบางแบบวัดหลังการเคลือบ ของฟิล์มที่เตรียมจากกระบวนการเคลือบในสุญญากาศที่นิยมใช้ในปัจจุบันพบว่ามี 5 วิธีดังนี้คือ

 การวัดความหนาด้วยวิธีชั่งมวล (Weighing) การวัดความหนาฟิล์มวิธีนี้อาศัยแนวคิด ว่าความหนาของฟิล์มจะแปรผันตรงกับมวลของฟิล์มที่เคลือบบนผิววัสดุ วิธีนี้ทำได้โดยชั่งมวลของ วัสดุรองรับก่อนและหลังการเคลือบ และผลต่างของมวลก่อนและหลังเคลือบจะมีค่าเท่ากับมวล ของฟิล์มบนผิววัสดุ โดยความหนาฟิล์มเป็นไปตามสมการ d = m / (A ρ) เมื่อ d คือความหนาฟิล์ม m คือมวลของฟิล์ม A คือพื้นที่ของฟิล์ม และ ρ คือความหนาแน่นสารที่เคลือบ โดยมวลที่จะนำมา ทดสอบต้องมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน ±2 μg โดยต้องทำหลังจากการวัดโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกัน การทำปฏิกิริยากับน้ำและอากาศเป็นผลทำให้มวลของฟิล์มที่ชั่งได้มีค่าไม่ถูกต้อง การวัดความหนา ด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับฟิล์มที่ทำการเคลือบสารเพียงชนิดเดียวบนวัสดุรองรับ ความหนาจะได้จาก อัตราส่วนของมวลต่อพื้นที่ถูณกับความหนาแน่นของสารเคลือบ ดังนั้นความหนาจะขึ้นอยู่กับความ หนาแน่นของสารแต่ละชนิดด้วยถึงแม้ว่าการวัดจะใช้พื้นที่และชั่งมวลได้เท่ากัน ความหนาที่ได้จะ ไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นหรือชนิดของสารเคลือบด้วย

2. การวัดความหนาด้วยสไตลัส (Stylus) เป็นการวัดด้วยอาศัยการเคลื่อนที่ของสไตลัส ผ่านฟิล์มกับวัสดุรองรับที่เป็นขั้นบันใด (Step) การวัดเริ่มจากเลื่อนหัวของสไตลัสที่ทำมาจากเพชร ในแนวดิ่งลงมาติดกับชิ้นงาน จากนั้นจึงเลื่อนหัววัดไปตามแนวราบด้วยแรงคงที่ค่าหนึ่ง จากนั้นนำ ค่าแรงที่ได้จากการเลื่อนหัวของสไตลัส ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงขอบของฟิล์มและวัสดุรองรับ ไปแปลงเป็นสัญญาณลากเส้นกราฟบนกระดาษ จะได้ความสูงของขั้นบันได ฟิล์มซึ่งเป็นความหนา ของฟิล์มนั่นเอง (ภาพที่ 2-5)



ภาพที่ 2-5 แนวกิดของการวัดกวามหนาด้วยสไตลัส (Pliskin & Zamin, 1970)

3. การวัดความหนาด้วยการแทรกสอดหลายลำแสง (Multiple Beam Interferometry) วิธีนี้อาศัยหลักการสะท้อนแสงหลายครั้งระหว่างผิวหน้าของฟิล์มและวัสดุรองรับ ความเข้มที่ได้ จากการสะท้อนตัวเครื่องจะนำไปสร้างขอบที่เป็นไปได้ ได้ความแตกต่างของขอบทำให้ได้ความ หนาของฟิล์มออกมา ส่วนขั้นตอนที่ทำให้เกิดระยะขอบ คือ ขั้นบันไดระหว่างผิวหน้าฟิล์มกับ วัสดุรองรับ โดยผิวหน้าฟิล์มต้องถูกเคลือบด้วยฟิล์มสะท้อนแสงสูงอีกชั้นส่วนใหญ่ชั้นฟิล์มเงิน เป็นตัวสะท้อนแสง แล้วนำมาวางเหนือชิ้นงาน โดยมีมุมเอียงเล็กน้อยกับชิ้นงาน ใช้ลำแสงเดี่ยวฉาย ไปที่ชิ้นงานขอบของฟิล์มก็จะแสดงให้เห็นเมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรสน์ ระยะระหว่างขอบและ ขั้นบันไดจะถูกวัดและคำนวณออกมาอยู่ในรูปความหนาของฟิล์มได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดด้วย วิธีนี้กือ ฟิล์มที่นำมาวัดต้องมีขอบของขั้นบันไดที่ชัดเจนและการสะท้อนสูง บนพื้นที่ขนาดเล็ก มีการดูดซับต่ำ วัสดุรองรับและฟิล์มด้องมีความเรียบและสม่ำเสมอ มุมที่ใช้ในการวัดคือ 1°-3° แสงที่นำมาใช้ในการวัดต้องเป็นแสงเดี่ยวที่สะท้อนได้ดี (ภาพที่ 2-6)



ภาพที่ 2-6 ใดอะแกรมการวัดความหนาด้วยเทคนิคการแทรกสอดหลายลำแสง (Ohring, 2002)

4. การวัดความหนาด้วยเทคนิกการสะท้อนกลับของอนุภาคอัลฟา (Beta Particle Back-Scattering) เกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิถ่าย โอนพลังงานแก่อะตอมของตัวอย่าง เมื่ออิเล็กตรอน ใด้รับพลังงานสูงกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอม อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกจากอะตอมกลายเป็น อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron, SE) สัญญาณนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาลักษณะพื้นผิว ของตัวอย่าง โดย โอกาสการเกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิและอิเล็กตรอนกระเจิงกลับขึ้นกับเลขอะตอม ของตัวอย่าง โดย โอกาสการเกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิและอิเล็กตรอนกระเจิงกลับขึ้นกับเลขอะตอม ของราตุ ถ้าเลขอะตอมสูงขึ้นเราสามารถนับอนุภาคที่กระเจิงจากฟิล์มแล้วแปรท่าเป็นความหนาของ ฟิล์มได้ โดยสามารถวัดได้ทั้งฟิล์มชั้นเดียวและหลายชั้น ทั้งนี้ โอกาสการเกิดสัญญาณอิเล็กตรอน ทุติยภูมิขึ้นกับความลึกที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิสามารถเคลื่อนผ่านไปในตัวอย่าง ซึ่งถ้าความลึกกรอน ทุติยภูมิขึ้นกับความลึกที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิสามารถเคลื่อนผ่านไปในตัวอย่าง ซึ่งถ้าความลึกของ อิเล็กตรอน บุฐิยภูมิที่หลุดออกมาจากตัวอย่างส่วนใหญ่จะออกมาจากบริเวณผิวของตัวอย่าง ทั้งนี้อริบายได้จาก สัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่หลุดออกมาจากตัวอย่างส่วนใหญ่จะออกมาจากบริเวณผิวของตัวอย่าง ทั้งนี้อริบายได้จาก สัญญาณอิเล็กรอนทุมภูมิเป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนปฐมภูมิลงไป กระตุ้นอะตอมของตัวอย่างในบริเวณลึกจากผิวต่อย่าง โอกาสที่อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะหลุดออกมา จากชั้นความลึกนั้นมีน้อยแพราะสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิจะถูกดูดกลึนโดยอะตอมบนผิวก่อนที่ จาก สัญญาณอิเล็กตรอยทุลอย่างไม้อิเล็กตรอนทุติอยามาจากชั่วอย่างในบริเวณลึกจากผิวต่อยางโอกาสที่อิเล็กตรอนทุติอยามาจากชั่น อิเล็กตรออนทุตอออทมา จากชั่น อิเล็กตรออนทุติกาลากติวอยางในกริกากชิ้นต้าวมารถาดท่า ด้าดร้ายางโอกาสที่ออยามาจากต่าวอยางากามาติกากมากากมีกากมิวอามาจากบริเลตสุกงามที่มีพลงงานต่าดามาจากชางิมิสักตรอนทุติมูมิจะหลุดออกมา จากชั่นลามาลึกนั้นอยางามาลิกจากผิวตัวอยางโล็กจากมามากรถามถึงนุนที่ไปกรามที่ อิเลกตออมกจามาจากชั่นที่มามามากัดวอยางางากากาลากดิออกกากจากทิจามาจากที่อิเลกตออมทุดอามาจากชั่นมามามีกากามาสถิกจากทิจากทิจามาที่อามาทิจามาจากลากมาจากสากจอมาจากทิจากทิจออกมาจากสาทิจอมาจากจากทิจากจามาที่จามาทามาสากจามาลากจามาจากจากจอกาลากจามาทามาที่ามาทามากจามาสาทิจอลากจอมาจากจอมาจากจามาจามาจามาท

5. การวัดความหนาด้วยเทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ (X-rav Fluorescence) เกิดจาก ้รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มถูกกระตุ้น โดยรังสีเอกซ์ปฐมภูมิ ความเข้มของรังสีเอกซ์ทุติยภูมิ สัมพันธ์กับความหนาของฟิล์ม รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิทำอันตรกิริยา กับอะตอมบริเวณชั้นโคจรของอิเล็กตรอนของอะตอม ถ้าอิเล็กตรอนชั้นใดได้รับพลังงานสูงกว่า แรงยึคเหนี่ยวอิเล็กตรอนชั้นนั้นจะหลุดออก ทำให้เกิดช่องว่าง อิเล็กตรอนในวงโคจรถัดไปก็จะเข้า มาแทนที่ โดยลดพลังงานลงด้วยการคายพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อิเล็กตรอนปฐมภูมิ ทำอันตรกิริยากับวงโคจรชั้น K แล้วอิเล็กตรอนในชั้น L ก็เข้ามาแทนที่พร้อมทั้งคายพลังงาน พลังงานที่ปล่อยมาเป็นพลังงานเฉพาะระดับชั้นของอิเล็กตรอน จึงเรียกคลื่นแม่เหล็กชนิดนี้ว่า ้รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ เนื่องจากระดับพลังงานในชั้นโคจรของอิเล็กตรอนสำหรับแต่ละธาตุนั้นมี ้ค่าไม่เท่ากันจึงสามารถนำความแตกต่างของระดับพลังงานเป็นตัวจำแนกชนิดของธาตุที่มีอยู่ใน ้ตัวอย่างซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และนอกจากนั้นความเข้มของรังสีเอกซ์บอกถึงปริมาณของ ธาตุในเนื้อตัวอย่างได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ ข้อดีของการใช้เทคนิคการวัดด้วย ้ วิธีนี้ คือ ไม่ต้องเตรียมฟิล์ม เป็นการวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงาน การวัคธาตุเชิงปริมาณและคุณภาพ ้เป็นอิสระต่อกัน ค่ากงที่สำหรับมวลต่อพื้นที่ สามารถวัดได้โดยไม่ต้องนำไปเทียบกับค่ามาตรฐาน ้สำหรับข้อจำกัดของการใช้เทคนิคนี้คือเครื่องมือมีราคาแพง และระดับพลังงานที่ใช้เหมาะสำหรับ การวัดฟิล์มบาง ถ้าฟิล์มมีความหนามากจะได้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะคงที่

รังสีเอกซ์และการเกิดรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ ถูกก้นพบครั้งแรก ในปี ค.ศ.1895 โดย Wilhelm Conrad Roentgen นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ขณะกำลังศึกษาสมบัติของหลอดรังสีแก โทด Roentgen ได้สังเกตเห็นการเรื่องแสงบน กระดาษซึ่งเกลือบด้วยสารแบเรียมแพลทิโนไซยาไนด์ (Barium Platinocyanide : BaPt(CN)₆) ซึ่งเรื่องแสงเมื่อถูกรังสีอัลตราไวโอเลต แต่ขณะนั้นไม่มีการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต Roentgen จึงสรุปว่าการเรื่องแสงที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากรังสีชนิดใหม่ที่ออกมาจากหลอดรังสีแก โทดและ ให้ชื่อรังสีชนิดนี้ว่า "รังสีเอกซ์" ต่อมาในปี ค.ศ.1897 Joseph John Thomson พบว่ารังสีแก โทดก็กือ อนุภาคอิเล็กตรอน จากนั้นจึงได้มีการศึกษาถึงสมบัติของรังสีเอกซ์อย่างแพร่หลาย ปัจจุบันพบว่า รังสีเอกซ์มีสมบัติเป็นกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้น (0.1-10.0 nm) ไม่เบี่ยงเบนใน สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าและมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง รังสีเอกซ์อาจเกิดจากการเร่ง อนุภาคอิเล็กตรอนให้วิ่งไปชนอะตอมของเป้าโลหะ ซึ่งเมื่ออิเล็กตรอนถูกทำให้หยุดอย่างกะทันหัน ก็จะกายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ นอกจากนี้ยังรังสีเอกซ์ยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนชั้น (Transition) อิเล็กตรอนวงใน (Inner Orbits) ของอะคอมแล้วมีการปล่อยพลังงานออกมาในรูปของ รังสีเอกซ์ ทั้งนี้อันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสสารจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การแผ่รังสี การดูดกลืน การกระเจิงและการเลี้ยวเบน

รังสีเอกซ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ รังสีเอกซ์แบบต่อเนื่อง (Continuous X-ray) และ รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ (Characteristic X-ray) สรุปได้ดังนี้

 รังสีเอกซ์แบบต่อเนื่อง เป็นรังสีเอกซ์ที่มีการกระจายของพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดย กวามเข้มรังสีเอกซ์จะเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมของเป้าแอโนคในหลอครังสีเอกซ์ ภาพที่ 2-7 (a) เป็น สเปกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องจากเป้าทังสเตนที่เปลี่ยนแปลงตามความต่างศักย์ พบว่าความยาว คลื่นต่ำสุด λ_{min} ของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์ที่ใช้ แต่ไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าแอโนคดังแสดง ในภาพที่ 2-7(b) โดยความสัมพันธ์ของ λ_{min} และความต่างศักย์ระหว่างขั้วแอโนคและแคโทค เป็นไปตามสมการ

$$\lambda_{\min}(A) = \frac{12.4}{V(kV)}$$
 (2.1)

้จากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ เมื่ออนภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือ ้ความหน่วงจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีหลายความถี่ ในหลอครังสีเอกซ์ เมื่ออิเล็กตรอนถูกเร่งและวิ่งไปชนเป้าแอโนค อิเล็กตรอนจะถูกหน่วงลงอย่างรวดเร็วและปล่อย ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านของรังสีเอกซ์ออกมา ที่มีความยาวคลื่น λ ตามสมการ

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad \dots \dots (2.2)$$

ເນື່ອ E คือพลังงานโฟตอน

h คือค่าคงที่ของพลังค์ = 6.62×10^{-34} J·s

c คือความเร็วแสงในสูญญากาศ $\approx 3.0 \times 10^8$ m/s

2. รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ พิจารณารังสีเอกซ์จากเป้าโมลิบคีนัม ในภาพที่ 2-7 (b) พบว่านอกจากจะมีสเปกตรัมแบบต่อเนื่องแล้วยังมีสเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum) ที่มีลักษณะ เป็นขอดแหลมของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะซ้อนทับอย่บนสเปกตรัมของรังสีเอกซ์แบบต่อเนื่อง ทั้งนี้รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเกิดจากการลดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมที่ถูกกระตุ้น และเนื่องจากรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมีค่าพลังงานที่แน่นอนตามชนิคของธาตุ ทำให้สามารถนำ รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะไปใช้วิเคราะห์ธาตในสารตัวอย่างด้วยเทคนิกการเรื่องรังสีเอกซ์ได้

ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นสถานะทางกวอนตัม โดยแต่ละระดับ พลังงานจะถกกำหนดด้วยเลขดวอนตัม n, l, j และการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอน จะเป็นไปตามกฎการคัคเลือก (Selection Rule)

$$\Delta 1 = \pm 1$$

 $\Delta j = 0, \pm 1$ (2.3)

กรณี K-series เมื่ออิเล็กตรอนในชั้น K ได้รับพลังงานที่มากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของ อิเล็กตรอน (ซึ่งอาจมาจาก ลำอิเล็กตรอน หรือ รังสีเอกซ์กีได้) แล้วทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก ้อะตอม อิเล็กตรอนในชั้นถัดไปเช่น L, M, N, ... จะถงมาแทนที่โดยขณะที่มีการเปลี่ยนชั้นของ อิเล็กตรอนอะตอมก็จะปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา และเรียกรังสีเอกซ์ที่ออกมานี้ว่า K X-ravs และ เช่นเดียวกันสำหรับกรณี L-series จะเป็นการแทนที่อิเล็กตรอนในชั้น L ที่หายไป ด้วยอิเล็กตรอน ้จากชั้น M, N, ... และให้รังสีเอกซ์ที่เรียกว่า L X-rays ออกมาเป็นต้น



ภาพที่ 2-7 สเปกตรัมของรังสีเอกซ์ (นิรันคร์ วิทิตอนันต์, 2542) (a) สเปกตรัมแบบต่อเนื่องของเป้าทั้งสเตน ที่เปลี่ยนแปลงตามความต่างศักย์ (b) สเปกตรัมเฉพาะธาตุของเป้าโมลิบคีนัม ที่ซ้อนอยู่บนสเปกตรัมต่อเนื่อง

การวัดความหนาโดยเทคนิคทางรังสี

การวัดความหนาฟิล์มอาจทำได้ทั้งทางตรงคือใช้เครื่องมือวัดความหนาของฟิล์มโดยตรง หรือวัดโดยอ้อมผ่านสมบัติของฟิล์มที่สัมพันธ์กับความหนา การวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิค ทางรังสีนี้เป็นวิธีวัดความหนาฟิล์มทางอ้อม โดยการวัดความเข้มของรังสีที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ความหนาของฟิล์มบางที่ต้องการวัด ซึ่งอาจทำได้โดย (1) การวัดความเข้มรังสีที่กระเจิงหรือแผ่จาก วัสดุรองรับ โดยความเข้มของรังสีที่วัดได้จะลดลงตามความหนาฟิล์ม และ (2) การวัดความเข้มรังสี ที่เลี้ยวเบนหรือแผ่จากฟิล์มโดยตรง ซึ่งความเข้มของรังสีที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม จากหลักการพื้นฐานนี้สามารถแบ่งการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคทางรังสีออกเป็น 3 วิธีคือ การวัดความหนาโดยหลักการเลี้ยวเบนรังสี การวัดความหนาโดยหลักการแผ่รังสี และการวัด ความหนาโดยหลักการส่งผ่านรังสี (นิรันดร์ วิทิตอนันต์, 2542) สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความหนาของฟิล์มโดยหลักการแผ่รังสี อธิบายได้ดังนี้ ถ้าให้พลังงานที่มากพอแก่ชิ้นงานที่ด้องการวัดความหนา ซึ่งอาจเป็นอิเล็กตรอน หรือ รังสีเอกซ์ ปฐมภูมินั้นจะกระตุ้นให้ธาตุที่อยู่ในฟิล์มบางและวัสดุรองรับแผ่รังสีทุติยภูมิ ที่เรียกว่า การเรืองรังสี เอกซ์ออกมา ถ้าการแผ่รังสีเอกซ์นี้เกิดที่วัสดุรองรับความเข้มรังสีที่วัดได้จะลดลงตามความหนา ฟิล์ม ทำนองเดียวกันถ้าเกิดจากฟิล์มความเข้มรังสีที่วัดได้ก็จะเพิ่มตามความหนาฟิล์ม การจัด อุปกรณ์สำหรับใช้ในการวัดความหนาด้วยเทคนิคนี้ (ภาพที่ 2-8) จากรูปรังสีเอกซ์ปฐมภูมิจาก หลอดรังสีเอกซ์จะผ่านคอลิเมเตอร์ที่หนึ่งซึ่งทำหน้าที่จำกัดความกว้างของลำรังสีเอกซ์ปฐมภูมิที่ใช้ เพื่อให้ตกกระทบชิ้นงานในมุม θ, พลังงานของรังสีเอกซ์ปฐมภูมิจะไปกระตุ้นธาตุที่เป็น ส่วนประกอบของฟิล์มบางและวัสดุรองรับ ให้ปล่อยรังสีเอกซ์ทูติยภูมิลักษณะการเรืองรังสีเอกซ์ ออกมาในทุกทิศทาง รังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่ออกมานี้จะผ่านคอลิเมเตอร์ที่สองในมุม θ₂ ไปตกบนผลึก วิเคราะห์ (Analyzing Crystal) ซึ่งถูกจัดวางไว้สำหรับสะท้อนเฉพาะรังสีเอกซ์ทุดิยภูมิที่มีความยาว กลิ่นตามต้องการให้เข้าสู่ตัวตรวจวัด ความเข้มของรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่วัดได้นอกจากเปลี่ยนแปลง ตามความหนาของฟิล์มแล้ว ยังขึ้นกับการจัดวางเครื่องมือ (Geometry of Apparatus) และสมบัติ ของฟิล์มนั้น ๆ ด้วย



ภาพที่ 2-8 การจัดอุปกรณ์การวัดความหนาโดยหลักการแผ่รังสี



ภาพที่ 2-9 การเรื่องรังสีเอกซ์จากฟิล์มบางที่ความหนาต่างกัน (นิรันคร์ วิทิตอนันต์, 2542)

หากพิจารณาการเรืองรังสีเอกซ์ของฟิล์ม A ที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ชั้นเดียวซึ่งเคลือบอยู่บน วัสดุรองรับ B ที่มีความหนาต่างกัน ด้วยรังสีเอกซ์ปฐมภูมิพลังงานเดี่ยว (Mono Energetic) แสดงได้ ดังภาพที่ 2-9 จะเห็นได้ว่าในภาพที่ 2-9(a) และ 2-9(b) รังสีเอกซ์ปฐมภูมิที่ใช้จะทะลุผ่านชั้นของ ฟิล์มบางลงไปยังวัสดุรองรับแล้วทำให้เกิดการเรืองรังสีเอกซ์ทุติยภูมิทั้งจากฟิล์มและวัสดุรองรับ (F_A และ F_B ตามลำคับ) ถ้าพิจารณาเฉพาะความเข้มรังสีเอกซ์จากฟิล์ม A จะพบว่าค่าที่ตรวจวัดได้ ในภาพที่ 2-9(b) จะมีค่ามากกว่าในภาพที่ 2-9(a) เนื่องจากฟิล์มในภาพที่ 2-9(b) มีความหนากว่า ฟิล์มในภาพที่ 2-9(b) จะมีค่ามากกว่าในภาพที่ 2-9(a) เนื่องจากฟิล์มในภาพที่ 2-9(b) มีความหนากว่า ฟิล์มในภาพที่ 2-9(a) ดังนั้นถ้าความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น ความเข้มรังสีเอกซ์จากฟิล์มที่วัดได้ก็จะ เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจนถึงค่าหนึ่ง (รูปที่ 2-9(c)) พบว่ารังสีเอกซ์ปฐมภูมิไม่สามารถทะลุผ่านชั้นของ ฟิล์มลงไปได้อีก ทำให้ความเข้มรังสีเอกซ์ที่วัดได้มีค่าคงที่เรียกว่า ความเข้มอิ่มตัว (Saturated Intensity) และเรียกความหนานี้ว่า ความหนาวิกฤต (Critical Thickness) ซึ่งถ้าฟิล์มที่ด้องการวัดมี ความหนามากกว่าความหนาวิกฤต (รูปที่ 2-9(d)) พบว่าก่าความเข้มรังสีเอกซ์ทุดิภูมิที่วัดได้จะไม่ เพิ่มสูงไปมากกว่าความเข้มที่วัดได้ขณะที่ฟิล์มมีความหนาเท่าความเข้มรังสีเอกซ์กุดิภูมิที่วัดได้จะไม่ เพิ่มสูงไปมากกว่าความพนาวิกฤต (รูปที่ 2-9(d)) พบว่าก่ามางมามาวิกฤต เนื่องจากอิเล็กตรอน ใม่สามารถทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบางไปได้มากว่านี้ หากนำความเข้มของรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่วัดได้จากชิ้นงาน มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มรังสีเอกซ์ทุติยภูมิกับความหนาฟิล์มที่ทราบค่าจะได้กราฟดังแสดงในภาพที่ 2-10 ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ (1) บริเวณเชิงเส้น (Linear Region) (2) บริเวณเอกซ์ โพเนนเชียล (Exponential Region) และ (3) บริเวณกงที่ (Flat Region) ดังนี้

 บริเวณเชิงเส้น (บริเวณ WX ภาพที่ 2-10) ช่วงนี้เป็นช่วงสั้นๆ และเนื่องจากความหนา ของฟิล์มช่วงนี้น้อยมากจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลจากเมทริกซ์ (Matrix Effects) ทำให้ความสัมพันธ์ ของความเข้มการเรืองรังสีเอกซ์ที่วัดได้กับความหนาฟิล์มมีลักษณะเป็นเชิงเส้น

2. บริเวณเอกซ์โพเนนเชียล (บริเวณ XY ในภาพที่ 2-10) ช่วงนี้ผลการดูดกลืนเนื่องจาก ธาตุในฟิล์มเริ่มมีความสำคัญ ดังนั้นถึงแม้ว่าความเข้มของรังสีเอกซ์ทุติยภูมิจะยังคงมีค่าเพิ่มขึ้นตาม ความหนาของฟิล์ม แต่จะเห็นได้ว่าเป็นไปในลักษณะที่อัตราการเพิ่มก่อย ๆ ลดลง ความชันกราฟ ในช่วงนี้จึงเพิ่มอย่างช้า ๆ ทำให้กราฟมีลักษณะโด้งลง

 3. บริเวณคงที่ (บริเวณ YZ ในภาพที่ 2-10) ช่วงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์ม เพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับความหนาวิกฤติของฟิล์มนั้น ทำให้ความเข้มรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่วัดได้มีค่าคงที่ แม้ว่าความหนาของฟิล์มจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม



Thickness



การวัคความหนาด้วยหลักการแผ่รังสีแบ่งเป็น 3 กรณีคือ (นิรันคร์ วิทิตอนันต์, 2542)

 กรณีการแผ่รังสีจากวัสดุรองรับ เมื่อรังสีตกกระทบฟิล์มและวัสดุรองรับ รังสีบางส่วน จะถูกดูดกลืนโดยชั้นฟิล์มและบางส่วนทะลุผ่านถึงชั้นของวัสดุรองรับ แล้วกระดุ้นชาตุในวัสดุ รองรับทำให้เกิดการเรืองรังสีลักษะเฉพาะและแผ่รังสีผ่านชั้นของฟิล์มกลับออกมา ตามสมการ

- เมื่อ I_d คือ ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่หนา d
 - d คือ ความหนาของฟิล์มบาง
 - I คือ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของวัสคุรองรับ
 - α คือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น

 กรณีการแผ่รังสีจากฟิล์ม พิจารณารังสีเอกซ์ความเข้ม I₀ กระทบฟิล์มซึ่งหนา d แล้ว ไปกระตุ้นให้เกิดการเรื่องรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความเข้ม I₄ แผ่รังสีกลับออกมา โดยค่ารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่แผ่กลับออกมามีค่าตามสมการ

$$I_d = I_s (1 - e^{-\alpha d})$$
 (2.5)

เมื่อ I_d คือ ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่หนา d

- d คือ ความหนาของฟิล์มบาง
- I คือ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะอิ่มตัวของชั้นฟิล์ม
- α คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถคทอนเชิงเส้น

กรณีการแผ่รังสีจากวัสดุรองรับและฟิล์ม เป็นการวัดความเข้มรังสีที่แผ่ออกมาจาก
 วัสดุรองรับและฟิล์ม ตามสมการ

$$\ln\left[\frac{(I-I_s)}{(I_0-I_s)}\right] = -\alpha d \qquad \dots \dots (2.6)$$

- เมื่อ I คือ ความเข้มรังสีรวมจากชิ้นงาน
 - \mathbf{I}_0 คือ ความเข้มรังสีที่ฉายไปยังชิ้นงาน
 - I คือ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของวัสดุรองรับ
 - d คือ ความหนาของฟิล์มบาง
 - α คือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

ลักษณะเฉพาะสำคัญอย่างหนึ่งของฟิล์ม คือ โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) ซึ่งหาได้ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction; XRD) ประเสริฐศักดิ์ เกษมอนันต์กูล (2549) ได้ อธิบายหลักการของเทคนิค XRD ไว้ดังนี้ การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เป็นเทคนิคสำหรับ วัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกจากผลึก โดยใช้หลักการของการเลี้ยวเบนของคลื่น ทั้งนี้พบว่ารังสีเอกซ์เลี้ยวเบนได้เมื่อตกกระทบผลึก ซึ่งแบรกก์ (Bragg) ได้เสนอแนวคิดว่า โครงสร้างผลึกหรือผลึกประกอบด้วยชั้น (Layer) หรือ ระนาบ (Plane) ของอะตอม ซึ่งสามารถ สะท้อนคลื่นที่ตกกระทบ โดยมุมที่ตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อน และแสดงออกมาในรูปของพีค เป็นไปตามสมการที่ 2-7 ซึ่งเรียกว่าสมการของแบรกก์ (Bragg's Law) และภาพที่ 2-11

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{2-7}$$

เมื่อ d_{hkl} คือ ระยะห่างระหว่างระนาบ (h k l)

θ คือ มุมตกกระทบและมุมสะท้อนเมื่อวัดจากแนวระนาบที่พิจารณา

n คือ ลำดับของการสะท้อน

 λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ (CuK $_{\alpha}$ = 1.5406 Å)

ทั้งนี้ตำแหน่งค่าสูงสุดของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ หรือ พืคที่มีค่ามากที่สุด สามารถบอกขนาดของหน่วยเซลล์ได้ ขณะที่ความกว้างให้หาค่าขนาด การจัดเรียงตัว (Orientation) และความเครียด (Strain) ภายในเกรนของวัสดุหลายผลึก โดยขนาดผลึกสามารถหาได้จากสมการ ของ Scherrer (สมการที่ 2-8)

$$L = \frac{k\lambda}{\beta\cos\theta}$$
(2-8)

เมื่อ L คือ ขนาดผลึก

- k คือ ค่าคงที่เท่ากับ 0.9
- λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ (CuK $_{\alpha}$ = 1.5406 Å)
- β คือ ความกว้างกรึ่งหนึ่งของพืกที่มีก่ากวามเข้มสูงสุด
- θ คือ ครึ่งหนึ่งของมุมของพีค



(a)



(b)



ภาพที่ 2-11 ลักษณะการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึก

เอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทำได้จากหลายวิธี ซึ่งมีข้อคื-ข้อเสียแตกต่างกัน แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่มีปริมาณน้อยเช่นฟิล์มบางนั้น คือการศึกษาด้วย เอกซเรย์สเปค โตรส โคปีแบบกระจายพลังงาน หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า EDS เนื่องจาก EDS เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) เพื่อเก็บสัญญาณรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จึงเป็นการง่ายและสะดวก ในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุไปพร้อมกัน

ปกติกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราค มักใช้เป็นเทคนิคในการศึกษาลักษณะพื้นผิวของ วัสดุหรือฟิล์มบาง ซึ่ง วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2543) ได้อธิบายหลักการทำงานไว้ดังนี้ สัญญาณภาพ ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราคที่ได้เกิดจากการใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron detector; SE detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิ ที่เกิดขึ้น หรือใช้ ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscatter Electron detector; BSE detector) มาจับสัญญาณ อิเล็กตรอนกระเจิงกลับที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่ 2-12



ภาพที่ 2-12 องค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (อมรรัตน์ คำบุญ, 2551)

อิเล็กตรอนทุติยภูมิจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนจะถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูงที่ ปรับค่าได้ จากนั้นจึงถูกดึงลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นแอโนดภายใต้ภาวะความดันสุญญากาศ 10⁻⁵ ถึง 10⁻⁷ torr โดย มีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ปรับลำอิเล็กตรอนให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์วัตถุ ทำหน้าที่ปรับลำอิเล็กตรอนทุติยภูมิให้โฟกัสบนผิวตัวอย่าง พอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิวตัวอย่าง มีขนาดในช่วง 5 - 200 nm โดยมีชุดควบคุม ทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิวชิ้นงานตัวอย่าง

ทั้งนี้ลำอิเล็กตรอนที่กระทบผิวตัวอย่างจะเกิดอันตรกริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับ อะตอมของธาตุในตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (Electron Signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมา (ภาพที่ 2-13 และภาพที่ 2-14) (วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา, 2543) ซึ่งสามารถนำไปใช้ศึกษาโครงสร้างจุลภาคและ วิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่าง โดยสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอน ชนิดต่าง ๆ ที่เกิด มีดังนี้

 อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electrons) เป็นส่วนหนึ่งของอิเล็กตรอนที่หลุด จากวงโกจรของอะตอม หลังจากดูดกลืนพลังงานจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิ มีพลังงานต่ำและจะเกิด ได้ดีกับธาตุที่มีเลขอะตอมก่อนข้างต่ำ

 อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electrons) เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสีย พลังงานบางส่วนให้กับอะตอมและกระเจิงกลับออกมา มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิเกิดได้ ดีกับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

 อิเล็กตรอนทะลุผ่าน (Transmitted Electron) เป็นส่วนของอิเล็กตรอนที่เหลือจาก การดูดกลืนพลังงานของชิ้นตัวอย่าง ปริมาณของอิเล็กตรอนจะขึ้นอยู่กับความหนา ความหนาแน่น และภาคตัดขวางการดูดกลืนพลังงานของธาตุองค์ประกอบในชิ้นตัวอย่าง

 อิเล็กตรอนที่ถูกดูดกลืน (Absorbed Electrons) เป็นส่วนของอิเล็กตรอนที่สูญเสีย พลังงานให้กับอะตอมในชิ้นตัวอย่างหมด และพลังงานที่สูญเสียจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งมีผลให้ตัวอย่างไหม้เกรียมได้

5. รังสีเอกซ์ (X-ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาหลังทำอันตรกริยา ระหว่างอะตอมบนชิ้นตัวอย่างกับอิเล็กตรอนพลังงานสูง แบ่งเป็น 2 ชนิด

5.1 รังสีเอกซ์ต่อเนื่อง (Continuum X-ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว คลื่นกระจายเป็นช่วงกว้าง (Broad Spectrum) เกิดจากการที่อิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสูง บริเวณสนามไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นสูงระหว่างนิวเคลียสกับวงโคจรชั้นในของอะตอม มีผลจึงทำ ให้อิเล็กตรอนพลังงานสูงสูญเสียพลังงานและปลดปล่อยพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทันที 5.2 รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ (Characteristic X-rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความยาวคลื่นเฉพาะอะตอมของธาตุที่ถูกกระตุ้น เกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงชนกับอิเล็กตรอน ในชั้น K L หรือ M แล้วอิเล็กตรอนของชั้นใดหนึ่งหลุดออก อิเล็กตรอนชั้นถัดไปจะเข้ามาแทนที่ และลดพลังงานด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจึงมี ดวามยาวคลื่นเฉพาะระดับพลังงานของอะตอมของธาตุนั้น ๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ธาตุในเชิงปริมาณและกุณภาพได้

6. โอเจร์อิเล็กตรอน (Auger Electrons) เป็นอิเล็กตรอนที่หลุดจากวงโคจรจาก การกระตุ้นของรังสีเอกซ์ที่เกิดจากชิ้นตัวอย่าง ให้ประโยชน์มากในการวิเคราะห์ปริมาณชาตุเบา

 แสงเรื่องจากชิ้นตัวอย่าง (Cathodoluminescence) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความยาวคลื่นในช่วงตามองเห็น เกิดจากอะตอมของชิ้นตัวอย่างได้รับพลังงานจากลำอิเล็กตรอน ในวงโคจรชั้นนอกเลื่อนเข้าสู่สภาวะถูกกระตุ้น (Exited State) และกลับเข้าสู่สภาวะปกติ (Ground State) พร้อมทั้งปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8. แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force) เป็นปริมาณไฟฟ้าที่เกิดจากความแตกต่าง ของประจุระหว่างค้านหน้าและหลังของชิ้นตัวอย่าง



ภาพที่ 2-13 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมตัวอย่าง



ภาพที่ 2-14 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับตัวอย่างที่ระดับชั้นความลึกต่าง ๆ (วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา, 2543)

สำหรับหลักการทำงานของเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานซึ่งต่อพ่วงกับ กล้องจุลทรรสน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา (2543) ได้อธิบายหลักการทำงาน ไว้ดังนี้ เมื่ออิเล็กตรอนพลังงานสูงเข้าชนอิเล็กตรอนชั้นในของอะตอม เช่น ชั้น K หรือ ชั้น L แล้ว ถ่ายโอนพลังงานให้แก่อิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนชั้นในที่ได้รับพลังงานดังกล่าวมีพลังงานสูงขึ้น มากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นโคจรจึงหลุดออกมาจากวงโคจร ทำให้เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน ในชั้นโคจร จากนั้นอะตอมที่อยู่ในสถานะกระตุ้นลดระดับพลังงานลงสู่สภาวะปกติในช่วง ระยะเวลาอันสั้น (10⁻¹⁵ วินาที) โดยอิเล็กตรอนของวงจรชั้นถัดออกไปลดระดับพลังงานสงมาเท่ากับ พลังงานยึดเหนี่ยวของวงจรที่เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน ด้วยการปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปของ รังสีเอกซ์ แล้วอิเล็กตรอนจะเข้ามาแทนที่ พลังงานส่วนเกินนี้มีพลังงานเท่ากับความต่างของระดับ พลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะชั้นโคจรของอิเล็กตรอนและเฉพาะธาตุนั้น ๆ จึงมีก่าพลังงานเฉพาะก่า ซึ่งเรียกรังสีชนิดนี้ว่า "รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ" ดังแสดงในภาพที่ 2-15 และภาพที่ 2-16



ภาพที่ 2-15 การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ โดยใช้ลำอิเล็กตรอน (วีรศักดิ์ อุดมกิจเคชา, 2543)



ภาพที่ 2-16 การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ระดับพลังงานของชั้น โคจรต่าง ๆ (วีระศักดิ์ อุคมกิจเดชา, 2543)

ระบบวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบ EDS หัววัดรังสีที่นิยม คือ หัววัดรังสีแบบ Si (Li) เหมาะสำหรับการวัดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่มีพลังงานในช่วง 1 ถึง 30 keV หรือหัววัดรังสีชนิด เจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูง (High Purity Germanium; HPGe) ซึ่งสามารถวัดรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะได้ช่วงกว้าง คือ 3 ถึง 200 keV โดยหัววัดรังสีเอกซ์ทั้งสอง 2 แบบ จะเปลี่ยนพลังงาน ของรังสีให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปของศักย์ไฟฟ้า โดยขนาดของสัญญานไฟฟ้าที่ทางออกของ หัววัดจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับพลังงานของรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบบนหัววัด จากนั้นวงจรขยาย แบบช่องเดี่ยวหรือหลายช่องจะเก็บสัญญานไฟฟ้าจากหัววัดในหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่อง และแสดงผลวิเคราะห์บนจอภาพในรูปของสเปกตรัม พร้อมทั้งผลวิเคราะห์เชิงปริมาณและกุณภาพ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปดังภาพที่ 2-17 และภาพที่ 2-18



ภาพที่ 2-17 องค์ประกอบหลักของเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (อมรรัตน์ คำบุญ, 2551)



Element	Wt%	A1%
N	45.38	69.74
Al	16.41	13.09
Ti	38.21	17.17

ภาพที่ 2-18 ตัวอย่างผลจากการวิเคราะห์องก์ประกอบของทางเกมีด้วยเทกนิก EDS (อารีรัตน์ สมหวังสกุล, 2556)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Prencipe, Dellasega, Zani, Rizzo, and Passoni (2015) ศึกษาวิธีวัดความหนาฟิล์มบาง แบบไม่ทำลายชิ้นงาน ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปกโตสโคปีแบบกระจายพลังงานที่ต่อพ่วงอยู่กับ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับวัดความหนาฟิล์มบางที่มีความหนาแน่นน้อยมี องค์ประกอบทางเคมีและพื้นผิวที่ต่างกัน โดยยิงลำอิเล็กตรอนไปที่ชิ้นงานตัวอย่าง ระบบ EDS จะ รับสัญญาณที่ออกมานเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของฟิล์มเปรียบเทียบกับการวัดความหนา แบบภาคตัดขวาง (Cross Section) จากเครื่อง SEM พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ เทคนิคนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการวัดนี้ เร็ว ง่าย และราคาถูก

Franquet, Conard, Gilbert, Hantschel, and Vandervorst (2013) ศึกษาการวัดความหนา และองค์ประกอบของฟิล์มบางนาโนแบบหลายชั้น (Multilayer Thin Films) ด้วยเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งความหนาและองค์ประกอบของฟิล์มที่มีหลาย ชั้นคลอบคลุมธาตุเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน การวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิค EDS ทำได้โดยยิง ลำอิเล็กตรอนไปในพื้นที่ขนาดเล็กของฟิล์มที่ต้องการวัด ด้วยศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV และ 12 kV ผลที่ได้จะอยู่ในรูปของความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ แล้วนำความเข้มของรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะที่ได้ไปแทนค่าในโปรแกรม ThinFilmID จะได้ความหนาฟิล์ม ซึ่งนำไปเทียบกับ ค่าที่วัดโดยใช้เทคนิค RBS, Atom Probe และ TEM พบว่าความหนาของฟิล์มที่ได้จากเทคนิค EDS มีความถูกต้องใกล้เกียงกัน โดยสามารถวัดความหนาของฟิล์มบางที่มีขนาดน้อยกว่า 500 nm ได้

Vrielink, Tiggelaar, Gardeniers, and Lefferts (2012) ได้ศึกษาการวัดความหนาของฟิล์ม แบบไม่ทำลายชิ้นงานด้วยเทคนิค XRF โดยรังสีจากแหล่งกำเนิดภายในเครื่องมือ (Primary X-ray Source) จะปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาพุ่งเข้าชนชิ้นงานตัวอย่าง ส่งผลให้อิเล็กตรอนวงในสุค (K-shell) ของอะตอมภายในวัตถุหลุดออก เกิดช่องว่างขึ้นในวงอิเล็กตรอนนั้น ทำให้อะตอมไม่เสถียร และ อะตอมจะกลับสู่สภาวะที่เสถียร โดยการเปลี่ยนระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนวงนอกเข้ามาแทนที่ ช่องว่างดังกล่าว ซึ่งในการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนทำใด้โดยการปลดปล่อยพลังงาน ออกมา ซึ่งพลังงานของธาตุต่างชนิดในชิ้นงานจะมีความยาวคลื่นเฉพาะสำหรับธาตุนั้น ๆ จึงทำให้ สามารถบ่งชี้ชนิดของธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ ปริมาณการเรืองรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุ นั้นในสารตัวอย่าง ข้อมูลนี้จึงสามารถนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุแต่ละชนิดได้ การวัดความ หนาของสารเคลือบ โดยการ วัดความเข้มของการเรืองรังสีเอกซ์ของสารเคลือบ และวัดฟิล์มเดี่ยว และฟิล์มเชิงซ้อนที่เคลือบภายใด้ระบบสป์ตเตอริงและระเหยสารบนกระจกและซิลิกอน จากนั้น นำไปวัดด้วยเทคนิค XRF ซึ่งจะได้ความเข้มของการเรืองรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะนำไปประมวล ความหนา ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แล้วนำเปรียบเทียบความหนาการวัดความหนาจากเทคนิค SEM จากภาพภาคตัดตามขวางของฟิล์มบางและสไตลัส แสดงให้เห็นว่าการวัดฟิล์มด้วยเทคนิค XRF สามารถแยกองค์ประกอบและความหนา ซึ่งเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นคล่องตัวกว่าการวัดด้วยเทคนิค SEM และสไตลัสซึ่งไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยาก และความหนาสามารถวัดได้ถึงระดับ 50 nm สรุปได้ว่าการวัดฟิล์มด้วยเทคนิค XRF นอกจากวัดความหนายังสามารถวัดความหนาแน่น และ องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มโลหะ ซึ่งสามารถทำได้ก่อนหรือหลังการนำฟิล์มไปใช้งานได้

Kailash and Hore (2010) ได้ศึกษาการวัดความหนาของฟิล์มด้วยหลักการแทรกสอด ของแสงของสเปกตรัมผ่านเนื้อฟิล์มไปยังสเปกโทรกราฟจะได้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัว ดัชนีหักเหของแสงและความยาวคลื่นแสง ในกระบวนการวัดจะทำการวัดค่าการกระจายตัวดัชนี หักเหของแสงและความยาวคลื่นแสง ของวัสดุรองรับที่ไม่ได้เคลือบฟิล์มและฟิล์มที่เคลือบบนวัสดุ รองรับนำมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการส่องผ่านแสงกับความยาวคลื่น และดัชนีหักเหกับ กวามยาวคลื่น จากกราฟเปรียบเทียบทั้งสองจะได้ข้อมูลที่นำไปคำนวณหาความหนาของฟิล์ม ตามความสัมพันธ์ของค่าดัชนีหักเหที่แตกต่างกันได้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความหนาของฟิล์มมีความถูกต้องและใกล้เคียงกัน สรุปแล้วการวัดความหนาโดยเทคนิคนี้ ไม่จำเป็นต้องทราบค่าคงที่ทางแสงของวัสดุที่นำมาวัด เทคนิกการวัดรูปแบบนี้สามารถวัดได้ อย่างถูกต้อง กระบวนการวัดไม่ซับซ้อน เป็นการวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงาน

Canli (2010) ใช้เทคนิคเอกซเรย์สเปกโตสโคปีแบบกระจายพลังงานในการวัคความหนา ของฟิล์มบางโลหะ โดยการใช้อุปกรณ์สำหรับการวัดองค์ประกอบทางเคมีของวัสคุด้วยระบบ EDS ซึ่งเป็นโมดูลที่ต่อพ่วงอยู่ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ ออกมาจากชิ้นงานจะแสดงให้ถึงองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของสารที่เคลือบบนวัสดุรองรับ อัตราส่วนของปริมาณของสารที่เคลือบมีความแตกต่างกันเมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน และฟิล์มบางที่มีองค์ประกอบเดียวบนวัสดุรองรับจะให้อัตราส่วนของพลังงานจากกราฟค่าเดียว ดังนั้นความหนาของฟิล์มบางสามารถคำนวณโดยการวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของกราฟอัตราส่วน พลังงานของข้อมูลเทคนิคเอกซเรย์สเปกโตสโคปีแบบกระจายพลังงานที่ได้รับจากฟิล์ม

Zhuang et al. (2009) ศึกษาเทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบางแบบไม่ทำลายชิ้นงาน ของฟิล์มที่เคลือบบนวัสดุรองรับ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีการติดตั้งระบบ EDS ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม โดยเมื่ออิเล็กตรอนถูกยิง จากปืนอิเล็กตรอน ลำอิเล็กตรอนจะแทรกลึกผ่านผิวหน้าของฟิล์มบางเข้าไปในผิวของฟิล์มแล้ว ทะลุผ่านไปถึงวัสดุรองรับ แล้วทำให้เกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะแผ่กลับออกมา ซึ่งแปรค่า ตามศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้เพื่อเร่งอิเล็กตรอน ทั้งนี้ระบบ EDS จะมีตัวรับสัญญาณความเข้มรังสีเอกซ์ จากฟิล์ม (I_r) และความเข้มจากวัสดุรองรับ (I_r) ซึ่งสามารถนำไปคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนของความเข้ม I_v/I_r เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน แล้วนำไปสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ ของฟิล์มได้ ตามทฤษฎีแล้วความหนาของฟิล์มสามารถคำนวณได้จากความเข้มของรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะที่ตรวจได้ ทั้งนี้เมื่อทดลองใช้การวัดความหนาวิธีนี้วัดความหนาของฟิล์มของ สารประกอบ FeCoSiB ที่เคลือบบนแก้ว แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดโดยใช้เทคนิคสไตลัส ผลการศึกษาพบว่าวิธีวัดความหนาโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์สเปกโตสโคปีแบบกระจายพลังงานมีค่า ใกล้เกียงกัน ซึ่งแสดงว่าการวัดความหนาวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมและใช้งานได้

Oliva Arias, López-Garduza, and Sosa (2006) ได้ศึกษาการวัดความหนาแบบ *in situ* ของฟิล์มบางทองคำซึ่งเตรียมจากการเคลือบ 2 วิธีได้แก่ วิธีระเหยสารและวิธีสปัตเตอริง โดยการวัด ความหนาวิธีนี้เป็นการวัดทางอ้อมจากสมบัติความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มซึ่งแปรก่าตามความหนา โดยวิธีนี้ต้องมีฟิล์มบางเริ่มต้นที่มีความหนาประมาณ 10 nm ทำหน้าที่เป็นฟิล์มสำหรับใช้ตรวจวัด หรือที่เรียกว่า Probe Film สำหรับวัดก่าความต้านทานไฟฟ้า โดยต้องต่อขั้วไฟฟ้าที่ Probe Film เพื่อวัดก่าความต้านทานเมื่อความหนาของฟิล์มที่เกลือบบน Probe Film เปลี่ยนแปลงไป สำหรับ การวัดความหนาจะทำโดยการนำ Probe Film ไปวางใกล้แท่นวางชิ้นงานหรือวัสดุรองรับที่ต้องการ เกลือบ เมื่อฟิล์มเริ่มเกลือบบนชิ้นงานหรือแผ่นวัสดุรองรับ ผิวหน้าของ Probe Film ก็จะถูกเกลือบ ด้วยเช่นกัน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ก่าความต้านทานที่วัดได้จาก Probe Film เปลี่ยนไปตามความหนา ของฟิล์มที่เกลือบบนชิ้นงานหรือวัสดุรองรับ ทั้งนี้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าความหนาของฟิล์มบาง ทองกำที่ได้จากการวัดด้วยวิธีนี้เมื่อเทียบกับความหนาของฟิล์มบางที่วัดจากเครื่อง Profilemeter พบว่ามีก่าใกล้เกียงกัน

Kongsakul, Witit-anun, Chaiyakun, and Kaewtrakulpong (2005) ได้ศึกษาเทคนิคการวัด ความหนาของฟิล์มบางแบบไม่ทำลายชิ้นงาน ที่สะดวก ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ เทคนิคทางแสงที่เรียกกว่า Fizeau Interferometer Technique การวัดความหนาของฟิล์มบางวิธีนี้ คำนวณได้จากตำแหน่งที่แตกต่างกันของริ้วการแทรกสอดของแสง การทดลองนี้ใช้เลเซอร์เป็น แหล่งกำเนิดแสงขนานฉายไปตกกระจกแผ่นเรียบ (Optical Flat) ซึ่งใช้อ้างอิง ทั้งนี้บางส่วนของ แสงเลเซอร์จะทะอุผ่านกระจกแผ่นเรียบไปกระทบผิวของฟิล์มที่ต้องการวัดความหนา โดยลำแสง ส่วนหนึ่งสะท้อนจากผิวด้านหลังของกระจกแผ่นเรียบ และอีกลำหนึ่งสะท้อนจากผิวด้านหน้าของ ฟิล์มที่นำมาทดสอบ แล้วเกิดการแทรกสอดระหว่างลำแสงทั้งสองเป็นริ้วการแทรกสอด ความหนา ของฟิล์มได้จากการวัดระยะของริ้วการแทรกสอดที่มีความแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีนี้ วัดความหนา ของฟิล์มบางอะลูมิเนียมซึ่งมีค่าความหนาอยู่ระหว่าง 0.11 - 0.39 μm พบว่า มีก่าใกล้เกียงกับค่าความหนาที่ได้จากการวัดด้วยเทกนิกสไตลัส Piegari and Maseti (1995) ศึกษาและเปรียบเทียบการวัดความหนาของฟิล์มบาง โดย เลือกบางเทคนิคมาพิจารณา เทคนิคการวัดความหนาที่เลือกมาเปรียบเทียบนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง เช่น Stylus Profilometry, Interferometry, Ellipsometry, Spectrophotometric Measurements และ X-ray Microanalysis และศึกษา โดยการกำหนดพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่ที่ศึกษาจะใช้เทคนิคมากกว่า 1 เทคนิคในการพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะการเตรียม ตัวอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากแต่ละเทคนิค สรุปผลจากการศึกษา การวัดในแต่ละวิธีมีความถูกต้องและมีความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกเทคนิคการวัดจะขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้ทำการศึกษาและความเหมาะสมในงานนั้น ๆ

Pascal, Cruz, Ferreira, and Gomes (1994) ได้ศึกษาเทกนิกการวัดความหนาของฟิล์มบาง บนวัสดุรองรับ โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มของรังสีเอกซ์จากฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ ซึ่งวัดจากเทกนิกเอกซเรย์สเปกโตสโคปีแบบกระจายพลังงาน ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วิธีนี้เป็นการวัดความหนาของฟิล์มบางโดยอาศัยความเข้มสูงสุดของ รังสีเอกซ์ที่ได้จากราฟการวัดองก์ประกอบทางเกมีของธาตุด้วยเทกนิกเอกซเรย์สเปกโตสโคปีแบบ กระจายพลังงานแล้วนำมาสร้างกราฟกวามสัมพันธ์ระหว่างกวามเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ และความหนาของฟิล์มบาง สร้างสมการความหนาของฟิล์มจากกราฟ เปรียบเทียบความหนาของ ชิ้นงานที่ได้จากสมการเทียบกับความหนาที่ได้จากการวัดโดยใช้เทกนิกแบบ Stylus Profilometry, Interferometry หรือ Rutherford Back Scattering ผลที่ได้มีกวามกาดเกลื่อนน้อย พลังงานที่ใช้มี ระดับต่ำ เป็นการวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงานเป็นที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมที่จะนำไป ประยุกต์ใช้ในการวัดกวามหนาของฟิล์มบาง

นิรันคร์ วิทิตอนันท์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเซษฐ ลิ้มสุวรรณ และวีรพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล (2544) ได้ศึกษาการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยเทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ ตัวอย่างฟิล์มที่ใช้คือ ฟิล์มทองกำที่เคลือบบนกระจกด้วยระบบอันบาลานซ์แมกนิตรอนสปัตเตอริง โดยความหนาของ ฟิล์มที่ใช้เป็นค่ามาตรฐานหาจากวิธีชั่งมวล แล้วนำฟิล์มทองกำไปวิเคราะห์การเรื่องรังสีเอกซ์ จากเทคนิค XRF พิจารณาความเข้มของรังสีเอกซ์เรื่องจากสเปกตรัมของ Au L_β ผลการศึกษา พบว่าฟิล์มที่ได้มีสีทองลักษณะผิวเนียนเรียบ มันวาวสะท้อนแสงได้ดี ความหนาของฟิล์มอยู่ในช่วง 0.13-5.89 µm โดยความเข้มของรังสีเอกซ์จาก Au L_β กับความหนาของฟิล์มมีความสัมพันธ์ แบบเอกซ์โพแนนเชียล ตามสมการการเรื่องรังสีเอกซ์ คือ $I_d = I_s(1 - e^{-\alpha d})$ เมื่อ I_d เป็นความเข้ม การเรื่องรังสีเอกซ์จากฟิล์มหนา d และ I, เป็นความเข้มรังสีเอกซ์อิ่มตัว ส่วน α เป็นตัวประกอบเชิง เรขาคณิต และเมื่อทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นพบว่ามีความถูกต้องถึง 95% ไพโรจน์ แก้วอภิชัย และพิเซษฐ ลิ้มสุวรรณ (2544) ได้ศึกษาเทคนิคการวัดความหนา ฟิล์มบางด้วยเทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ โดยใช้ฟิล์มทองที่เคลือบบนแผ่นทองแดง ซึ่งทราบความ หนาจากวิธีชั่งมวลและนำมาวิเคราะห์การเรื่องรังสีเอกซ์จากฟิล์ม โดยพิจารณาความเข้มการเรื่อง รังสีเอกซ์จากสเปกตรัมของ AuLa ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มทองมีความหนาในช่วง 0.00-7.00 μ m ซึ่งตรงกับค่าความหนาฟิล์มที่นำมาใช้ในการทดลอง โดยความเข้มการเรื่องรังสีเอกซ์กับความหนา ของฟิล์มที่ในการศึกษามีความสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพแนนเชียลตามสมการ I_d = I_s(1 - e^{-ad}) เมื่อ I_d เป็นความเข้มการเรื่องรังสีเอกซ์จากฟิล์มหนา d และ I_s เป็นความเข้มรังสีเอกซ์อิ่มตัว ส่วน a เป็นตัวประกอบเชิงเรขาคณิต และเมื่อทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น พบว่ามีความถูกต้องถึง 97%

วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล, เกษรา อินนุรักษ์ และวรพจน์ อิงกสรรัตน์ (2549) ได้พัฒนา สเปคโตรมิเตอร์เรืองรังสีเอกซ์เพื่อใช้วัดความหนาของโลหะเกลือบชนิดต่าง ๆ บนแผ่นวัสดุรองรับ วิธีนี้ลำรังสีเอกซ์จากหลอดรังสีเอกซ์กำลังต่ำจะถูกบีบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm แล้วฉาย ลงบนชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ซึ่งสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ โดยการปรับ แท่นวางชิ้นงานสามมิติจนเห็นพื้นผิวได้อย่างชัดเจนจากกล้องจุลทรรศน์ รังสีเอกซ์เรืองจาก สารเกลือบถูกวัดด้วยหัววัดแบบพรอพพอร์ชันนอลชนิดแก๊สซีนอน (Xe) และวิเคราะห์ด้วย มัลดิแชลแนลอนาไลเซอร์(MCA) ความหนาของสารเกลือบหาจากความเข้มรังสีเอกซ์เรืองที่ สอดกล้องกับธาตุของสารเกลือบ โดยคำนวณจากแบบจำลองทางกณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมา โดยใช้สารเกลือบมาตรฐาน Cu/glass และ Au/Ni ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์การเรือง รังสีเอกซ์ร่วมกับการใช้วิธีการทางกณิตศาสตร์ซึ่งได้อธิบายในงานวิจัยนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการหาความหนาของสารเกลือบ ซึ่งปรากฏว่าให้ก่ากลาดเกลื่อน 1-16 % สำหรับสารเกลือบ ทองแดงบนกระจกที่มีความหนา 0.35- 6.20 μm และกลาดเกลื่อน 1-5 % สำหรับสารเกลือบทอง บนนิกเกิลที่มีความหนา 0.41-9.40 μm

บทที่ 3

วิชีดำเนินการวิจัย

อุปกรณ์และเครื่องมือ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมฟิล์มบาง โครเมียม (2) การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียม ซึ่งมีรายละเอียคคังนี้

1. การเตรียมฟิล์มบางโครเมียม

 1.1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบสปัตเตอริง เป็น เครื่องเคลือบที่สร้างขึ้น โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทค โน โลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-1)

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบ (Target) ใช้ โครเมียม (Cr) ความบริสุทธิ์ 99.97%

- 1.2.2 วัสคุรองรับ ใช้ 2 ชนิดคือ กระจกส ไลด์ และ แผ่นซิลิกอน
- 1.2.3 แก๊สอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.999% เป็นแก๊สสปัตเตอร์ (Sputtered Gas)

2. การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียม

2.1 X-Ray Diffractrometer (XRD) สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์ม ใช้เครื่อง X-ray Diffractometer Bruker รุ่น D8 ของ คณะพลังงานสิ่งแวคล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาพที่ 3-2)

2.2 Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) สำหรับศึกษา โครงสร้างจุลภาค ใช้เครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope รุ่น Hitashi S-4700 ของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center, TMEC) (ภาพที่ 3-3)

2.3 Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) สำหรับศึกษาองก์ประกอบ ทางเคมีของฟิล์ม ใช้ระบบ Energy Dispersive X-ray Spectroscope ของ IXRF systems รุ่น EDS2006 550i Analyzer ซึ่งต่อพ่วงกับ FE-SEM (Hitashi S-4700) ของศูนย์เทคโนโลยี ใมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center, TMEC) (ภาพที่ 3-3)

2.4 Atomic Force Microscope (AFM) สำหรับศึกษาความหยาบผิวของฟิล์ม ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope ของ SEIKO Instrument รุ่น SPA400 ของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) (ภาพที่ 3-4)



ภาพที่ 3-1 ใดอะแกรมและลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริง



ภาพที่ 3-2 เครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD)



ภาพที่ 3-3 เครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) พร้อม Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)

เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบดีซีสปัตเตอริง

การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง ซึ่งเป็น กระบวนการที่เกิดภายใต้สภาวะสุญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ ต้องการ ต้องลดความดันพื้น (Base Pressure) ในห้องเคลือบให้อยู่ในระดับ 10⁻⁵ mbar ส่วนประกอบ ของเครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และระบบการเคลือบ (Coating System) มีรายละเอียดดังนี้

 ระบบสุญญากาศ (Vacuum System) ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจาก สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 310.0 mm ระบบเครื่องสูบสุญญากาศของ เครื่องเคลือบประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบ กล โรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย สำหรับการวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดัน ของ PFEIFFER ซึ่งใช้ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauge รุ่น PKR251 ภาพที่ 3-5 เป็นผังระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ



ภาพที่ 3-5 ผังระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัย

2. ระบบการเคลือบ (Coating System) เป็นส่วนเคลือบฟิล์มบางโครเมียม แสดงดัง ภาพที่ 3-6 ซึ่งประกอบด้วยแมกนิตรอนคาโทด (ภาพที่ 3-6 (a)) แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 50.0 mm ติดตั้งที่แผ่นปิดบน (Top Plate) ของห้องเคลือบ พร้อม ภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงขนาด 1000 V 3 A ในส่วนของการจ่ายแก๊สในกระบวนการเคลือบ (แก๊สอาร์กอน) จ่ายโดยการควบคุมของเครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D สำหรับภายในห้องเคลือบมีแท่นวางชิ้นงานที่กลางห้องเคลือบ ตรงข้ามกับแมกนิตรอนคาโทด โดย แท่นวางชิ้นงานสามารถปรับระยะห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบได้ ภาพที่ 3-6 (b) และ ภาพที่ 3-6 (c) แสดงลักษณะของพลาสมาจากคาโทดขณะเคลือบ



(c) ภาพที่ 3-6 ลักษณะและการติดตั้งกาโทด และพลาสมาจากกาโทดของเครื่องเคลือบ

การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาคเพื่อขจัคสิ่งสกปรก ใด้แก่ คราบฝุ่น ใขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผิววัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวหน้าของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์ เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 10 นาที แล้วนำไป ล้างต่อด้วยไอโซโพรพานอล (Isopropanal) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 10 นาที นำวัสดุรองรับขึ้น ด้วยแล้วเป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสุญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-7



ภาพที่ 3-7 ขั้นตอนการถ้างวัสดุรองรับ

ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง

การเคลือบฟิล์มบางโลหะด้วยวิธีแมกนิตรอนสปัตเตอริง ในงานวิจัยนี้มีการจัดเตรียม เครื่องเคลือบโดยสรุปดังนี้ ติดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อศักย์ไฟฟ้าลบ เข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสุญญากาศ ติดตั้งเป้าโครเมียมกับ ขั้วคาโทดซึ่งต่อกับระบบไหลเวียนน้ำเย็นเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสปัตเตอร์บริเวณ ผิวหน้าเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางตรงข้ามคาโทด และอุปกรณ์ชุดควบคุมระบบ ที่ต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) สำหรับควบคุมอัตราไหลของ แก๊สอาร์กอนที่เข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์ม มีรายละเอียคดังนี้

1. การเตรียม นำวัสคุรองรับวางบนแท่นวางวัสคุรองรับ ปิคฝาภาชนะสุญญากาศ

 การสร้างภาวะสุญญากาศ ขั้นตอนนี้เป็นการลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศ ให้มีค่าเท่ากับ 5×10⁻⁵ mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น (P_b) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน P_b ที่อ่านได้

3. การเคลือบ ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์ม โดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้า ภาชนะสุญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง แล้วจ่ายศักย์ไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิด โกลว์ดิสชาร์จ เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่ เปลี่ยนแปลง แล้วจึงเปิดชัตเตอร์เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมจับเวลา ในขั้นนี้ให้บันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) ค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (P,) ที่เกิดขึ้น ขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา (t) ที่กำหนด

 การนำชิ้นงานออกจากภาชนะสุญญากาศ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ให้ปีดแหล่งจ่ายไฟ ปิดการจ่ายแก๊สอาร์กอน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสุญญากาศ เพื่อนำ วัสดุรองรับออก

5. ตรวจเช็กสภาพของชิ้นงานที่เกลือบได้ก่อนเก็บเพื่อส่งวิเกราะห์ต่อไป

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางในงานวิจัยนี้มี 3 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างผลึก ขนาดผลึก โครงสร้างจุลภาค ความหนา และองค์ประกอบทางเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างผลึก ศึกษาจากฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง X-Ray Diffractrometer ซึ่งใช้ CuK_α เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ (λ = 1.54056 Å) โดย
ตรวจวัดใน Mode Low Angle ด้วยมุมตกกระทบคงที่เท่ากับ 2^o กำหนดมุมวัดในช่วง 20^o - 80^o
สเปกตรัมที่วัดได้บันทึกในรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ จากนั้นนำไปเทียบรูปแบบการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์ตามฐานข้อมูล JCPDS และ กฎของแบรกส์ (Bragg's Law) ดังสมการ

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{3-1}$$

เมื่อ λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

n คือ ลำคับของการสะท้อน

d_{hkl} คือ ระยะห่างระหว่างระนาบ (h k l)

heta คือ มุมตกกระทบและมุมสะท้อนเมื่อวัดจากแนวระนาบที่พิจารณา

 ขนาดผลึก สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้ หาจากรูปแบบการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ โดยใช้ สมการของ Scherrer ในการคำนวณหาขนาดผลึกของ ฟิล์มบางโครเมียม ที่ได้หลังการเคลือบ ดังสมการ

$$L = \frac{k\lambda}{\beta\cos\theta}$$
(3-2)

เมื่อ L คือ ขนาดของผลึก

- k คือ ค่าคงที่เท่ากับ 0.9
- λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ (CuK $_{lpha}$ = 1.5406 Å)
- β คือ ความกว้างกรึ่งหนึ่งของพืกที่มีก่ากวามเข้มสูงสุด
- heta คือ ครึ่งหนึ่งของมุมตรงจุดศูนย์กลางพิค

 ค่าคงที่แลตทิซ การหาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยใช้ สมการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มโครเมียม ซึ่งมีโครงสร้างแบบบอดี้เซ็นเตอร์คิวบิก (bcc) จากสมการ (3-3)

ระยะห่างระหว่างระนาบผลึกแบบคิวบิก; $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ (3-3)

 องค์ประกอบทางเคมี นำฟิล์มที่ได้มาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ด้วยเทคนิค EDS ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 3-8



ภาพที่ 3-8 ตัวอย่างผลการตรวจวัดองค์ประกอบทางเกมีของฟิล์มด้วยเทกนิก EDS

5. ลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนา นำฟิล์มมาศึกษาลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนา ด้วยเทคนิค FE-SEM ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 3-9



ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างผลการตรวจวัดลักษณะพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคและความหนาของฟิล์ม ด้วยเทคนิค FE-SEM

หลักการและแนวคิดของการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิค EDS

การวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) ในงานวิจัยนี้เป็นการวัดภายหลังเคลือบแบบไม่ทำลายชิ้นงานซึ่งเป็นการวัดความหนาฟิล์มทางอ้อม โดยอาศัยหลักการและแนวคิดว่า "จำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของฟิล์มบาง ที่เคลือบบนผิวของวัสดุรองรับ จะเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม" ซึ่งอาจพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ (1) พิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นฟิล์มบาง โดยหากสามารถกระตุ้นให้อะตอมของ ธาตุในชั้นฟิล์มปล่อยรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะออกมา ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ ออกมานั้นจะมีค่าแปรผันตรงกับความหนาของชั้นฟิล์ม และทำนองเดียวกัน (2) หากกระตุ้นให้ อะตอมของวัสดุรองรับที่มีชั้นของฟิล์มบางเคลือบปิดทับอยู่ ปล่อยรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะออกมา ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของวัสดุรองรับที่ออกมาจะแปรผกผันกับความหนาของ ชั้นฟิล์ม เนื่องจากรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของวัสดุรองรับที่ออกมาจะแปรผกผันกับความหนาของ รันฟิล์ม เพื่องจากรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของวัสดุรองรับที่ออกมาจะแปรผกผันกับความหนาของ

้จากแนวคิดข้างต้นงานวิจัยนี้ใช้ อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนของ FE-SEM เป็นตัวกระตุ้นให้อะตอมของฟิล์มหรือวัสคุรองรับปล่อยรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะออกมาจากชิ้นงาน ้ โดยเมื่อลำอิเล็กตรอนถูกยิ่งไปที่ชิ้นงาน (ฟิล์มบางโครเมียมที่เคลือบบนซิลิกอนซึ่งเป็นวัสดุรองรับ) แล้วทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบางลงไปถึงชั้นของวัสคุรองรับ ระหว่างนั้นอิเล็กตรอนจะเกิดอันตรกิริยา (Interaction) กับอะตอมของทั้งฟิล์มบางและวัสคุรองรับซึ่งทำให้เกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะปล่อย ้กลับออกมาจากชิ้นงาน (รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะนี้เป็นสัญญาณที่สามารถเกิดขึ้นจากการทำงาน ของเทคนิค FE-SEM ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยระบบ EDS ที่ติดตั้งต่อพ่วงกับเครื่อง FE-SEM) ้โดยระดับกวามลึกที่อิเล็กตรอนสามารถทะลผ่านชิ้นงานลงไปได้ และ ก่ากวามเข้มของรังสีเอกซ์ ้ถักษณะเฉพาะที่ส่งกลับออกมาจากชิ้นงานอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย สำหรับกรณีชิ้นงานที่มี องก์ประกอบของธาตุชนิคเดียวปัจจัยหนึ่งที่มีผล คือ ค่าศักย์เร่งอิเล็กตรอน (Accelerating Voltage) ้ของแหล่งกำเนิคอิเล็กตรอนในเครื่อง FE-SEM เพราะหากใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนที่มีค่าสูง สัญญาณ ที่ได้จากก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย (กรณีนี้สัญญาณดังกล่าวคือรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะทั้งจาก ชั้นฟิล์มหรือวัสครองรับ) ซึ่งสามารถแยกพิจาณาใค้เป็น 2 กรณีคือ (1) การเพิ่มค่าความเข้มของ ้รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ได้จากชั้นฟิล์มตามความหนาของฟิล์มบางที่เพิ่มขึ้น และ (2) การลดค่า ้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ได้จากวัสดรองรับตามความหนาของฟิล์มบางที่เพิ่มขึ้น ้โคยงานวิจัยนี้จะพิจารณาผลของค่าศักย์เร่งอิเล็กตรอนที่มีต่อความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ ทั้งจากชั้นฟิล์มบางและจากวัสครองรับ



ภาพที่ 3-10 ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง

(a) การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง

(b) กราฟปรับเทียบและสมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์มบาง

กรณิพิจารณาค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นฟิล์ม กรณีนี้อิเล็กตรอนที่ ถูกยิงทะลุผ่านเข้าไปในชิ้นงานแล้วเกิดอันตรกิริยากับอะตอมของโครเมียมในฟิล์มบางที่ใช้ศึกษา ทำให้เกิดสัญญาณรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของชั้นฟิล์มบางปล่อยกลับออกมา (ภาพที่ 3-10 (a)) โดยค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่วัดได้จะแปรผันตรงกับจำนวนอะตอมของโครเมียม ในชั้นฟิล์ม ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพแนนเชียล (ภาพที่ 3-10 (b)) การสร้างกราฟปรับเทียบหรือ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรณีนี้ในทางปฏิบัติต้องนำฟิล์มบางที่ทราบชนิดของธาตุและ ความหนา (หรือฟิล์มมาตรฐาน) มาวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิก EDS แล้วจึงนำค่าความหนาของฟิล์มกับค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นฟิล์มมาสร้าง กราฟปรับเทียบและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามสมการ

$$I_{d} = I_{s} \left(1 - e^{-\alpha d} \right)$$
 (3.4)

เมื่อ I_d คือความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความหนา d

- I คือความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะอิ่มตัวของฟิล์ม
- α คือค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น
- d คือความหนาของฟิล์มที่ศึกษา





(a) การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ

(b) กราฟปรับเทียบและสมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ

สำหรับกรณีพิจารณาก่าความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นของวัสดุรองรับ กรณีนี้ เมื่ออิเล็กตรอนยิงทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบาง ถ้าหากให้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนที่มากพอ อิเล็กตรอนจะ ทะลุผ่านชั้นฟิล์มลงไปถึงชั้นของวัสดุรองรับ แล้วทำให้เกิดสัญญาณรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจาก วัสดุรองรับ แต่เนื่องจากชิ้นงานมีชั้นของฟิล์มเคลือบปิดทับวัสดุรองรับ จึงทำให้เกิดการดูดกลืน รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเนื่องอะตอมของธาตุที่เป็นองก์ประกอบในชั้นฟิล์ม ซึ่งส่งผลให้กวามเข้ม ของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชิ้นงานมีก่าลดลงตามกวามหนาฟิล์มที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 3-11 (a)) สัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพแนนเชียล (ภาพที่ 3-11 (b)) โดยการสร้างกราฟปรับเทียบหรือแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ ทำได้เช่นเดียวกับกรณีพิจารฉากวามเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นฟิล์ม โดยก่าความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชั้นของกัสดุรองรับเป็นไปตามสมการ

เมื่อ I_d คือความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความหนา d

- I คือความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะอิ่มตัวของฟิล์ม
- α คือค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น
- d คือความหนาของฟิล์มที่ศึกษา

แนวทางการทดลอง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิค EDS โดยพิจารณาความเข้ม ของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะทั้ง 2 กรณีคือจากชั้นฟิล์มและจากวัสดุรองรับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ (1) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ (2) การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

1. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

1.1 การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมสำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ขั้นนี้เป็น การเคลือบฟิล์มโครเมียมด้วยวิธีสปัตเตอริง บนกระจกสไลด์และซิลิกอน เมื่อใช้เวลาเคลือบต่าง ๆ เท่ากับ 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 และ 30.0 นาที (กำหนดให้เป็นฟิล์มบางชุดที่ 1) สำหรับเงื่อนไข การเคลือบสรุปได้ดังตารางที่ 3-1 จากนั้นนำฟิล์มที่ได้ไปศึกษาลักษณะเฉพาะซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ด้วยเทคนิค XRD ส่วนความหยาบผิวศึกษาด้วยเทคนิค AFM สุดท้ายศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความหนาด้วยเทคนิค FE-SEM

 1.2 การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางชุดที่ 1 ด้วยเทคนิค EDS โดย นำฟิล์มบางโครเมียมที่เคลือบได้บนแผ่นซิลิกอน ที่เวลาการเคลือบต่าง ๆ กัน ไปวิเคราะห์ความเข้ม ของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ โดยใช้ค่าศักย์เร่งอิเล็กตรอนในการวิเคราะห์ต่างกัน 2 ค่าคือ 6 kV และ 10 kV และพิจารณาพีคของ Cr L_α จากฟิล์มบางซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม และ พีคของ Si K_α จากวัสดุรองรับซึ่งมีค่าลดลงตามความหนาฟิล์ม

1.3 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำได้โดยใช้ก่าความหนาของฟิล์มบาง จากเทคนิค FE-SEM และค่าความเข้มรังสีลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1 จาก ข้อ 1.2 มาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ SOLVER ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณ ประเภท Linear Programming ซึ่งเป็น Add-Ins ของโปรแกรม EXCEL ในการช่วยหาคำตอบที่ เหมาะสมที่สุด (Optimization) ซึ่งในงานวิจัยนี้คือสมการความสัมพันธ์ของความเข้มรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่วัดค้วยเทคนิค EDS และความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ซึ่งสัมพันธ์ กันแบบเอกซ์โพเนนเซียล ตามสมการ (3.4) เมื่อพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์ม และ สมการ (3.5) เมื่อพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ

2. การทคสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

2.1 การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมสำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดย การเคลือบฟิล์มโครเมียมด้วยวิธีสปัตเตอริง บนกระจกสไลด์และซิลิกอน เมื่อใช้เวลาเคลือบต่าง ๆ เท่ากับ 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 และ 27.5 นาที (กำหนดให้เป็นฟิล์มบางชุดที่ 2) สำหรับเงื่อนไข การเคลือบสรุปดังตารางที่ 3-1 ฟิล์มที่เตรียมได้จะนำไปศึกษาลักษณะเฉพาะได้แก่ โครงสร้างผลึก งนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ด้วยเทคนิค XRD ส่วนความหยาบผิวศึกษาด้วยเทคนิค AFM สุดท้าย ศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความหนาด้วยเทคนิค FE-SEM

2.2 การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางชุดที่ 2 ด้วยเทคนิค EDS โดย นำฟิล์มบางโครเมียมที่เคลือบได้บนแผ่นซิลิกอน ที่เวลาการเคลือบต่าง ๆ กัน ไปวิเคราะห์ความเข้ม ของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ โดยใช้ก่าศักย์เร่งอิเล็กตรอนในการวิเคราะห์ต่างกัน 2 ก่าคือ 6 kV และ 10 kV และพิจารณาพีกของ Cr L_α จากฟิล์มบางซึ่งมีก่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม และ พีกของ Si K_α จากวัสดุรองรับซึ่งมีก่าลดลงตามความหนาฟิล์ม

2.3 การเปรียบเทียบความหนาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับความหนาจาก เทคนิค FE-SEM ขั้นนี้เป็นการเปรียบเทียบความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มชุดที่ 2 กับความหนาฟิล์มที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น โดยพิจารณาความแตกต่างของ ค่าที่คำนวณได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับค่าที่ได้จากเทคนิค FE-SEM

٩، ٢	รายละเอียด		
พารามเตอร	ฟิล้มบางชุดที่ 1	ฟิล์มบางชุดที่ 2	
เป้าสารเคลือบ	โครเมียม (Cr)		
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์และซิลิกอน		
อุณหภูมิวัสคุรองรับ	อุณหภูมิห้อง		
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสคุรองรับ (cm)	15		
ความคันพื้น (mbar)	$5.0 imes 10^{-5}$		
ความคันรวม (mbar)	5.0×10^{-3}		
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	20.0		
กระแสไฟฟ้า (mA)	300		
เวลาเคลื่อบ (min)	5.0, 10.0, 15.0,	7.5, 12.5, 17.5,	
	20.0, 25.0, 30.0	22.5, 27.5	

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมที่ใช้ในงานวิจัย

บทที่ 4 ผลและอภิปรายผลการวิจัย

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ส่วนนี้เป็นรายงานผลการสร้างกราฟปรับเทียบและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ ใช้วัดความหนาของฟิล์มบาง โครเมียมจากเทคนิคเอกซ์เรย์สเปค โตรส โคปีแบบกระจายพลังงาน อาศัยหลักการว่า อะตอมของ โครเมียมในฟิล์มจะเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม ซึ่งทำให้ความเข้ม ของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ โครเมียมจากฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา หรือ กรณีพิจารณา รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากซิลิกอนซึ่งเป็นวัสดุรองรับ โดยความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ ของซิลิกอนจะมีค่าลดลงตามความหนาของฟิล์มที่เคลือบปิดทับ ขั้นนี้แบ่งงานเป็น 3 ตอนได้แก่ การเตรียมฟิล์มบาง โครเมียมสำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

1. การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมสำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ส่วนนี้เป็นผลการเตรียมฟิล์มบางโครเมียม (ฟิล์มบางชุดที่ 1) จากระบบสปัตเตอริง บนกระจกสไลด์ เมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 และ 30.0 นาที ผลการศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางภายภาพ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค ดังนี้

ฟิล์มบาง โครเมียมชุดที่ 1 ที่เคลือบบนกระจกส ไลด์ เมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ พบว่าผิวหน้าของฟิล์มมีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาวทึบแสงและสะท้อนแสงคี (ภาพที่ 4-1) โดยฟิล์มบางชุดนี้ความหนามีก่าอยู่ในช่วง 50.5 - 284.5 nm







ภาพที่ 4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุคที่ 1

ภาพที่ 4-2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบาง โครเมียมชุดที่ 1 ซึ่งเคลือบบนซิลิกอน ทั้งนี้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มชุดที่ 1 ที่ได้มี การเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ใช้ในการเคลือบ โดยฟิล์มที่เตรียมได้เมื่อใช้เวลาการเคลือบในช่วง 5.0 – 10.0 นาที ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เนื่องจากฟิล์มที่ได้อาจมีโครงสร้างเป็น แบบอสัณฐานหรือฟิล์มยังมีความหนาน้อยมาก แต่เมื่อเพิ่มเวลาการเคลือบ (15.0 นาทีขึ้นไป) พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม ประมาณ 44.02^o - 44.9^o ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมที่ระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิก (bcc) ทั้งนี้ยังพบอีกว่าความเข้มของรูปแบบ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ยังมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการเคลือบที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับ ความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก และค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางชุดที่ 1 สรุปได้ดัง ตารางที่ 4-1 ทั้งนี้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นตามเวลาการเคลือบ โดยฟิล์มที่ใช้ เวลาเคลือบเท่ากับ 5.0 นาที ฟิล์มหนาเท่ากับ 50.5 nm และเพิ่มเป็น 284.5 nm เมื่อใช้เวลาเคลือบ เท่ากับ 30 นาที เนื่องจากเมื่อใช้เวลาการเคลือบเพิ่มขึ้นอะตอมของสารเคลือบที่ถูกสปัตเตอร์ออกมา ตกเคลือบแล้วควบแน่นสะสมพอกพูนเป็นชั้นของฟิล์มบางหนาเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการเคลือบ ขนาดผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบซึ่งคำนวณจากสมการ Scherrer พบว่าเมื่อเวลาที่ใช้

ในการเกลือบเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ้น จาก 32.3 nm เป็น 38.1 nm โดยฟิล์มชุดที่เกลือบด้วย เวลาเท่ากับ 5.0 และ 10.0 นาที ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เนื่องจากฟิล์มอาจมีโครงสร้าง ผลึกแบบอสัณฐานทำให้ไม่สามารถคำนวณขนาดผลึกได้

ส่วนค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางชุดที่ 1 ซึ่งคำนวณจากสมการระยะห่างระหว่าง ระนาบผลึกที่มีโครงสร้างแบบคิวบิก พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ มีค่าอยู่ในช่วง 4.5808 Å - 4.5946 Å ใกล้เคียงค่าคงที่แลตทิซของโครเมียมตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 สำหรับความ หยาบผิวของฟิล์มพบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นความหยาบผิวของฟิล์มที่เตรียมได้มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm แสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีพื้นผิวของหน้าฟิล์มที่เรียบเป็นอย่างคื

เวลาเคลือบ	ความหนา	ขนาดผลึก	ค่าคงที่แลตทิช	ความหยาบผิว
(นาที)	(nm)	(nm)	(Å)	(nm)
5.0	50.5	N/A	N/A	0.3
10.0	94.0	N/A	N/A	0.7
15.5	143.0	32.3	4.5877	0.8
20.0	191.0	34.9	4.5907	1.0
25.0	232.5	36.5	4.5897	0.9
30.0	284.5	38.1	4.5946	1.3

ตารางที่ 4-1 ค่าความหนา ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ความหยาบผิว ของฟิล์มบาง โครเมียมชุดที่ 1

ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะ โครงสร้างจุลภาคและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง โครเมียม จากการศึกษาด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มตลอดจนขนาดเกรนของฟิล์ม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เคลือบด้วยเวลาเท่ากับ 5.0 และ 10.0 นาที สารเคลือบมีการกระจายตัวทั่วผิวหน้าของฟิล์มซึ่งมีลักษณะเรียบสม่ำเสมอดี ความหยาบผิวมี ค่าประมาณ 0.3 – 0.7 nm ส่วนฟิล์มที่เคลือบเมื่อใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 15.0, 20.0, 25.0 และ 30.0 นาที เกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยมยาวยอดแหลมกระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์ม ขนาดของเกรน ใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบเพิ่มขึ้น และความหยาบผิวเพิ่มขึ้นมีค่าประมาณ 0.8 – 1.3 nm (ตารางที่ 4-1) เนื่องจากเมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบเพิ่มขึ้นอะตอมของสารเคลือบที่ตกเคลือบสะสม พอกพูนเป็นชั้นฟิล์มมีมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้เกิดความร้อนจากการตกเคลือบของอะตอมสารเคลือบ ซึ่งส่งผลให้มีพลังงานในการเคลื่อนไหวสูง (Mobility) นอกจากนี้ขณะที่เกิดการเคลือบอะตอมของ สารเคลือบจะมีพฤติกรรมคล้ายของเหลว (Liquid Like Behavior) ซึ่งเคลื่อนที่จนไปชนและรวมตัว กันเป็นชั้นของฟิล์มที่หนาขึ้น เกรนของฟิล์มจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นตามเวลาที่ใช้เกลือบ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาคตัดขวางของฟิล์มบางที่เคลือบได้ พบว่าฟิล์มที่ใช้เวลาในการเคลือบ เท่ากับ 5.0 และ 10.0 นาที เนื้อฟิล์มมีโครงสร้างทึบแน่นไม่มีช่องว่าง และเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 15.0, และ 20.0 นาที ฟิล์มเริ่มรวมกันเป็นกลุ่มก้อนมีลักษณะ โครงสร้างเป็นแบบแท่งแต่ยังไม่ชัดเจน ต่อมาเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มเป็น 25.0 และ 30.0 นาที พบว่าฟิล์มมีโครงสร้างเป็นแบบแท่งแหลมเรียว ในลักษณะคอลัมนาร์ชัดเจนมากขึ้น และมีช่องว่างในเนื้อฟิล์มค่อนข้างน้อย ส่วนความหนาของ ฟิล์มที่ได้พบว่าเมื่อเวลาในการเคลือบเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มเพิ่มจาก 50.5 nm เป็น 284.5 nm (ตารางที่ 4-1) เนื่องจากเมื่อเวลาในการเคลือบเพิ่ม อะตอมสารเคลือบตกลงวัสดุรองรับได้มากขึ้น ทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนามากขึ้น

55



ภาพที่ 4-3 ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมเมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ (a) 5.0 นาที (b) 10.0 นาที (c) 15.0 นาที (d) 20.0 นาที (e) 25.0 นาที (f) 30.0 นาที

57



ภาพที่ 4-3 ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมเมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ (a) 5.0 นาที (b) 10.0 นาที (c) 15.0 นาที (d) 20.0 นาที (e) 25.0 นาที (f) 30.0 นาที

2. การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1

เมื่อนำฟิล์มบางชุดที่ 1 ไปวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS โดยใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนต่างกัน 2 ค่า คือ 6 kV และ 10 kV พบว่าค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากฟิล์มบางและวัสดุรองรับ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามศักย์เร่งอิเล็กตรอนและความหนาของฟิล์มบาง ดังแสดงในตารางที่ 4-2 โดยภาพที่ 4-4 เป็นตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ ฟิล์มบางจากเทคนิค EDS และลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 1 โดยพบว่า

2.1 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α ที่ได้จากฟิล์มบาง พบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV สำหรับฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm ได้ความเข้มพีคของ Cr L_α เท่ากับ 32.88 C/S และเพิ่มขึ้นมีค่าเป็น 102.64 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 284.5 nm และเมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm ได้ความเข้มพีค ของ Cr L_α เท่ากับ 33.73 C/S และเพิ่มเป็น 136.94 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 284.5 nm

จากผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของชิ้นงานเมื่อพิจารณาพีคของ Cr L_α จากฟิล์มบางพบว่าความเข้มพีคของ Cr L_α มีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์มบาง เนื่องจากเมื่อยิง อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนไปที่ฟิล์มโครเมียมซึ่งเคลือบบนซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับ โดยอิเล็กตรอนที่ถูกยิงเข้าไปจะเกิดอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนชั้นในของอะตอม เกิดการถ่ายโอน พลังงานทำให้อิเล็กตรอนชั้นในมีพลังงานสูงขึ้นมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นโคจรจึงหลุด ออกมาจากวงโคจร ทำให้เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนวงในที่ชั้นโคจรนั้น ซึ่งเป็นผลให้อะตอมดังกล่าว อยู่ในสถานะกระตุ้น จากนั้นอะตอมจะลดระดับพลังงานลงสู่สภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงสู่สภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรชั้นถึงไปจะลดระดับพลังงานลงมาเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงจรที่ เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน โดยปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปของรังสีเอกซ์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ ออกมา (วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา, 2543) ความเข้มของพีก Cr L_α จากฟิล์มโครเมียมที่เคลือบบน ซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับจึงมีก่ามากขึ้นเมื่อฟิล์มโครเมียมหนามากขึ้น โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน เท่ากับ 10 kV ก็พบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

หากพิจารณากรณีที่ใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานของอิเล็กตรอน จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ต่างกัน พบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV ความเข้มพีคของ Cr Lα จากฟิล์มบางโครเมียมจะมีค่าน้อยกว่าที่ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV เนื่องจาก ที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV อิเล็กตรอนมีโอกาส ทะลุผ่านชั้นฟิล์มลงไปทำอันตรกิริยากับอะตอมของโครเมียมในฟิล์มได้มากกว่าที่ศักย์เร่ง อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV ทำให้ความเข้มพีคของ Cr Lα จากฟิล์มบางเพิ่มขึ้นตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน 2.2 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสคุรองรับ พบว่า โดยพบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV สำหรับฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm ได้ความเข้มพีคของ Si K_α มีค่าเท่ากับ 349.18 C/S และมีค่าลดลงเป็น 1.18 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 284.5 nm และเมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm ได้ความเข้มพีค ของ Si K_α มีค่าเท่ากับ 2259.87 C/S และมีค่าลดลงเท่ากับ 303.40 C/S เมื่อฟิล์มบางมีความหนา เท่ากับ 284.5 nm

จากผลการวิเกราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของชิ้นงานเมื่อพิจารณาพีคของ Si K_a จากวัสดุรองรับ พบว่าความเข้มพีคของ Si K_a มีค่าลดลงตามความหนาของฟิล์มบาง โครเมียมที่ เคลือบบนแผ่นซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับ โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน 6 kV เมื่อยิงอิเล็กตรอนไปที่ ฟิล์ม โครเมียมซึ่งเคลือบบนวัสดุรองรับ อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนจะเสียพลังงาน บางส่วนเมื่อทะลุผ่านชั้นฟิล์ม โครเมียม และเมื่อลงไปถึงชั้นของซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับแล้วเกิด อันตรกิริยากับอิเล็กตรอนวงในของซิลิกอนทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออก จากนั้นอิเล็กตรอนชั้น ถัดไปจะลดระดับชั้นพลังงานเข้าแทนที่ โดยคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ แต่รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ Si K_a จากวัสดุรองรับค้องผ่านชั้นฟิล์ม โครเมียมออกมาซึ่งกรณีนี้ทำให้ ความเข้มของรังสีเอกซ์ Si K_a จากวัสดุรองรับมีก่าลดลงตามความหนาของฟิล์ม โครเมียมที่เพิ่มขึ้น โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน 10 kV กีพบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับความเข้มพีคของ Si Kα จากวัสดุรองรับมีค่าเพิ่มขึ้นตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน เมื่อความหนาของฟิล์มที่ 50.5 nm เนื่องจากพลังงานในการเร่งเข้าชนของอิเล็กตรอนมีพลังงานต่ำ วิ่งเข้าไปในเนื้อวัสดุรองรับได้น้อยและวิ่งเข้าชนอิเล็กตรอนวงในจึงหลุดได้ยาก เมื่อทำการวัดความ เข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจะวัดได้น้อยกว่าการใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนพลังงานสูง และเมื่อพิจารณา ความหนาที่ 284.5 nm ก็พบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

ศักย์เร่งอิเล็กตรอน	เวลาการเคลือบ	ความหนา	ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ (C/S)	
(kV)	(min)	(nm)	Cr La	Si Ka
6	5.0	50.5	32.88	349.18
	10.0	94.0	54.69	128.99
	15.0	143.0	59.33	35.55
	20.0	191.0	60.85	7.09
	25.0	232.5	57.81	3.44
	30.0	284.5	102.64	1.18
10	5.0	50.5	33.73	2259.87
	10.0	94.0	63.85	1753.85
	15.0	143.0	89.69	1116.66
	20.0	191.0	101.97	686.29
	25.0	232.5	120.2	405.38
	30.0	284.5	136.94	303.40

ตารางที่ 4-2 ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1 สำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์








- ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS และ ลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 1
 - (a) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 50.5 nm
 - (b) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 284.5 nm

3. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

งานวิจัยนี้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชิ้นงาน (ฟิล์มบางที่เคลือบบนซิลิกอน) โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ (1) พิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของCr La จากฟิล์มบาง และ (2) เมื่อพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si Ka จากวัสคุรองรับ

3.1 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง สมการของแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น เมื่อใช้ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของพีค Cr Lα จาก ฟิล์มบางที่ได้จากเทคนิค EDS และความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM พบว่ามีความสัมพันธ์ กันตามสมการ

$$I_d = 107.16 (1 - e^{-0.0048 d})$$
 (4.1)

$$I_d = 203.28 (1 - e^{-0.0039 d})$$
 (4.2)

เมื่อ I₄ คือ ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางที่มีความหนา d โดย สมการ 4.1 ใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV ส่วนสมการ 4.2 ใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV เมื่อนำมาสร้างกราฟปรับเทียบจะแสดงได้ดังภาพที่ 4-5 และ 4-6 ตามลำดับ ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ ของค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะและความหนาของฟิล์มทั้ง 2 กรณีมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α จากฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา ของฟิล์มบาง โดยช่วงแรกความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α จากฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา ของฟิล์มบาง โดยช่วงแรกความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α จากฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตาม ความหนาของฟิล์ม (ในช่วง 0 – 250 nm) เนื่องจากชั้นฟิล์มยังมีความหนาน้อยอิเล็กตรอนจาก แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนจึงสามารถทะลุผ่านชั้นฟิล์มบางลงไปทำอันตรกิริยากับอะตอมโครเมียม เกิดเป็นรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะออกมาได้มา จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ (ในช่วง 250 – 1000 nm) เนื่องจากช่วงนี้ฟิล์มเริ่มมีความหนามากขึ้นทำให้อิเล็กตรอนทะลุลงไปได้น้อยลง จนช่วงสุดท้าย ค่ารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเพิ่มเข้าสู่ค่าความเข้มอิ่มดัวในที่สุดเมื่อความหนามากกว่า 1000 nm ช่วงนี้อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบางลงไปได้อีกกวามเข้ม รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจึงมีค่าค่อนข้างคงที่



ภาพที่ 4-5 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์มบาง เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV



ภาพที่ 4-6 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์มบาง เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV

3.2 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ สมการของแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น เมื่อใช้ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของพีค Si K_α ของ วัสดุรองรับจากเทคนิค EDS และความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ตามสมการ

$$I_d = 855.44 e^{-0.0192 d}$$
 (4.3)

$$I_d = 3735.73 e^{-0.0088 d}$$
 (4.4)

เมื่อ I₄ คือ ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางที่มีความหนา d โดย สมการ 4.1 ใช้ศักย์เร่งอิเล็กครอนเท่ากับ 6 kV ส่วนสมการ 4.2 ใช้ศักย์เร่งอิเล็กครอนเท่ากับ 10 kV เมื่อนำมาสร้างกราฟปรับเทียบจะแสดงได้ดังภาพที่ 4-7 และ 4-8 ตามลำดับ ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ ของค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะและความหนาของฟิล์มทั้ง 2 กรณีมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si Ka จากวัสดุรองรับมีค่าลดลงตามความหนา ของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงแรกความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมีค่าลดลงตามความหนา ของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงแรกความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วตาม ความหนาฟิล์ม (ในช่วง 0 – 150 nm สำหรับศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV และ ช่วง 0- 300 nm สำหรับศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV) เนื่องจากเมื่อฟิล์มบางมีความหนาเพิ่มขึ้นอิเล็กตรอนจาก แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนส่วนใหญ่เสียพลังงานไปในชั้นฟิล์มโครเมียม ทำให้อิเล็กตรอนที่ผ่านไปลึง ชั้นของวัสดุรองรับมีก่าน้อย ทำให้ช่วงนี้มีรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับน้อยตามไปด้วย โดยการลดลงของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อฟิล์มมีความหนา ในช่วง 150 – 250 nm สำหรับศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV และ ในช่วง 300 - 500 nm สำหรับ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV แต่ลดในลักษณะช้า ๆ ต่างจากช่วงแรก จนสุดท้ายก่าความเข้มของ รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมีก่าลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์ เมื่อฟิล์มมีความหนามากกว่า 250 nm สำหรับ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV และ มากกว่า 500 nm สำหรับศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากงามหนามากกว่า 10 kv



ภาพที่ 4-7 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสดุรองรับ เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV



ภาพที่ 4-8 กราฟปรับเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV

การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ส่วนนี้เป็นผลทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งสร้างจากฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1 ขั้นนี้แบ่งการคำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนย่อยได้แก่ การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมสำหรับทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS และการเปรียบเทียบค่าความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และความหนาฟิล์มจากแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

1. การเตรียมฟิล์มบางโครเมียมสำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ฟิล์มบางโครเมียมสำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ฟิล์มบางชุดที่ 2) เคลือบด้วยระบบสปัตเตอริง บนกระจกสไลด์ เมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 และ 27.5 นาที ผลการศึกษาประกอบด้วย ลักษณะทางภายภาพ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค ดังนี้ ฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2 ที่เคลือบบนกระจกสไลด์และซิลิกอน เมื่อแปรค่าเวลาใน การเคลือบ พบว่าผิวหน้าของฟิล์มมีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาวทึบแสงและสะท้อนแสงดี

(ภาพที่ 4-9) โดยฟิล์มบางชุดนี้ความหนามีก่าอยู่ในช่วง 70.5 - 263.5 nm



ภาพที่ 4-9 ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2 สำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์



ภาพที่ 4-10 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2

ภาพที่ 4-10 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบาง โครเมียมชุดที่ 2 ซึ่งเคลือบบนซิลิกอน ทั้งนี้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มชุดที่ 2 ที่เตรียม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ใช้ในการเคลือบ โดยฟิล์มชุดที่เตรียมได้เมื่อใช้เวลาเคลือบ เท่ากับ 7.5 นาที ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เนื่องจากฟิล์มที่ได้อาจมีโครงสร้างแบบ อสัณฐานหรือฟิล์มที่เตรียมได้มีความหนาน้อยมาก แต่เมื่อเพิ่มเวลาการเคลือบ (12.5 นาทีขึ้นไป) พบรูปแบบการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 44.11° - 44.16° ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบบอลี้เซนเตอร์คิวบิก (bcc) ทั้งนี้ยังพบอีกว่าความเข้มของรูปแบบการ เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ยังมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ใน การเคลือบที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับ ความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก และค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางชุดที่ 2 สรุปได้ดัง ตารางที่ 4-3 พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการเคลือบ โดยฟิล์มที่ใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 7.5 นาที ฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 70.5 nm และเพิ่มเป็น 263.5 nm เมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 27.5 นาที เนื่องจากเมื่อใช้เวลาการเคลือบเพิ่มขึ้นอะตอมของสารเคลือบที่ ถูกสบัตเตอร์ออกมาตกเคลือบแล้วควบแน่นสะสมพอกพูนเป็นชั้นของฟิล์มบางหนาเพิ่มขึ้นตาม เวลาที่ใช้ในการเคลือบ

ในส่วนของขนาดผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบซึ่งคำนวณจากสมการ Scherrer พบว่า เมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ้น จาก 31.7 nm เป็น 37.3 nm โดยฟิล์มที่ เคลือบด้วยเวลาเท่ากับ 7.5 นาที ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ซึ่งอาจมีโครงสร้างผลึก แบบอสัณฐานจึงไม่สามารถคำนวณขนาดผลึกได้

ส่วนค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางชุคที่ 2 ซึ่งคำนวณจากสมการระยะห่างระหว่าง ระนาบผลึกที่มีโครงสร้างแบบคิวบิก พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ มีค่าอยู่ในช่วง 4.5808 – 4.5852 Å ใกล้เคียงค่าคงที่แลตทิซของโครเมียมตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 สำหรับความ หยาบผิวของฟิล์มพบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นความหยาบผิวของฟิล์มที่เตรียมได้มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm แสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีพื้นผิวของหน้าฟิล์มที่เรียบเป็นอย่างคื

เวลาเคลือบ	ความหนา	ขนาดผลึก	ค่าคงที่แลตทิช	ความหยาบผิว
(นาที)	(nm)	(nm)	(Å)	(nm)
7.5	70.5	N/A	N/A	0.5
12.5	122.0	31.7	4.5833	0.8
17.5	165.0	33.6	4.5808	0.9
22.5	210.0	35.7	4.5823	1.0
27.5	263.5	37.3	4.5852	1.2

ตารางที่ 4-3 ค่าความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบาง โครเมียมชุดที่ 2

ภาพที่ 4-11 แสดงลักษณะ โครงสร้างจุลภาคและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียม ที่เคลือบได้ จากการศึกษาด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มตลอดจนขนาดเกรน ของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเคลือบโดยใช้เวลา 7.5 นาที เกรนมี ลักษณะเป็นเม็ดกลมกระจายทั่วผิวหน้าฟิล์ม โดยรวมค่อนข้างเรียบส่วนฟิล์มที่เคลือบโดยใช้เวลา เพิ่มขึ้นเป็น 12.5, 17.5, 22.5 และ 27.5 นาที เกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็น แท่งเหลี่ยมพีระมิดยอด แหลมกระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์ม ขนาดของเกรนใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบเพิ่มขึ้น และ ความหยาบผิวเพิ่มจาก 0.5 nm เป็น 1.2 nm (ตารางที่ 4-3) เนื่องจากเมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบ เพิ่มขึ้นอะตอมของสารเกลือบที่ตกเคลือบสะสมพอกพูนเป็นชั้นฟิล์มมีมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้เกิด ความร้อนจากการตกเคลือบของอะตอมสารเคลือบซึ่งส่งผลให้มีพลังงานในการเคลื่อนไหวสูง นอกจากนี้ขณะที่เกิดการเคลือบอะตอมของสารเคลือบจะมีพฤติกรรมคล้ายของเหลว ซึ่งเคลื่อนที่ จนไปชนและรวมตัวกันเป็นชั้นของฟิล์มที่มีความหนาเพิ่มขึ้น เกรนของฟิล์มจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามเวลาที่ใช้เคลือบ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาคตัดขวางของฟิล์มที่เคลือบได้ จะเห็นว่าเมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 7.5 นาที เนื้อฟิล์มมีโครงสร้างเป็นแบบแท่งในลักษณะคอลัมนาร์และมีช่องว่างในเนื้อฟิล์มค่อนข้าง น้อย และเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 12.5, 17.5, 22.5 และ 27.5 นาที ฟิล์มมีโครงสร้างเป็นแบบแท่งมี ลักษณะแหลมเรียว แบบคอลัมนาร์และมีช่องว่างในเนื้อฟิล์มค่อนข้างน้อย ในส่วนของความหนา ของฟิล์มพบว่าเวลาในการเคลือบเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มมีค่าเพิ่มจาก 70.5 nm เป็น 263.5 nm (ตารางที่ 4-3) เนื่องจากเมื่อเวลาในการเคลือบเพิ่ม อะตอมสารเคลือบตกลงวัสดุรองรับได้มากขึ้น ทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนามากขึ้น





ภาพที่ 4-11 ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางโครเมียมเมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ (a) 7.5 นาที (b) 12.5 นาที (c) 17.5 นาที (d) 22.5 นาที (e) 27.5 นาที



ภาพที่ 4-11 ภาคตัดขวางและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง โครเมียมเมื่อแปรค่าเวลาในการเคลือบ (a) 7.5 นาที (b) 12.5 นาที (c) 17.5 นาที (d) 22.5 นาที (e) 27.5 นาที

2. การวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 2

เมื่อนำฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS โดยใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนต่างกัน 2 ค่า คือ 6 kV และ 10 kV พบว่าค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากฟิล์มบางและวัสดุรองรับ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามศักย์เร่งอิเล็กตรอนและความหนาของฟิล์มบาง ดังแสดงในตารางที่ 4-4 โดยภาพที่ 4-13 เป็นตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจาก ฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS และลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 2 โดยพบว่า

2.1 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α ที่ได้จากฟิล์มบาง พบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV สำหรับฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm ได้ความเข้มพีคของ Cr L_α เท่ากับ 42.02 C/S และเพิ่มขึ้นมีค่าเป็น 95.54 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 2863.5 nm และเมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm ได้ความเข้มพีค ของ Cr L_α เท่ากับ 49.23 C/S และเพิ่มเป็น 128.55 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 263.5 nm

จากผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของชิ้นงานเมื่อพิจารณาพีคของ Cr L_α จากฟิล์มบางพบว่าความเข้มพีคของ Cr L_α มีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์มบาง เนื่องจากเมื่อยิง อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนไปที่ฟิล์มโครเมียมซึ่งเคลือบบนซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับ โดยอิเล็กตรอนที่ถูกยิงเข้าไปจะเกิดอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนชั้นในของอะตอม เกิดการถ่ายโอน พลังงานทำให้อิเล็กตรอนชั้นในมีพลังงานสูงขึ้นมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นโคจรจึงหลุด ออกมาจากวงโคจร ทำให้เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนวงในที่ชั้นโคจรนั้น ซึ่งเป็นผลให้อะตอมดังกล่าว อยู่ในสถานะกระตุ้น จากนั้นอะตอมจะลดระดับพลังงานลงสู่สภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงสู่สภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรชั้นถึงไปจะลดระดับพลังงานลงมาเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงจรที่ เกิดที่ว่างของอิเล็กตรอน โดยปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปของรังสีเอกซ์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ ออกมา (วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา, 2543) ความเข้มของพีก Cr L_α จากฟิล์มโครเมียมที่เคลือบบน ซิลิกอนที่เนวัสดุรองรับจึงมีค่ามากขึ้นเมื่อฟิล์มโครเมียมหนามากขึ้น โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน เท่ากับ 10 kV ก็พบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

หากพิจารณากรณีที่ใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานของอิเล็กตรอน จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ต่างกัน พบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV ความเข้มพีคของ Cr Lα จากฟิล์มบางโครเมียมจะมีค่าน้อยกว่าที่ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV เนื่องจาก ที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV อิเล็กตรอนมีโอกาส ทะลุผ่านชั้นฟิล์มลงไปทำอันตรกิริยากับอะตอมของโครเมียมในฟิล์มได้มากกว่าที่ศักย์เร่ง อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV ทำให้ความเข้มพีคของ Cr Lα จากฟิล์มบางเพิ่มขึ้นตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน 2.2 กรณีพิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสคุรองรับ พบว่า โดยพบว่าเมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV สำหรับฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm ได้ความเข้มพีคของ Si K_α มีค่าเท่ากับ 215.63 C/S และมีค่าลดลงเป็น 4.57 C/S เมื่อฟิล์มมีความหนาเท่ากับ 263.5 nm และเมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm ได้ความเข้มพีค ของ Si K_α มีค่าเท่ากับ 2049.61 C/S และมีค่าลดลงเท่ากับ 407.75 C/S เมื่อฟิล์มบางมีความหนา เท่ากับ 263.5 nm

จากผลการวิเกราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของชิ้นงานเมื่อพิจารณาพีคของ Si K_a จากวัสดุรองรับ พบว่าความเข้มพีคของ Si K_a มีค่าลดลงตามความหนาของฟิล์มบาง โครเมียมที่ เคลือบบนแผ่นซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับ โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน 6 kV เมื่อยิงอิเล็กตรอนไปที่ ฟิล์ม โครเมียมซึ่งเคลือบบนวัสดุรองรับ อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนจะเสียพลังงาน บางส่วนเมื่อทะลุผ่านชั้นฟิล์ม โครเมียม และเมื่อลงไปถึงชั้นของซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับแล้วเกิด อันตรกิริยากับอิเล็กตรอนวงในของซิลิกอนทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออก จากนั้นอิเล็กตรอนชั้น ถัดไปจะลดระดับชั้นพลังงานเข้าแทนที่ โดยคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ แต่รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ Si K_a จากวัสดุรองรับค้องผ่านชั้นฟิล์ม โครเมียมออกมาซึ่งกรณีนี้ทำให้ ความเข้มของรังสีเอกซ์ Si K_a จากวัสดุรองรับมีก่าลดลงตามความหนาของฟิล์ม โครเมียมที่เพิ่มขึ้น โดยที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอน 10 kV ก็พบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

สำหรับความเข้มพีคของ Si Kα จากวัสดุรองรับมีค่าเพิ่มขึ้นตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน เมื่อความหนาของฟิล์มที่ 70.5 nm เนื่องจากพลังงานในการเร่งเข้าชนของอิเล็กตรอนมีพลังงานต่ำ วิ่งเข้าไปในเนื้อวัสดุรองรับได้น้อยและวิ่งเข้าชนอิเล็กตรอนวงในจึงหลุดได้ยาก เมื่อทำการวัดความ เข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจะวัดได้น้อยกว่าการใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนพลังงานสูง และเมื่อพิจารณา ความหนาที่ 263.5 nm ก็พบลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

จากทั้งสองกรณีแสดงให้เห็นว่าความเข้มของ Cr L_a เพิ่มขึ้น การรวมตัวกันของ ฟิล์มโครเมียมที่เคลือบบนวัสดุรองรับมีมากขึ้นเป็นผลทำให้ความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้นนั่นเอง ในทางตรงกันข้ามเมื่อวัคความเข้มจากซิลิกอนซึ่งเป็นวัสดุรองรับ ความเข้ม Si K_a ที่ได้จะมีค่าลดลง ตามความหนาของฟิล์มที่มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากชั้นฟิล์มที่เคลือบมีความหนามากขึ้นทำให้อำนาจใน การทะลุผ่านของอิเล็กตรอนจากปืนอิเล็กตรอนไปที่วัสดุรองรับมีค่าลดลง ซึ่งในการลดลงของ ซิลิกอนจะแปรผกผันกับความหนาของฟิล์มโครเมียมที่เคลือบอยู่บนซิลิกอนนั่นเอง

ศักย์เร่งอิเล็กตรอน	เวลาการเคลือบ	ความหนา	ความเข้มของรังสีเอกร	ช์ลักษณะเฉพาะ (C/S)
(kV)	(min)	(nm)	Cr La	Si Ka
6	7.5	70.5	42.02	215.63
	12.5	122.0	58.94	65.97
	17.5	165.0	59.18	16.34
	22.5	210.0	62.50	5.20
	27.5	263.5	95.54	4.57
10	7.5	70.5	49.23	2049.61
	12.5	122.0	77.23	1319.91
	17.5	165.0	96.65	872.59
	22.5	210.0	110.97	540.08
	27.5	263.5	128.55	407.75

ตารางที่ 4-4 ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 2 สำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์







(b)

ภาพที่ 4-12 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางด้วยเทคนิค EDS และ ลักษณะของฟิล์มบางจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 2

- (a) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 70.5 nm
- (b) ฟิล์มบางที่มีความหนาเท่ากับ 263.5 nm

3. การเปรียบเทียบค่าความหนาของฟิล์มบางจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ ใช้ การเปรียบเทียบค่าความหนาของฟิล์มบางชุดที่ 2 ที่ได้จากการวัดด้วยเทคนิค FE-SEM กับค่าที่ได้ จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น โดยนำฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS แล้วนำค่าความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ได้ไปแทนใน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 3.1 พิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

3.1.1 เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV โดยแทนก่ากวามเข้มรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะในแบบจำลองทางกณิตศาสตร์ ตามสมการ (4.1) พบว่า ก่ากวามหนาที่ได้มีกวาม กลาดเกลื่อนสูงมากในช่วง 12.99 – 76.04 %

3.1.2 เมื่อใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV โดยแทนค่าความเข้มรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามสมการ (4.2) พบว่า ค่าความหนาที่จาก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีค่าใกล้เคียงความหนาจากเทคนิค FE-SEM โดยมีความคลาดเคลื่อน เพียง 1.3 – 2.8 % เท่านั้น

จากผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กรณีที่ใช้ศักย์เร่งอิเล็กตรอน เท่ากับ 6 kV ให้ก่าความหนาของฟิล์มบางได้ต่างจากก่าความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM มาก เนื่องจาก ที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV พลังงานของอิเล็กตรอนที่เป็นโพรบมีค่าน้อยทำให้ไม่ สามารถทำให้อะตอมของโครเมียมในฟิล์มเกิครังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะตามที่เป็นจริง แต่เมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV พลังงานของอิเล็กตรอนที่ยิงไปที่ชิ้นงานมีค่ามากพอในการ กระตุ้นให้อะตอมของโครเมียมในฟิล์มปล่อยรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะได้มากพอ จึงทำให้ก่าความ หนาของฟิล์มบางได้ไกล้เคียงก่าความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM มากที่สุด

ตารางที่ 4-5 ความหนาฟิล์มจากเทคนิก FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากฟิล์ม

ศักย์เร่งอิเล็กตรอน	เวลาการเคลือบ	ความหนาจาก	ความหนาจาก	%Error
(kV)	(min)	เทคนิค FE-SEM	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
		(nm)	(nm)	
6	7.5	70.5	103.92	47.40
	12.5	122.0	166.71	36.65
	17.5	165.0	167.75	1.67
	22.5	210.0	182.72	12.99
	27.5	263.5	463.88	76.04
10	7.5	70.5	71.7	1.68
	12.5	122.0	123.5	1.26
	17.5	165.0	166.8	1.09
	22.5	210.0	204.1	2.82
	27.5	263.5	258.7	1.83

3.2 พิจารณารังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

3.1.1 เมื่อใช้สักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV เมื่อแทนค่าความเข้มรังสีเอกซ์
 ลักษณะเฉพาะในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามสมการ (4.3) พบว่า ค่าความหนาของฟิล์มที่ได้
 มีความถูกในเมื่อฟิล์มบางและหนาที่สุด โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1.99 – 3.60 % แต่ในช่วง
 ความกลางของค่าความหนาที่ใช้ทดลองพบว่ามีความคลาดเคลื่อนสูงมาก ในช่วง 9.59 – 26.79 %
 3.1.2 เมื่อใช้สักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV โดยแทนค่าความเข้มรังสีเอกซ์

3.1.2 เมชาริศกอเวงชแก๊ตรอนเท็กบาง (4.4) พบว่า ค่าความหนาที่จาก ลักษณะเฉพาะในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามสมการ (4.4) พบว่า ค่าความหนาที่จาก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีค่าใกล้เคียงความหนาจากเทคนิค FE-SEM โดยมีความคลาดเคลื่อน เพียง 0.19 – 4.69 % เท่านั้น

จากผลการศึกษาพบว่า ความหนาฟิล์มจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ศักย์เร่ง อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV มีความคลาคเคลื่อนสูงมาก เนื่องจากที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV พลังงานของอิเล็กตรอนที่เป็นโพรบมีค่าน้อยทำให้รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับอาจ ถูกดูดกลืนโดยชั้นของฟิล์มบางเป็นส่วนใหญ่ก่าความหนาที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่เมื่อใช้ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 kV พลังงานของอิเล็กตรอนที่ยิงไปที่ชิ้นงานมีค่ามากพอในการ กระตุ้นให้อะตอมของซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับให้ปล่อยรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่มีพลังงานมาก พอที่จะทะลุผ่านชั้นของฟิล์มที่เคลือบทับอยู่ จึงทำให้ค่าความหนาของฟิล์มบางได้จากแบบจำลองมี ค่าใกล้เกียงค่าความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM มากที่สุด

ศักย์เร่งอิเล็กตรอน	เวลาการเคลื่อบ	ความหนาจาก	ความหนาจาก	%Error
(kV)	(min)	เทคนิค FE-SEM	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
		(nm)	(nm)	
6	7.5	70.5	71.90	1.99
	12.5	122.0	133.70	9.59
	17.5	165.0	206.52	25.16
	22.5	210.0	266.26	26.79
	27.5	263.5	273.00	3.60
10	7.5	70.5	68.24	3.20
	12.5	122.0	118.27	3.06
	17.5	165.0	165.32	0.19
	22.5	210.0	219.86	4.69
	27.5	263.5	251.81	4.44

ตารางที่ 4-6 ความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ จากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากวัสคุรองรับ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 ฟิล์มบาง โครเมียมเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริงบนกระจกสไลด์และซิลิกอน ชุดที่ 1 ที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ ทึบสะท้อนแสงดี ฟิล์มที่ใช้ในการศึกษาชุดนี้มีความหนา ในช่วง 50.5 - 284.5 nm

2. โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการเคลือบ
 โดยที่เวลา 5-10 นาที ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานและเปลี่ยนเป็นผลึกที่ระนาบ (210)
 เมื่อเวลามากกว่า 15 นาที ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มที่ได้มีค่าในช่วง 4.5877 – 4.5946 Å

ความหยาบผิวและขนาดผลึกของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้เคลือบ

 ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α จากฟิล์มบาง มีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา ของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น และความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si K_α จากวัสดุรองรับ มีค่าลดลง ตามความหนาของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น

5. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สร้างโดยใช้ค่าความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากชิ้นงาน แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

5.1 กรณีรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_a จากฟิล์มบาง กราฟปรับเทียบที่ได้จาก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง 3 ช่วง ช่วงแรกความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมี ค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความหนาของฟิล์ม จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และ เพิ่มเข้าสู่ค่าอิ่มตัว ในช่วงท้าย โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ยังเปลี่ยนแปลงตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน โดยที่ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV คือ $I_d = 107.16 (1 - e^{-0.0048 d})$ และ ที่ 10 kV คือ $I_d = 203.28 (1 - e^{-0.0039 d})$ 5.2 กรณีรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si K_a จากวัสดุรองรับ กราฟปรับเทียบที่ได้จาก

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง 3 ช่วง ช่วงแรกความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะมี ค่าลดลงอย่างรวดเร็วตามความหนาของฟิล์ม จากนั้นลดลงอย่างช้า ๆ และ ลดลงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ในช่วงท้าย โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ยังเปลี่ยนแปลงตามศักย์เร่งอิเล็กตรอน โดยที่ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV คือ I_d = 855.44 e^{-0.0192 d} และที่ 10 kV คือ I_d = 3735.73 e^{-0.0088 d}

การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 ฟิล์มบาง โครเมียมเคลือบด้วยวิธีสป์ตเตอริงบนกระจกส ไลด์และซิลิกอน ชุดที่ 2 ที่เคลือบ ได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ ทึบสะท้อนแสงดี ฟิล์มที่ใช้ในการศึกษามีความหนา ในช่วง 70.5 - 263.5 nm

2. โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการเคลือบ
 โดยที่เวลา 7.5 นาที ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานและเปลี่ยนเป็นผลึกที่ระนาบ (210)
 เมื่อเวลามากกว่า 12.5 นาที ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าอยู่ในช่วง 4.5808 – 4.5852 Å

3. ความหยาบผิวและขนาดผลึกของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้เคลือบ

 ความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr L_α จากฟิล์มบาง มีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา ของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น และความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Si K_α จากวัสดุรองรับ มีค่าลดลงตาม ความหนาของฟิล์มที่เพิ่มขึ้น

5. การทคสอบเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กับความหนาของฟิล์มบางที่ได้จากเทคนิค FE-SEM แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

5.1 กรณีรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง ที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV มี ความคลาดเคลื่อนสูงถึง 76.0 % ส่วน ที่ 10 kV มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2.8 %

5.2 กรณีรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ ที่ศักย์เร่งอิเล็กตรอนเท่ากับ 6 kV มีความคลาดเคลื่อนสูงถึง 26.8 % ส่วน ที่ 10 kV มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 4.7 %

บรรณานุกรม

- นิพนธ์ ดังคณานุรักษ์ และคณิตา ดังคณานุรักษ์. (2547). *สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- นิรันคร์ วิทิตอนันต์, วุฒิพงศ์ ศาสนสุพิน และสยาม วีรวิศกุล. (2552). กระจกเงาเคลือบ โครเมียมที่ เคลือบด้วยเทคนิคสปัตเตอริงสำหรับกระจกเงาส่องหลังรถยนต์. *วารสารมหาวิทยาลัย ทักษิณ, 12*(3), 52-63.
- นิรันคร์ วิทิตอนันต์. (2542). การวัดความหนาของฟิล์มทองกำซึ่งเกลือบบนแผ่นแก้ว ด้วยเทกนิก การเรืองรังสีเอกซ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทกโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- นิรันคร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษ ลิ้มสุวรรณ และวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐกุล. (2544). การวัคความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 24(3), 299-310.
- พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิว โลหะด้วย วิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. รายงานการวิจัย ประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทค โน โลยี พระจอมเกล้าธนบุรี.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. (2551). เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ไพโรจน์ แก้วอภิชัย และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. (2544). การวัดความหนาของทองที่เคลือบบนวัสดุ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 (หน้า 547-552). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

้ วีรศักดิ์ อุคมกิจเดชา. (2543). *เครื่องมือวิจัยทางวัสคุศาสตร์ ทฤษฏี และหลักการทำงานเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระพงศ์ จิ๋วประคิษฐ์กุล, เกษรา อินนุรักษ์ และวรพจน์ อิงคสรรัตน์. (2549). การวัดความหนา สารเคลือบ โดยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปก โตรเมตรี. ใน *การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44* (หน้า 603-610). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

- สุรสิงห์ ไชยคุณ, นิรันคร์ วิทิตอนันต์, สกุล ศรีญาณลักษณ์ และจักรพันธ์ ถาวรธิรา. (2540). *การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง*. รายงานการวิจัยประจำปี 2540. ทุนอุคหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อมรรัตน์ คำบุญ. (2551). ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียม ใคออกไซค์ที่เคลือบค้วยวิธีรีแอคตีฟ สปัตเตอริง ที่มีผลต่อการเกิดอปาไทท์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อารีรัตน์ สมหวังสกุล. (2556) การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง ไทเทเนียม อะลูมิเนียม ใน ไตรค์ค้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอน โคสปัตเตอริง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณทิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบุรพา.
- American Society for Testing and Materials. (1997). ASTM B659-90: Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic Coatings. In 1997 Annual Books of ASTM Standard (pp. 385-387). Philadelphia: ASTM.
- Berry, R. W., Hall, P. M., & Harris, M. T. (1968). *Thin Film Technology*. New Jersey: D.Van Nostrand.
- Bunshah, R. F. (1994). Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings (2nd ed.). New Jersey: Noyes.
- Canli, S. (2010). *Thickness Analysis of Thin Film by Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*. Graduate school of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University.
- Chapman, B. (1980). Glow Discharge Processes. New York: John Wiley & Sons.
- Echertová, L. (1986). *Physics of Thin Films* (2nd ed.). New York: Plenum.
- Franquet, A., Conard, T., Gilbert, M., Hantschel, T., & Vandervorst, W. (2013). Thickness and Composition Measurements of Nanoelectronics Multilayer Thin Films by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), 15th International Conference on Thin Films. *Journal* of Physics: Conference Series, 417, 1-6.
- Homhuan, P., Chaiyakun, S., Thonggoom, R., Panich, N., & Tungasmita, S. (2010). Growth and structural characterization of nanostructured chromium-zirconium-nitride thin films for tribologocal application. *Materials Transactions*, 51(9), 1651-1655.

- Kailash, C. J., & Hore, D. K. (2010). A simple transmission-based approach for determining the thickness of transparent films. *American Journal of Physics*, 79(256), 256-260.
- Kongsakul, J., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., & Kaewtrakulpong, P. (2005). Measurement of Aluminum thin film thickness by Fizeau interferometer technique. In *Proceedings of The 2005 electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Tehnology (ECTI) International Conference* (pp. 450-453). Chon Buri: Thailand.
- Mattox, D. M. (2010). Handbook of Physics Vapor Deposition (PVD) Processing Film information Adhesion Surface Preparation and Contamination Control (2nd ed.). Burlington: Elsevier.
- Oliva Arias A. I., López-Garduza, F., & Sosa, V. (2006). On the thickness measurement of metallic thin films. *Ingeniería*, *10*(2), 57-65.
- Orhing, M. (2002). *Materials Science of Thin Films: Deposition & Structure* (2nd ed.). San Diego: Academic Press.
- Pascual, R., Cruz, L. R., Ferreira, C. L., & Gomes, D. T. (1990). Thin Film Thickness Measurement Using The energy Dispersive Spectroscopy Technique in a Scanning Electron Microscope. *Thin Solid Films*, 185, 279-286.
- Piegari, A., & Masetti, E. (1985). Thin Film Thickness Measurement: A Comparison of Various Technique. *Thin Solid films*, 124, 249-257.
- Pliskin, W. A., & Zamin, S. J. (1970). Film thickness and composition. In L. I. Miassel, &
 R. Glang (Eds.), *Handbook of Thin film technology* (pp. 1-54). New York: McGraw-Hill.
- Prencipe, I., Dellasega, D., Zani, A., Rizzo, D., & Passoni, M. (2015). Energy dispersive x-ray spectroscopy for nanostructured thin film density evaluation. *Science and Technology* of Advanced Materials, 16, 1-9.
- Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.
- Smith, D. L. (1995). Thin-Film Deposition: Principle and Practice. New York: McGraw-Hill.

Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). Thin Films Processes. New York: Academic Press.

- Vrielink, J. A. M., Tiggelaar, R. M., Gardeniers, J. G. E., & Lefferts, L. (2012). Applicability of X-ray fluorescence spectroscopy as method to determine thickness and composition of stacks of metal thin films: A comparison with imaging ad profilometry. *Thin Solid Films, 520*, 1740-1744.
- Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). Handbook of Sputter Deposition Technology: Principles, Technology and Applications. New Jersey: Noyes.
- Zhuang, L., Bao, S., Wang, R., Li, S., Ma, L., & Lv, D. (2009). Thin Film Thickness Measurement Using Electron Probe Microanalyzer. In *Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices* (pp. 450-453). Chengdu: China.

ภาคผนวก ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ ศธ อ๕๕๑.๑๒/ ๑๐ ได้



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐

ชา พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ตอบรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติครั้งที่ ๕

เรียน วิรุฬห์ พรมมากุล อดิศร บูรณวงศ์ สุรสิงห์ ไชยคุณ และนิรันดร์ วิทิตอนันต์

ตามที่ท่านได้ส่งบทความ เรื่อง "การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปค โตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน" เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาผลงานของ ท่านเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผลงานของท่านได้รับการพิจารณาตอบรับให้นำเสนอผลงานใน รูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใน รูปแบบบทความฉบับเต็ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ ວ-๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๓ โทรสาร ๐- ๒๕๒๙ ๑๖๓๘ ต่อ ๔๐๖



December 8th - 9th , 2016 Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Rayal Patronage The 41st National and 5th International Graduate Research Conference



💙 🛫 🎲 🤓 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

การประเมินค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) โดยช่วงอายุของขยะที่แตกต่างกันที่สถานฝังกลบมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป.ลาว <i>ภูคำ นิราวรรณ และซลอ จารุสุทธิรักษ์</i>	314
ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์ มณวิภา พลจักรี ปราโมทย์ พรสุริยา และประพฤติ พรหมสมบูรณ์	322
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยวิธีการจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ <i>ซลิดา ยังเพ็ง ชัชวาล ชินวิกัย และสมภพ ตลับแก้ว</i>	330
การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจาย พลังงาน วิ <i>รุฬห์ พรมมากุล อดิศร บูรณวงศ์ สุรสิงห์ ไชยคุณ และนิรันดร์ วิทิตอนันต์</i>	344
การประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับเว็บไซต์สินค้าชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชน บ้านใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา <i>ศุภสิทธิ์ สมศรีใส สนั่น การค้า และจงกล จันทร์เรือง</i>	359
การศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความต้องการพัฒนาของ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน <i>พงศ์อมร คชศิลา สุนทรี จีนธรรม และวินัย วีระวัฒนานนท์</i>	375
การบำบัดก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 ด้วยระบบดักจับแบบเปียกที่มีการไหลของ อากาศที่เข้าบำบัดแบบ co-current พรรวิษา แกสมาน สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ และพนาลี ชีวกิดาการ	391
การพัฒนาระบบบริหารห้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต <i>ไชย มีหนองหว้า</i>	403
ผลของสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักคะน้า <i>นัฐวดี มงกุฎสุวรรณ์ ปริชาติ ดิษฐกิจ และจรรยา สิงห์คำ</i>	419
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อ	432

สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศศิธร แท่นทอง และอัคกะบัทคาน ปาทาน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41^{et} National and 5th International Graduate Research Conference

การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปี แบบกระจายพลังงาน

THICKNESS MEASUREMENT OF METAL THIN FILM BY ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY TECHNIQUE

วิรุหห์ พรมมากุล¹ อดีศร บูรณวงศ์² สุรสิงท์ ไชยคุณ³ และนิรันตร์ วิทิตอนันต์⁴ Wiroon Prommakoon¹ Adisom Buranawong², Surasing Chaiyakun³ and Nirun Witit-anun⁴

¹ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e-mail: krujoey1@gmail.com ²/ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e-mail: adisomb@buu.ac.th ³ กาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e-mail: s-chaikun@hotmail.com ⁴ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา e-mail: nirun@buu.ac.th

บทคัดย่อ

ลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งของพิล์มบางคือความหนาของพิส์มเนื่องจากมีสมบัติของ พิล์มหลายด้านที่สัมพันธ์กับความหนา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการวัดความหนาของ พิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคบีแบบกระจายพลังงาน (EDS) ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้ง ต่อพ่วงอยู่กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พิล์มตัวอย่างในการศึกษาคือพิล์มบาง โครเมียม (Cr) ที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง โครงสร้างผลึก ความหยาบผิว ความหนา โครงสร้างจุลภาค และ องค์ประกอบทางเคมีของพิล์มศึกษาด้วยเทคนิค GA-XRD, AFM, FE-SEM และ EDS ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าพิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาวสะท้อนแสงดี ความหนาของพิล์ม อยู่ในช่วง 50.5 - 284.5 nm โดยความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของ Cr LC จากพิล์มกับ ความหนาพิล์มมีความสัมพันธ์กับแบบเอกซ์โพเนนเซียล ตามสมการ คือ I_d = 203.28 (1-e^{-0.0039 d}) เมื่อ I_d เป็นความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากพิล์มกางที่มีความหนาเท่ากับ d ทั้งนี้ความหนา ของพิล์มจากเทคนิคเอกซ์เรย์สเปตโตรสโคบีแบบกระจายพลังงานในงานวิจัยนี้มีความถูกต้องถึง 97% เมื่อเทียบกับความหนาของพิล์มที่วัดได้จากเทคนิค FE-SEM

คำสำคัญ : ฟิล์มบาง สปัตเตอริง ความหนา เอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ABSTRACT

The important characteristic of thin film is the thickness, due to the fact that most of film properties are related to film thickness. The objective of this research work is to study the thickness measurement of metal thin film by energy dispersive X-ray spectroscopy technique (EDS) which equipped with the scanning electron microscope (SEM). The metal thin films of chromium (Cr) have been deposited on glass slide and Si substrates by sputtering method. Crystal structure, roughness, thickness, microstructure and elemental component of the as-deposited were characterized by GA-XRD, AFM, FE-SEM and EDS technique, respectively. The results showed that the as-deposited chromium thin films give very bright color of the dark gray, smooth surface and highly reflectance. The thickness of films in this study is in the range of 50.5 - 284.5 nm. The intensity of the characteristic x-ray of Cr EQ from films are related to film thickness in exponential function obeyed the equation of $I_d = 203.28 (1-e^{-0.0039})^4$ where I_d is the intensity of the characteristic x-ray from film thickness d. The thickness of films from mathematical models is 97% in agreement with the thickness from FE-SEM technique.

Keywords: Thin film, Sputtering, Thickness, Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy

บทน้ำ

2

การปรับปรุงผิวของวัสดุเพื่อให้มีความทนทาน สีสันสวยงาม หรือรวมถึงมีสมบัติตาม ต้องการเพื่อการใช้ประโยขน์ในงานอื่น ๆ อาจทำได้หลายวิธี ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การเคลือบผิววัสดุด้วยสารที่เหมาะสมในลักษณะของชั้นเคลือบที่เรียกว่า ฟิล์มบาง (Thin Films) (Wasa & Hayakawa, 1992) ทั้งนี้ Bunshah (1994) ได้ให้ความหมายของฟิล์มบางว่าหมายถึง ชั้นของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับตัวรวมกันเป็นของแข็งบาง ๆ บนวัสดุรองรับ ทั้งนี้การจำแนก ชนิดของฟิล์มยังขึ้นกับลักษณะการใช้งาน โดยฟิล์มบางเป็นการใช้สมบัติเชิงผิว (Surface Properties) แต่ถ้าใช้สมบัติเชิงปริมาตร (Bulk Properties) เรียกฟิล์มนั้นว่า ฟิล์มหนา

การเคลือบผิวของวัสดุในช่วงแรกภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีอิเล็กโตรเพลตติง (Electroplating) เนื่องจากเป็นวิธีเคลือบที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีราคาถูก และสามารถเคลือบ ชิ้นงานได้จำนวนมากในแต่ละครั้ง แต่วิธีนี้ต้องใช้สารละลายเคมีจำนวนมากซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อม จึงมีการวิจัยและพัฒนาการเคลือบใหม่มาทดแทน คือ การเคลือบในสุญญากาศ (Vacuum Deposition) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดในสุญญากาศและไม่ใช้สารเคมี ชั้นเคลือบที่ได้มี คุณภาพสูงกว่าชั้นเคลือบจากวิธีอิเล็กโตรเพลตติง โดยวิธีเคลือบในสุญญากาศที่ได้รับความสนใจจาก นักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม คือ การเคลือบด้วยไอกายภาพ (Physical Vapor Deposition; PVD) เนื่องจากการเคลือบวิธีนี้สามารถควบคุมการเกิดชั้นเคลือบได้อย่างแน่นอนเที่ยงตรง ทั้งด้านความหนา และองค์ประกอบ ชั้นเคลือบที่ได้มีการยึดติดดี อีกทั้งยังสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท

345

346

ทั้งโลหะ อโลหะหรือของผสม (พิเซษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2551) ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการนำฟิล์มบาง มาใช้งานต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบบฟิล์มชั้นเดียว (Single Layer) หรือแบบหลายชั้น (Multi-Layer) รวมถึงอาจเป็นฟิล์มของสารชนิดเดียว (Single Element) อัลลอยด์ (Alloys) หรือสารประกอบ (Compound) ขึ้นกับวัตถุประสงค์และการใช้งาน โดยสมบัติของฟิล์มบางส่วนใหญ่ขึ้นกับ ลักษณะเฉพาะของฟิล์ม เช่น โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ความหนา (Thickness) ความหยาบผิว (Roughness) องค์ประกอบทางเคมี (Elemental Composition) เป็นต้น

ความหนาเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งของฟิล์มบาง เนื่องจากมีสมบัติหลายด้าน ของฟิล์มบางที่เปลี่ยนแปลงไปตามศาความหนาของฟิล์ม เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางแสง หรือ สมบัติทางไฟฟ้า ฯลา ดังนั้นความหนาของฟิล์มบางจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ความหนาของฟิล์ม หมายถึง "ระยะตั้งฉากจากจุดใด ๆ บนผืาหน้าของฟิล์มทะลุผ่านเนื้อของ ฟิล์มไปยังอีกขอบหนึ่งของผิวหน้าฟิล์ม" จากนิยามดังกล่าวถ้าขอบผิวหน้าของฟิล์มบางที่ต้องการวัด ไม่ขนานหรือไม่ราบเรียบ ความหนาฟิล์มที่ได้จะไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่อย่างไรก็ดี ฟิล์มบางที่ได้จากการเคลือบในสุญญากาศส่วนใหญ่จะมีผิวหน้าที่ขนานและราบเรียบทำให้ไม่ค่อยมี ปัญหาในประเด็นนี้มากนัก (Berry, Halt & Hards, 1968)

การวัดความหนาของฟิล์มอาจทำได้ทั้ง แบบการวัดระหว่างเคลือน (in situ method) และ การวัดภายหลังการเคลือบ (ex-situ Method) ทั้งนี้ ASTM ได้แบ่งการวัดความหนาของฟิล์มใน ASTM B659-90. Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic Coatings. ออกเป็น 4 กลุ่มหลักคือ (1) การวัดแบบในทำลายขึ้นงาน (Nondestructive Methods) (2) การวัดแบบกึ่งทำลายขึ้นงาน (Semidestructive Methods) (3) การวัดแบบทำลายขึ้นงาน (Destructive Methods) และ (4) วิธีอื่น ๆ (Other Methods) (3) การวัดแบบทำลายขึ้นงาน (Destructive Methods) และ (4) วิธีอื่น ๆ (Other Methods) (American Society for Testing and Materials, 1997) ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวิธีวัดความหนาพิล์มด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เทคนิคเซิงกล เทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า เทคนิคทางแสง และ เทคนิคทางรังสี (Piegari & Masetti, 1985) แต่ละเทคนิคก็มีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไป โดยการเลือกใช้เทคนิคการวัดความหนาฟิล์ม ขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ชนิดของฟิล์ม ระดับความหนา การใช้งาน ความละเอียดที่ต้องการ ซึ่งปกติ แล้วไม่มีเทคนิคใดที่ดีที่สุดแต่ขึ้นกับการตัดสินไจของผู้ศึกษาเป็นสำคัญ (Pliskin & Zamin, 1970)

ทั้งนี้การวัดความหนาของฟิล์มหลังการเคลื่อบแบบไม่ทำลายขึ้นงานเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การวัดความหนาฟิล์มด้วยเหลนิคการเรื่องรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence Technique; XRF) เทคนิคนี้อาศัยแนวคิดว่า ปริมาณอะต่อมของธาตุในเนื้อฟิล์มจะเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม ทั้งนี้ เมื่อวัดความหนาโดยการฉายรังสีเอกซ์ไปกระตุ้นอะต่อมของธาตุในเนื้อฟิล์ม ถ้าฟิล์มด้วอย่างที่ ต้องการวัดมีความหนามาก (อะต่อมของธาตุในเนื้อฟิล์มก็จะมาก) ความเข้มของรังสีเอกซ์ ลักษณะเฉพาะ (Characteristic X-ray) ที่ตรวจวัดได้จากฟิล์มก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน (นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเซษฐ ลิ้มสุวรรณ, และวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล, 2544) อย่างไรก็ดีเทคนิคนี้เหมาะสำหรับฟิล์มที่มีความหนามากในระดับไมโครเมตร แต่ไม่เหมาะสำหรับ ฟิล์มบางที่เตรียมได้จากกระบวนการเคลือบด้วยไอกายภาพที่มีความหนาน้อยมากในระดับนาโนเมตร เนื่องจากรังสีเอกซ์ที่ใช้เป็นโพรบ (Probe) ในการวัดมีความเข้มสูงมากจนทะลุผ่านชั้นของฟิล์มบางไป การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ยังวัสดุรองรับ (กรณีเทคนิค XRF) ส่งผลให้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากวัสดุรองรับ มีค่าสูงและแตกต่างจากความเข้มของการรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากพิล์มมากจนไม่สามารถตรวจวัด รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มได้ อย่างไรก็ดีด้วยหลักการเดียวกันการวัดความหนาของฟิล์มด้วย เทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy Technique; EDS) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากอิเล็กตรอนที่ใช้เป็นโพรบในการ วิเคราะห์ฟิล์มบางของเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนั้น มีระดับพลังงานไม่สูง มากเกินไป เหมาะสำหรับใช้ในการกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย (กรณีนี้คือฟิล์มที่มีความหนาระดับนาโนเมตร) และที่สำคัญระบบวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคเอกซ์ เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานยังเป็นอุปกรณ์ที่มีติดตั้งอยู่ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราต (Scanning Electron Microscope: SEM) ทั่วไป เทคนิคนี้จึงมีความน่าสนใจในการนำมา ประยุกต์ใช้ในการวัดความหนาของฟิล์มบางระดับนาโนเมตรภายหลังการเคลือบแบบไม่ทำลาย ซิ้นงานได้ (Franquet et al. 2013)

บทความวิจัยนี้เป็นรายงานผลการศึกษาเทคนิคการวัดคงามหนาของฟิล์มบางโลหะที่มี ความหนาในระดับนาโนเมตร ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน โดยฟิล์มบาง ด้วอย่างที่ใช้ศึกษาคือฟิล์มบางโครเมียม (Cr) ที่มีความหนาระดับนาโนเมตรที่เตรียมจากวิธีสปัตเตอริง ซึ่งถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD แล้วนำไปวัดความหนาจากเทคนิค FE-SEM สำหรับใช้เป็นกาอ้างอึง จากนั้นนำฟิล์มบางตัวอย่างที่ทราบความหนาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS เพื่อให้ได้ความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษะเฉพาะซึ่งสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา แล้วนำข้อมูลข้างต้นมาสร้างแบบจำลองทรงคณิตศาสตร์เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ของ ค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะกับความหนาของฟิล์มบางตัวอย่าง สุดท้ายเป็นการทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วยฟิล์มบางชุดที่ใช้สำหรับทศสอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเคลือบพิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคสปัตเตอริง

 เพื่อพัฒนาเทคนิศการวัดความหนาของพิสมบางด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปี แบบกระจายพลังงาน

BOOLISE A IONEINA IN

วิธีการวิจัย พิล์มบางโลหะที่ใช้ในการศึกษานี้คือพิล์มบางโครเมียม (Cr) ซึ่งเคลือบบนกระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอนด้วยวิธีสปัตเตอริง จากเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบดีชีแมกนีตรอนสปัตเตอริง (ภาพที่ 1) ห้องเคลือบมีทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.0 cm สูง 31.0 cm คาโทดติดตั้ง เป้าสารเคลือบ (โครเมียม) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 cm พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง การเคลือบใช้แก้สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก้สสปัตเตอร์ ซึ่งจ่ายเข้าห้องเคลือบผ่านการควบคุมด้วย เครื่องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D ระบบเครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วย เครื่องสูบแบบแพรไอมีเครื่องสูบกลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย ใช้มาตรวัดความดันของ PFEIFFER ซึ่งใช้ ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauage รุ่น PKR251

347

348

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ฟิล์มบางโครเมียมในการศึกษามี 2 ชุด ซึ่งเคลือบด้วยเงื่อนไขเดียวกันแต่ใช้เวลาการเคลือบต่างกัน สรุปดังตารางที่ 1 โดยฟิล์มบางชุดที่ 1 ใช้สร้างกราฟปรับเทียบและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ส่วน ฟิล์มบางชุดที่ 2 สำหรับใช้ในการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากฟิล์มบางชุดที่ 1



	รายละเอียด		
พารามเตอร	ฟิล์มบางชุดที่ 1 ฟิล์มบางชุดที่ 2		
<mark>เป้า</mark> สารเคลือบ	โครเมียม (Cr)		
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์และชิลิกอน		
อุณหภูมิวัสดุรองรับ	อุณหภูมิห้อง		
ระยะระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับ	11/12 15		
(cm)	100 1		
ความดันพื้น (mbar) 🛇 🖊 🌔 🗍 🖉	5.0 × 10 ⁻⁵		
ความดันรวม (mbar)	50 x 10-3		
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	20.0		
กระแสไฟฟ้า (mA)	EU(/_\ 300		
เวลาเคลี่ฮุบ (min)	5.0, 10,0, 15.0 7,5, 12.5, 17.5,		
0 1200	20.0, 25.0, 30.0 22.5, 27.5		
1 DIAN			

ดารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมที่ใช้ในงานวิจัย

การเครียมพิล์มโครเมียมเริ่มจากนำวัสดุรองรับ (กระจกสไลด์และซิลิกอน) เข้าห้องเคลือบ วางห่างจากเป้าสารเคลือบเท่ากับ 15 cm จากนั้นลดความดันในห้องเคลือบให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ 5.0x10⁻⁵ mbar จ่ายแก้สอาร์กอนเข้าห้องเคลือบผ่านเครื่องควบคุมอัตราไหลมวลโดยกำหนดให้ เท่ากับ 20 sccm จากนั้นจ่ายศักย์ไฟฟ้าให้แก่คาโทดจนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (Glow Discharge) โดย ควบคุมความดันรวมและกระแสสปตเตอริงให้คงที่เท่ากับ 5.0x10⁻⁷ mbar และ 500 mA ตามลำดับ ฟิล์มแต่ละชุดเคลือบตามเวลาที่กำหนด เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มโครเมียมทั้ง 2 ชุด สรุปดังตารางที่ 1

พิล์มบางที่เคลื่อนได้นำไปศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD ของ Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu-K_{α} (λ = 1.54056 Å) เป็นแพล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ตรวจวัดแบบ 20-scan ด้วยมุมตกกระทบเฉียง (Grazing Incident Angle) เท่ากับ 29 และสนุกนนุม 20 จาก 20° ถึง 80° สำหรับขนาดผลึก (Crystal Size) คำนวณตามสมการของ Scherrer คือ L = $k\lambda/\beta \cos \theta$ เมื่อ L คือขนาดผลึก, k คือค่าคงที่เท่ากับ 0.94, λ คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ (λ = 1.54056 Å), β คือความกว้างครึ่งหนึ่ง ของพืคที่มีค่าความเข้มสูงสุด (FWHM) และ 0 คือมุมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ค่าคงที่ แลตพิชหาจากสมการระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของโครเมียมซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ bcc ความหยาบผิวศึกษาด้วยเครื่อง AFM ของ SEIKO Instrument รุ่น SPA400 โครงสร้างจุลภาคและ ความหนาของพิล์มบางใช้เครื่อง FE-SEM ของ Hitashi รุ่น S-4700 ส่วนองค์ประกอบทางเคมีใช้ ระบบ EDS ของ IXRF systems รุ่น EDS2006 550i Analyzer ซึ่งต่อท่วงอยู่กับ FE-SEM

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำได้โดยใช้ค่าความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM และค่าความเข้มรังสีลักษณะเฉพาะจากเทคนิค EDS ของฟิล์มบางชุดที่ 1 มาสร้างแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์โดยใช้ SOLVER ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณประเภท Linear Programming

349

ซึ่งเป็น Add-Ins ของโปรแกรม EXCEL ในการช่วยหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) จาก เงื่อนไขที่มี ซึ่งในงานวิจัยนี้คือสมการความสัมพันธ์ของความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบาง ที่วัดด้วยเทคนิค EDS และความหนาฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพเนนเซียล ตามสมการ I_d = I_s (1-e^{-αd}) เมื่อ I_d เป็นความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มที่มีความหนา เท่ากับ d และ I_s เป็นความเข้มอื่มตัวของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่ศึกษา ส่วน α เป็น ค่าสัมประสิทธิ์การลดเซิงเส้น

สุดท้ายเป็นการทดสอบแบบจำลองหางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น โดยการนำฟิล์มบางขุดที่ 2 มาวัดค่าความเข้มรังสีลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิศ EDS แล้วนำไปแทนค่าในแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากฟิล์มบางขุดที่ 1 จากนั้นเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางขุดที่ 2 ที่ได้ จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับความหนาที่วัดจากเทคนิค FE-SEM

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

การเตรียมฟิล์มบาง

350

พิล์มบางชุดที่ 1 เป็นฟิล์มสำหรับใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีสีเทาเข้ม ผิว เนียนเรียบ มันวาวที่บแสงและสะท้อนแสงดี (ภาพที่ 2) ความหนามีค่าในช่วง 50.5 - 284.5 nm สำหรับโครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือนได้ในงานวิจัยนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่า รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ในการเคลือบ (ภาพที่ 3) โดยฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบในช่วง 5-10 ณัก ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กรณีนี้อาจ เกิดจากฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบในช่วง 5-10 ณัก ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กรณีนี้อาจ เกิดจากฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบในช่วง 5-10 ณัก ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กรณีนี้อาจ เกิดจากฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างเป็นแบบอลัณฐานหรือฟิล์มมีความหมาน้อยมาก แต่เมื่อใช้เวลา การเคลือบเพิ่มขึ้น พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุ่มประมาณ 44.02^Q - 44.09^Q สอดคล้องกับ รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบบอดี้เซนเตอร์คิวนิก (bcc) โดยค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางที่เคลือบได้มี ค่าอยู่ในช่วง 4.5877 - 4.5946 Å ทั้งนี้พบว่าความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ได้ยังมี ค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาการเคลือนอีกด้วย สำหรับโครงสร้างของฟิล์มโครเมียมที่เคลือบได้เมื่อเวลา การเคลือบเพิ่มขึ้นพบว่า ความทยาปผิวของฟิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm ขณะที่ ขนาดผลึกเพิ่มขึ้นจาก 32.3 nm เป็น 38.1 nm สรูปดังตวรางที่ 2



ภาพที่ 2 ลักษณะของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 1 สำหรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference



สำหรับฟิล์มบางชุดที่ 2 ซึ่งเป็นฟิล์มสำหรับใช้ทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น ในงานวิจัยนี้ พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข้ม ผิวเนียนเรียบ มันวาว ทีบและสะท้อนแสงดี เช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 (ภาพที่ 4) โดยมีความหนาในช่วง 70.5 - 263.5 nm ในส่วนของ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางชุดที่ 2 จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ในการเคลือบเช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 (ภาพที่ 5) โดยฟิล์มที่ได้เมื่อใช้เวลาเคลือบเท่ากับ 7.5 min ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ซึ่ง อาจเกิดจากฟิล์มมีโครงสร้างแบบอลัณฐานหรือฟิล์มมีความบางมาก แต่เมื่อเวลาการเคลือบเพิ่มขึ้น พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ 44.11⁰ - 44.16⁰ สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ของโครเมียมระนาบ (210) ตามฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-2392 ซึ่งมีโครงสร้างผลึก

351

352

แบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิก (bcc) ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 4.5808 – 4.5852 Å ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเคลือบเช่นเดียวกับฟิล์มบางชุดที่ 1 ทั้งนี้เมื่อเวลาการเคลือบเพิ่มขึ้นพบว่า ความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.3 nm เป็น 1.3 nm ขณะที่ขนาดผลึกเพิ่มขึ้นจาก 31.7 nm เป็น 37.3 nm สรุปดังตารางที่ 3



ภาพที่ 5 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2
<mark>เวลาเคลือบ</mark> (นาที)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)	<mark>ขนาดผลึก</mark> (nm)	ค่าคงที่แลตทิช (Å)
7.5	70.5	0.5		
12.5	122	0.8	31.7	4.5833
17.5	165	117 22	33.6	4.5808
22.5	210151	allolla	35.7	4.5823
27.5	263.5	1.2	37.3	4.5852

ตารางที่ 3 ค่าความหนา ความหยาบผิว ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางโครเมียมชุดที่ 2

การวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน

เมื่อนำพิลัมบางชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ไปวิเคราะห์ตรวจวัดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วย เทคนิคเอกซ์เรยัสเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน ได้ผลดังแสดงตารางที่ 4 โดยพบว่าซิ้นงาน ด้วอย่างซึ่งเป็นพิล์มบางโครเมียมเคลือบบนแผ่นซิลิกอน มีพีค (Peak) ของ Cr LQ จากพิล์มบางและ Si KQ จากซิลิกอนที่ใช้เป็นวัสดุรองรับที่มีความเข้มต่างกัน ภาพที่ 6 เป็นตัวอย่างของพิล์มบางชุดที่ 1 ซึ่งมีความหนาเท่ากับ 50.5 nm พบความเข้มของพืค Qr LQ จากพิล์มบางมีค่าเท่ากับ 33.73 C/S และความเข้มของพืค Si KQ จากวัสตุรองรับมีค่าเท่ากับ 2,259.87 C/S เมื่อความหนาของพิล์มเพิ่ม เป็น 284.5 กกล พบจ่าความเข้มของพืค Cr LQ จากพิล์มบางมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 136.94 C/S ขณะที่ ความเข้มของพืค Si KQ จากวัสตุรองรับมีค่าเก่ากับ 343.44 C/S พัฒนี้การเปลี่ยนแปลงความ เข้มของพิคจากพิล์มบางชุดที่ 2 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพิล์มบางชุดที่ 1 ตั้งแสดงในภาพที่ 7

ตารางที่ 4 ตัวอย่างคำความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะและความหนาจากเทคนิค FE-SEM ของฟิล์มบางชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2

ฟิล์มบางชุดที่	ความพบา	R ความเข้มของรังสีเอกซ์เ	ลักษณะเฉพาะ (C/S)
	(nm)	Cr La	Si KQ
1	50.55-11	33.78114	2,259.87
	284.5	136.94	343.44
	70.5	49.23	2,049.61
2	263.5	128.55	457.75

353



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41St National and 5th International Graduate Research Conference



รังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะเพิ่มเข้าสู่ค่าความเข้มอื่มตัวในที่สุดเมื่อความหนามากกว่า 1000 nm

355



การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การประเบินความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวัดค่าความหนาของ ฟิล์มบางที่มีความหน่วในระดับนาโนเมตร ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเบคโตรสไคปีแบบกระจายพลังงาน ในงานวิจัยใช้การเปรียบเทียบค่าความหนาของฟิล์มบางชุศที่ 2 (เคลือบด้วยเงื่อนไขเดียวกับฟิล์มบาง ชุดที่ 1) โดยนำฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวัดความหนาด้วยเทคนิค FE-SEM สำหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง แล้วนำฟิล์มบางชุดที่ 2 ไปวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค EDS จากนั้น จึงนำค่าความเข้มรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ได้ไปแทนในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้พบว่า ความหนาของฟิล์มที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ มีค่าใกล้เคียงกับ ค่าความหนาของฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ตลอดช่วงความหนาของฟิล์มที่ศึกษา (70 – 260 nm)

ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วง 1.1 - 2.8%

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ตารางที่ 5	เปรียบเทียบค่าคว	ามหนาที่ได้จากเทคนิค	FE-SEM	กับแบบจำลองท	างคณิตศาสตร์
------------	------------------	----------------------	--------	--------------	--------------

ขึ้นที่	ความหนาจากเทคนิค FE- SEM (nm)	ความหนาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (nm)	%Error
1	70.5	71.7	1.7
2	122.0	123.5	1.3
3	165.0 51514	166.8	1.1
4	210.0	204.1	2.8
5	263.5	258.7	1.8

สรป

พิล์มบรงโครเมียมถูกเคลือบด้วยเทคนิคสบัตเตอริงบนกระจกสไอด์และซิลิกอนสำหรับใช้ ศึกษาวิธีการวัดความหนาของพิล์มด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปิแบบกระจายพลังงาน (EDS) ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีสีเทาเข็ม ผิวเนียนเรียบ ทีบสะท้อนแสงที ฟิล์มที่ใช้ในการศึกษามี ความหนาในอยู่ช่วง 50.5 - 284.5 กm โครงสร้างผลึกของพิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาในการเคลือบ โดยที่เวลา 5-10 min พิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานและ เปลี่ยนเป็นผลึกที่ระบาบ (210) เมื่อเวลามากกว่า 15 min ค่าคงที่แลตที่ขของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าอยู่ ในช่วง 4.5808 - 4.5946 Å ความหยาบผิวและขนาดผลึกของพิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้เคลือบ ทั้งนี้ความเข็มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะจากฟิล์มบางโครเมียม (Cr/LOI) มีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา ของพิล์มซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงโดยช่วงแรกความเข้มรังสีที่วัดได้เพิ่มขึ้นอย่างร่วดเร็วตามความหนา จากนั้นเป็นการเพิ่มอย่างข้าๆ และสุดท้ายเฉพาะเพิ่มเข้าสู่ค่าความเข้มอิมดังในที่สุด โดยแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ในงานวิจัยนี้คือ I_d = 203.28 (1-e^{-0.0039 d}) เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาฟิล์มที่ ได้จากเทคนิค FE-SEM กับคำความหนาที่ได้จากแบบจำลองทางศณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นพบว่ามี ความคลาดเกลื่อนน้อยกว่า 3%

กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการจิจัยจาก งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติ (รหัสโครงการ) 222738 / สัญญาเลขที่ 91/2559)

357

358

บรรณานุกรม

นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษ ลิ้มสุวรรณ และวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐกุล. (2544). การวัดความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิคการเรื่องรังสีเอกซ์, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 24(3), 299-310.

พิเซษฐ ลิ้มสุวรรณ (2551). เทคโนโลยีการเคลือบพิล์มบางในสุญญากาศ. กรุงเทพา: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

- American Society for Testing and Materiats. (1997), ASTM B659-90: Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic Coatings. In 1997 Annual Books of ASTM Standard, Vol. 02.05, Philadelphia, ASTM, 385-387.
- Berry, R.W., Hall, P.M. & Harris, M.T. (1968). Thin Film Technology. New Jersey: D.Van Nostrand
- Bunshah, R./F. (1994) Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings. 2nd ed. New Jersey: Noyes.
- Franquet, A., Conard, T., Gilbert, M., Hantschel, T. & Vandervorst, W. (2013). Thickness and Composition Measurements of Nanoelectronics Multilayer Thin Films by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Journal of Physics: Conference Series. 417. 012033. DOI:10.1088/1742-6596/417/1/012033.
- Piegari, A., & Masetti, E. (1985). Thin Film Thickness Measurement: A Comparison of Various Techniques, Thin Solid Films, 124(3-4), 249-257
- Pliskin, W.A. & Zanin, S.J. (1970). Film Thickness and Composition. In L.L. Maissel & Glang, R. (Eds.), Handbook of Thin Film Technology (11-1 - 11-54). New York McGraw-Hill.
- Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). Handbook of sputter deposition technology:

principles technology and applications. New Jersey: Noyes.